

## 上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司 首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市之 补充法律意见书

致：华虹半导体有限公司

根据华虹半导体有限公司（以下简称“发行人”）的委托，本所指派李仲英律师、张征轶律师、郭珣律师、夏青律师（以下合称“本所律师”）作为发行人首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《关于华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）、《关于华虹半导体有限公司首次公开发行人民币普通股并在上海证券交易所科创板上市之律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”，与法律意见书以下合称“已出具法律意见”）。现根据《管理办法》《审核规则》、上交所上证科审（审核）[2022]496号《关于华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》的要求，以及安永华明于2022年12月13日出具的安永华明（2022）审字第60985153\_B03号《审计报告》，特就发行人有关事宜出具本补充法律意见书。

已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本补充法律意见书，但本补充法律意见书中另作定义的除外。本补充法律意见书构成已出具法律意见的补充。

## 第一部分 关于审核问询相关问题的答复

- 一. 审核问询问题 1. 关于实际控制人：根据申报材料：（1）华虹集团持有华虹国际 100%的股份，华虹集团通过华虹国际间接持有发行人 26.70%的股份，系发行人的实际控制人，申报材料对实际控制人认定中发行人股东大会、董事会的决策机制及表决情况、董事提名任免等分析不充分；（2）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》（以下简称《科创板招股说明书格式准则》）第四十一条规定“实际控制人应披露至最终的国有控股主体。”发行人参考中国海油集团、中国移动集团等案例认定上海市国资委为最终控制人，但相关参考案例有明确授权依据，申报材料对华虹集团是否有明确授权的依据论述不充分；（3）2020 年 6 月，华虹集团的控股股东上海联和按照上海市国资委的批复将所持股份无偿划转给上海市国资委，并于 2020 年 12 月完成工商变更登记手续。请发行人说明：（1）结合发行人股东大会、董事会的决策机制及表决情况，董事的提名任免，公司章程、协议或其他安排，发行人经营管理的实际运作情况等，分析认定华虹国际为控股股东、华虹集团为实际控制人的依据是否充分，控制权是否稳定及相应保障措施；（2）结合最近 2 年上海市国资委、上海联和、华虹集团、华虹国际、发行人等各层级间及跨层级间的重大事项决策、人事任免审批机制及实际履行情况，说明将上海市国资委认定为最终控制人而非实际控制人的规则依据及合理性，是否依据《企业国有资产法》的相关规定取得有关部门的明确授权，是否符合《科创板招股说明书格式准则》第四十一条的规定；（3）上海联和将所持华虹集团股份转让给上海市国资委并于 2020 年 12 月才完成工商变更登记的原因，发行人最近 2 年实际控制人是否发生变动。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

- （一）结合发行人股东大会、董事会的决策机制及表决情况，董事的提名任免，公司章程、协议或其他安排，发行人经营管理的实际运作情况等，分析认定华虹国际为控股股东、华虹集团为实际控制人的依据是否充分，控制权是否稳定及相应保障措施

1. 发行人股东大会、董事会的决策机制及表决情况，董事的提名任免，公司章程、协议或其他安排，发行人经营管理的实际运作情况

(1) 与发行人公司治理相关的主要公司章程规定、协议或其他安排

经本所律师核查，根据《公司章程》、HSF 于 2022 年 12 月出具的《Hong Kong Legal Review Report》（以下简称“《香港法律审阅报告》”）及相关备忘录（以下简称“《备忘录》”）、发行人提供的文件资料，最近 2 年以来，与发行人公司治理相关的公司章程规定、协议或其他安排主要如下：

1) 股东大会表决机制

经本所律师核查，根据《公司条例》《公司章程》《香港法律审阅报告》及《备忘录》，公司的部分权力系保留予股东；股东大会决议分为普通决议及特别决议，普通决议由（i）就该决议亲自表决（且有权如此表决）的股东和（ii）作为有权就该决议表决的股东妥为委任的代表而就该决议表决的人（“出席股东”）以总票数的 50%以上表决通过，特别决议由至少 75%的出席股东表决通过。股东大会审议的常见事项及其对应的决议要求如下表所示：

审议事项	决议类型
变更公司名称	特别决议
修改公司章程	特别决议,但有关授权董事决定股份赎回的条款、条件

	和方式而修改公司章程的决议、对公司章程中公司可发行的股份数目上限的修改可由普通决议通过
就赎回或回购公司自身的股份而从资本中拨款作付款	特别决议
授权公司回购其股份	特别决议
决议公司自愿清盘	特别决议
决议公司由法院清盘	特别决议
受限于章程的规定，授权董事决定可赎回股份的赎回条款、条件及方式	普通决议
重新发行已赎回债券	普通决议
委任核数师	普通决议
免任核数师	普通决议
董事未在核数师职位出现期中空缺后一个月内委任核数师填补空缺的情况下，委任核数师填补该空缺	普通决议
减少公司股本	特别决议
增加公司股本	普通决议
罢免董事	普通决议
在董事会建议的最大额度内宣派股息	普通决议
受限于相关监管机构或部门（包括香港联交所和	普通决议

<p>香港证监会) 不时颁布并有效的任何有关规定, 批准提供财务资助</p>	
<p>《香港上市规则》规定的特定类型的交易, 如须予公布的交易或关联交易 (分别具有《香港上市规则》所规定的含义, 其中, “须予公布的交易” 包括广泛的交易类型, 如未明确规定, 这一定义排除了公司在日常和惯常业务过程中具有收入性质的交易)</p>	<p>除香港相关法律或公司章程另有规定需由特别决议通过的(如批准构成关联交易的公司与其控股公司的纵向合并或者多家子公司的横向合并、批准公司与其控股公司的纵向合并或子公司的横向合并, 且该等合并构成重大交易、非常重大收购、非常重大处置或反向收购), 通常系由普通决议通过</p>

《公司章程》第六十一条及第六十二条规定, 董事会主席 (如有) 或 (如其缺席) 副主席 (如有) 或 (如两者均缺席) 获董事会提名的其他董事须以主席的身份主持发行人的每次股东大会; 如主席或副主席或获委任的其他董事 (如有) 于指定举行会议的时间之后十五分钟内仍未出席或无意担任会议主席, 则出席的董事须在与会的董事中推选一名董事担任会议主席; 如仅一名董事出席会议并有意出任主席, 则该董事即为会议主席。如无董事愿意担任主席, 或于指定举行会议的时间后十五分钟内仍无董事出席, 则出席并有权投票之股东须在与会股东中选出一名股东担任会议主席。

《公司章程》第六十四条及第六十八条规定, 根据香港

联交所不时规定的规则，除主席根据诚实信用原则准许就纯粹与程序或行政事宜相关的决议案以举手方式表决外，股东于股东大会上的任何表决应以投票方式进行。如果票数相等（不论举手表决或投票表决），主席除拥有其他投票权外，有权投决定票。

## 2) 董事会表决机制

经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》《备忘录》《公司章程》及《公司条例》，在《公司条例》《公司章程》或/及《香港上市规则》未要求股东大会批准的情形下，根据《公司条例》及《公司章程》的规定，董事会负责经营公司业务并有权根据《公司章程》第九十九条的规定行使公司的全部权利。董事会可以通过召开董事会会议或通过书面决议的方式行使其决策权，但在考虑发行人主要股东或董事有利益冲突且董事会已确定该等利益冲突属重大的事宜或业务、委任及解雇公司秘书时，不得以通过书面决议案取代召开董事会会议。

董事会须从董事中选出一名董事会主席及一名副主席，并可罢免其职务。主席（或其未能出席则副主席）须主持所有董事会会议，但如无主席或副主席，或如主席或副主席在会议指定时间十分钟内未能列席，或如二位均不愿担任主席，则可从出席之董事当中选出一位董事担任会议主席。

董事会决议应由出席会议的董事或其替任董事的多数票通过，如果票数相等，则主席将有权投第二票或决定票。

书面决议应由当时有权收到会议通知的所有董事签署书面决议后通过。董事及其替任人一般不得就任何批准其或其联系人或任何其关联实体直接或间接拥有重大利益关系之任何交易、合约、安排或事项（持有公司或通过公司持有之股份、债券或其他证券权益除外）决议案在董事会会议上表决或计入法定人数。

### 3) 董事提名任免

经本所律师核查，根据《公司章程》第一百一十条及《备忘录》，在任何股东大会上，除卸任董事外，没有人可被委任或再次被委任为董事，除非（i）该人士由董事会推荐；或（ii）有权投票之股东向公司提交一份通知，列明其欲委任或再委任该人士为董事的意向，说明如该人士被委任或再被委任，须登记于公司董事登记册内之资料，并须连同该人士签署表明愿意接受委任或再委任的通知书。就上述第（ii）项而言，发出通知的期限至少为提前 7 日，且须于不早于大会通告寄发日期后翌日开始，并于不迟于该大会举行日期前 7 日结束。

经本所律师核查，根据《于 2019 年 1 月 1 日生效的提名委员会职权范围》及《备忘录》，发行人提名委员会由三名委员组成，分别为执行董事张素心及独立非执行董事王桂壖、叶龙蜚；其中，张素心为提名委员会主席。发行人提名委员会就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事会主席及行政总裁）继任计划向董事会提出建议。在收到并考虑了提名委员会的建议后，董事会可：

（i）根据《公司章程》第一百一十二条委任一名董事；

或 (ii) 建议发行人根据第一百一十一条委任或重新委任一名人员，以填补空缺或担任增补董事。根据《公司章程》第一百一十二条委任的董事应在下一届股东周年大会上退任，且应有资格连任。

经本所律师核查，根据《备忘录》，任何提名委员会会议上提出的问题须以出席会议的委员或其替任委员的多数票作出决定；如果票数相等，则委员会主席将有权投第二票或决定票。根据发行人提供的文件资料，最近两年以来，提名委员会决议主要系关于向董事会推荐委任孙国栋为发行人非执行董事事宜，该等决议系由全体成员一致同意。

经本所律师核查，根据发行人与大基金于 2018 年 1 月签订的《认购协议》，大基金（无论是通过其自身或是通过其指定人士）认购发行人 242,398,925 股股份，认购价为每股 12.9002 港元；认购条件包括发行人需任命一名由认购人提名的人士作为发行人的董事。

## (2) 发行人股东大会、董事会的表决情况

经本所律师核查，根据发行人于香港联交所公开披露的文件、发行人提供的文件资料、《香港法律审阅报告》及《备忘录》，最近 2 年以来，发行人股东大会审议的事项主要为发行人股本变动、股票期权激励计划、财务报告、董事选举及薪酬确定、聘用会计师、重大投资、本次发行等事宜，由华虹国际投赞成票的议案均获股东大会审议通过；发行人董事会审议的事项主要为发行人财务业绩、考虑派付股息、董事选举及高级管理人员聘任、战略投资、股票期权激励计划、

本次发行等事宜，来自于华虹集团之董事同意的议案均获发行人董事会通过。

经本所律师核查，根据发行人于香港联交所公开披露的文件、发行人提供的文件资料、《香港法律审阅报告》及《备忘录》，最近2年以来发行人股东大会、董事会表决的具体情况如下表所示：

序号	会议名称	主要审议事项	表决情况
<b>一. 股东大会</b>			
1.	2020年 股东周 年大会	省览、考虑及采纳发行人及其子公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之经审核财务报表以及董事及核数师报告	998,553,868 股 (100.00%) 赞成, 0 股 (0.00%) 反对
		重选森田隆之先生为非执行董事	996,604,613 股 (99.76%) 赞成, 2,363,611 股 (0.24%) 反对
		重选叶峻先生为非执行董事	891,690,810 股 (89.26%) 赞成, 107,276,414 股 (10.74%) 反对
		重选王桂壩先生为独立非执行董事	997,764,816 股 (99.88%) 赞成,

			1,202,408 股 (0.12%) 反对
		重选王靖女士为非执行董事	996,521,613 股 (99.76%) 赞成, 2,445,611 股 (0.24%) 反对
		授权董事会厘定各董事之酬金	998,857,074 股 (99.99%) 赞成, 93,150 股 (0.01%) 反对
		续聘安永会计师事务所为核数师, 并授权董事会厘定其酬金	998,758,224 股 (99.98%) 赞成, 209,000 股 (0.02%) 反对
		批准一般授权以购回发行人已发行股份	998,398,224 股 (99.94%) 赞成, 552,000 股 (0.06%) 反对
		批准一般授权以配发及发行发行之额外股份	898,859,583 股 (89.98%) 赞成, 100,107,641 股 (10.02%) 反对
		批准扩大一般授权以配发及发行发行人所购回之股份	908,025,583 股 (90.90%) 赞成, 90,941,641 股 (9.10%) 反对
2.	2021 年 股东周	省览、考虑及采纳发行人及其子公司截至二零	899,834,664 股 (99.93%) 赞成,

年大会	二零年十二月三十一日止年度之经审核财务报表以及董事及核数师报告	661,004 股 (0.07%) 反对
	重选张素心先生为执行董事	882,004,052 股 (97.95%) 赞成, 18,491,616 股 (2.05%) 反对
	重选张祖同先生为独立非执行董事	900,495,664 股 (99.99%) 赞成, 4 股 (0.01%) 反对
	重选叶龙蜚先生为独立非执行董事	900,473,663 股 (99.99%) 赞成, 22,005 股 (0.01%) 反对
	重选孙国栋先生为非执行董事	889,609,546 股 (98.79%) 赞成, 10,886,122 股 (1.21%) 反对
	授权董事会厘定各董事之酬金	898,690,963 股 (99.80%) 赞成, 1,804,705 股 (0.20%) 反对
	续聘安永会计师事务所为核数师, 并授权董事会厘定其酬金	899,480,664 股 (99.89%) 赞成, 1,015,004 股 (0.11%) 反对

		批准一般授权以购回发 行人之已发行股份	899,939,364 股 (99.94%) 赞成, 556,304 股 (0.06%) 反对
		批准一般授权以配发及 发行发行人之额外股份	779,589,037 股 (86.57%) 赞成, 120,906,631 股 (13.43%) 反对
		批准扩大一般授权以配 发及发行发行人所购回 之股份	787,138,890 股 (87.41%) 赞成, 113,356,778 股 (12.59%) 反对
3.	2021 年 特别股 东大会	批准建议修订根据于该 通函中提及的股票期权 计划之二零一八年期权 及二零一九年期权之相 关期权条款	804,675,795 股 (88.49%) 赞成, 104,662,861 股 (11.51%) 反对
		批准更新股票期权计划 限额	798,896,212 股 (87.85%) 赞成, 110,442,444 股 (12.15%) 反对
4.	2022 年 股东周 年大会	省览、考虑及采纳截至 二零二一年十二月三十 一日止年度发行人及其 子公司的经审核综合财 务报表以及董事报告及 核数师报告	881,365,418 股 (99.96%) 赞成, 318,000 股 (0.04%) 反对

	重选唐均君先生为执行董事	875,105,191 股 (99.25%) 赞成, 6,578,227 股 (0.75%) 反对
	重选王靖女士为非执行董事	867,562,345 股 (98.40%) 赞成, 14,121,073 股 (1.60%) 反对
	重选王桂壘先生为独立非执行董事	870,235,228 股 (98.70%) 赞成, 11,448,190 股 (1.30%) 反对
	授权董事会厘定各董事的薪金	879,935,357 股 (99.80%) 赞成, 1,734,061 股 (0.20%) 反对
	续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其薪金	879,348,865 股 (99.74%) 赞成, 2,334,553 股 (0.26%) 反对
	批准一般授权以购回发行人之已发行股份	881,433,918 股 (99.97%) 赞成, 249,500 股 (0.03%) 反对
	批准一般授权以配发及发行发行人之额外股份	745,212,513 股 (84.52%) 赞成, 136,470,905 股 (15.48%) 反对

		批准扩大一般授权以配发及发行发行人所购回之股份	753,910,610 股 (85.51%) 赞成, 127,772,808 股 (14.49%) 反对
5.	2022 年 股东特 别大会	考虑及批准人民币股份发行及特别授权	890,296,381 股 (97.78%) 赞成, 20,176,969 股 (2.22%) 反对
		考虑及批准授权董事会及其授权人士全权办理与人民币股份发行相关的一切事宜	890,296,381 股 (97.78%) 赞成, 20,176,969 股 (2.22%) 反对
		考虑及批准人民币股份发行前滚存利润分配的计划	900,388,532 股 (98.89%) 赞成, 10,084,818 股 (1.11%) 反对
		考虑及批准人民币股份发行后三年内稳定人民币股份股价预案	890,296,381 股 (97.78%) 赞成, 20,176,969 股 (2.22%) 反对
		考虑及批准人民币股份发行后三年利润分配政策及股东分红回报规划	900,394,532 股 (98.89%) 赞成, 10,078,818 股 (1.11%) 反对
		考虑及批准人民币股份发行募集资金的用途	893,411,995 股 (98.13%) 赞成, 17,061,355 股 (1.87%) 反对

	考虑及批准人民币股份发行后即期回报摊薄的补救措施	890,296,381 股 (97.78%) 赞成, 20,176,969 股 (2.22%) 反对
	考虑及批准人民币股份发行的承诺函及相应约束措施	890,296,381 股 (97.78%) 赞成, 20,176,969 股 (2.22%) 反对
	考虑及批准采纳股东大会议事规则	902,975,531 股 (99.18%) 赞成, 7,497,819 股 (0.82%) 反对
	考虑及批准采纳董事会议事规则	902,975,532 股 (99.18%) 赞成, 7,497,818 股 (0.82%) 反对
	授权任何董事或发行人高级管理人员执行及采取与上述普通决议案有关或使之生效的一切必要的行动, 并签署所有必要文件	893,591,994 股 (98.15%) 赞成, 16,881,356 股 (1.85%) 反对
	考虑及批准对发行人组织章程细则的建议修订, 授权发行人任何董事或高级管理人员执行及采取与此特别决议案有关或使之生效的一切	895,868,995 股 (98.40%) 赞成, 14,604,355 股 (1.60%) 反对

		必要的行动，并签署所有必要文件	
6.	2022 年 股东特 别大会	批准、确认及追认发行人于二零二二年六月二十九日与华虹无锡、上海华虹宏力、无锡锡虹联芯投资有限公司、大基金及国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司就将华虹无锡的注册资本自 1,800 百万美元增至约 2,536.85 百万美元而订立的注资协议及其项下拟进行之交易	703,006,697 股 (100.00%) 赞成，0 股 (0.00%) 反对
<b>二. 董事会会议</b>			
1.	2020 年 第一次 董事会	批准刊发 2019 年第四季度业绩等事项	全体出席董事 一致同意
2.	2020 年 第二次 董事会	批准刊发 2019 年全年业绩、批准不派发 2019 年期末股息、同意及批准 4 名董事于股东周年大会卸任及重选事宜、考虑召开下一届股东周年大会等事项	全体出席董事 一致同意
3.	2020 年 第三次	批准刊发 2020 年第一季度业绩等事项	全体出席董事 一致同意

	董事会		
4.	2020年第四次董事会	批准刊发2020年第二季度业绩、2020年中期业绩、期权归属等事项	全体出席董事 一致同意
5.	书面决议	董事辞任相关事宜	全体董事 一致同意
6.	2020年第五次董事会	批准刊发2020年第三季度业绩、批准发行人2020年预算调整、同意发行人2021年预算、同意发行人参与投资上海华虹投资发展有限公司等事项	全体出席董事 一致同意
7.	书面决议	关于非执行董事辞任及批准委任非执行董事相关事宜	全体董事 一致同意
8.	2021年第一次董事会	批准刊发2020年第四季度业绩等事项	全体出席董事 一致同意
9.	2021年第二次董事会	批准刊发2020年全年业绩、批准不派发2020年期末股息、同意及批准4名董事于股东周年大会卸任及重选事宜、考虑召开发行人下一届股东周年大会、审批回购授权建议、一般授权建议等事项	全体出席董事 一致同意

10.	2021年第三次董事会	批准刊发2021年第一季度业绩、批准发行人2021年预算调整等事项	全体出席董事 一致同意
11.	书面决议	关于战略投资相关事宜	全体董事 一致同意
12.	2021年第四次董事会	批准刊发2021年第二季度业绩、2021年中期业绩等事项	全体出席董事 一致同意
13.	书面决议	关于发行人投资支出相关事宜	全体董事 一致同意
14.	书面决议	关于股票期权计划相关事宜	全体董事 一致同意
15.	2021年第五次董事会	批准刊发2021年第三季度业绩、批准2022年财务预算等事项	全体出席董事 一致同意
16.	2022年第一次董事会	批准刊发2021年第四季度业绩等事项	全体出席董事 一致同意
17.	2022年第二次董事会	关于本次发行初步方案相关事宜	全体出席董事 一致同意
18.	2022年第三次董事会	批准刊发2021年全年业绩、批准不派发2021年期末股息、批准3名董事于股东周年大会卸任及重选事宜、审批回购授权建议、一般授权等事项	全体出席董事 一致同意

19.	2022年第四次董事会	批准刊发2022年第一季度业绩、本次发行方案相关事宜等事项	全体出席董事一致同意
20.	书面决议	高级管理人员任免相关事宜	全体董事一致同意
21.	书面决议	历史关连交易和修订年度上限相关事宜	全体董事一致同意
22.	2022年第五次董事会	关于华虹无锡增资事宜、批准成立独立董事委员会等事项	全体出席董事一致同意
23.	书面决议	香港股份过户登记处地址更改等事项	全体董事一致同意
24.	2022年第六次董事会	批准刊发2022年第二季度业绩；2022年中期业绩、期权归属等事项	全体出席董事一致同意
25.	书面决议	批准减持上海艾为战略配售股份等事项	全体董事一致同意
26.	书面决议	上海华虹宏力与华虹置业、华锦物业关连交易事宜等事项	全体董事一致同意

(3) 最近两年发行人董事的提名、任免情况

经本所律师核查，根据发行人于香港联交所的相关公开披露文件、发行人提供的文件资料、《香港法律审阅报告》及《备忘录》，发行人最近两年内的董事提名、任免情况如下：

1) 于2020年1月1日，发行人的董事会成员为：执行董事

张素心、唐均君，非执行董事杜洋、森田隆之、王靖、叶峻，独立非执行董事张祖同、王桂壘、叶龙蜚。前述董事均系由发行人董事会提名委员会提名，并经发行人股东大会/董事会选举产生。其中，张素心、王靖分别系华虹集团董事长及董事，唐均君系长期在华虹集团下属企业体系内工作；杜洋时任华芯投资管理有限责任公司总监、华芯投资管理有限责任公司上海分公司总经理，森田隆之时任发行人原主要股东之一 NEC 资深执行副总裁，叶峻时任上海联和董事兼总经理。

2) 2020 年 9 月，因工作安排原因，森田隆之辞任发行人非执行董事。

3) 2020 年 12 月，因工作安排原因，杜洋辞任发行人非执行董事，发行人董事会批准孙国栋担任非执行董事。孙国栋时任华芯投资管理有限责任公司总监兼上海分公司总经理。

(4) 发行人经营管理的实际运作情况

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、《公司章程》及华虹集团的说明，自发行人于香港联交所上市以来，华虹国际始终系发行人第一大股东。最近两年以来，发行人来自于华虹集团的非独立董事在发行人全体非独立董事中占比最高，发行人董事会主席亦系由华虹集团董事长担任；发行人高级管理人员由董事会聘任，华虹集团推荐的发行人高级管理人员均获得委任，发行人现任五名高级管理人员中，总裁唐均君、执行副总裁周卫平（主要负责市场销售）及倪立华（主要负责制造工程与安全管理，同时系发行人核心技术

人员)均系由华虹集团推荐。发行人经营管理中的重大事项系按照《香港上市规则》《公司章程》等规定相应履行股东大会、董事会决策程序,日常经营管理则主要在高级管理人员的主持下开展。

经本所律师核查,根据发行人于香港联交所公开披露的文件、发行人提供的文件资料、《香港法律审阅报告》及《备忘录》,最近两年以来,发行人涉及股本变动、股票期权激励计划、董事选举、年度财务报告等事项均在股东大会上获得华虹国际的赞成票并进而由股东大会审议通过;发行人涉及财务预算、派发股息、高级管理人员委任、战略投资等事项均在董事会会议上获得来自于华虹集团之董事的赞成票并进而由董事会会议审议通过。

经本所律师核查,根据《公司章程》、发行人提供的文件资料,发行人已建立覆盖生产、研发、销售、人事、财务等方面的职能部门及管理制度,发行人系在高级管理人员的主持下开展企业日常经营活动、具体实施股东大会、董事会决议及年度经营计划等。

- (5) 华虹半导体作为上海市国资委下属国有控股上市公司,上海市国资委已就华虹半导体控制权相关事宜出具说明文件

经本所律师核查,根据上海市国资委于2022年6月出具的《关于华虹集团及华虹半导体控制权有关情况的说明》,2018年10月中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)退出华虹集团后,华虹集团作为上海市国资委直接监管企业,其党的关系隶属上海市国资委党委,华虹集团董事长由上海市委任命,副董事长经上海市委备案同意后由

上海市国资委任命；其重要财务监管事项（包括财务预算、财务决算等）、重大投融资事项、改制重组等重大事项由上海市国资委直接进行监管或审批。据此，华虹半导体系华虹集团下属国有实际控制上市公司。

2. 认定华虹国际为控股股东、华虹集团为实际控制人的依据是否充分，控制权是否稳定及相应保障措施

经本所律师核查，根据发行人于香港联交所的相关公开披露文件、股东名册、最近两年发行人董事会会议文件并经华虹集团确认，自发行人于香港联交所上市以来，华虹国际始终系发行人单一持股比例最高的股东；华虹国际出席了发行人最近两年内所有股东大会，由华虹国际投赞成票的议案均获股东大会审议通过。

最近两年以来，发行人董事由董事会提名委员会提名，发行人董事会主席担任提名委员会主席；发行人董事会主席系由华虹集团董事长担任，其主持了最近两年内发行人所有的董事会会议，如在董事会会议表决中发生票数相等的情形，其将有权投第二票或决定票；发行人来自于华虹集团的非独立董事在发行人全体非独立董事中占比最高；来自于华虹集团的非独立董事均出席了最近两年内发行人所有的董事会会议，前述董事同意的议案均获发行人董事会通过。

最近两年以来，发行人的高级管理人员由发行人董事会委任，华虹集团推荐的发行人高级管理人员均获发行人委任，发行人现任五名高级管理人员中，总裁唐均君、执行副总裁周卫平（主要负责市场销售）及倪立华（主要负责制造工程与安全管理，同时系发行人核心技术人员）均系由华虹集团推荐。发行人系在包括高级管理人员在内的经营管理层的领导下开展企业日常经营活动。

华虹集团系华虹国际的唯一股东并持有华虹国际 100%股权并可对华虹国际进行控制。上海市国资委亦已于 2022 年 6 月出具《关于华虹集团及华虹半导体控制权有关情况的说明》，确认 2018 年 10 月中国电子退出华虹集团后，华虹集团作为上海市国资委直接监管企业，华虹半导体系华虹集团下属国有实际控制上市公司。

据此，本所律师认为，认定华虹国际为控股股东、华虹集团为实际控制人的依据充分，发行人控制权稳定。

经本所律师核查，发行人相关股东已采取如下措施进一步保障发行人控制权稳定：

- (1) 发行人控股股东华虹国际、实际控制人华虹集团已出具不主动放弃控股股东/实际控制人地位的承诺函，承诺其将长期持有发行人股份，发行人股票在上交所上市之日起 36 个月内，其不主动放弃发行人控股股东/实际控制人地位。
- (2) 发行人其他主要股东联和国际及其全资子公司 Wisdom Power、鑫芯香港已出具《关于不谋求控制权的承诺函》，具体如下：
  - 1) 联和国际已确认除其全资子公司 Wisdom Power 亦持有发行人股份外，其与发行人其他股东均不存在一致行动关系；并承诺自发行人股票在上交所科创板上市之日起 36 个月内，其将不会单独或采取与其他主体签订一致行动协议或通过任何其他安排，谋求或共同谋求发行人的控制权，亦不会协助或促使发行人实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求发行人的实际控制人地位。

- 2) Wisdom Power 已确认除其母公司联和国际亦持有发行人股份外，其与发行人其他股东均不存在一致行动关系；并承诺自发行人股票在上交所科创板上市之日起 36 个月内，其将不会单独或采取与其他主体签订一致行动协议或通过任何其他安排，谋求或共同谋求发行人的控制权，亦不会协助或促使发行人实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求发行人的实际控制人地位。
- 3) 鑫芯香港已确认其与发行人的其他股东均不存在一致行动关系；并承诺自发行人股票在上交所科创板上市之日起 36 个月内，其将不会主动谋求发行人的控制权，亦不会协助或促使发行人实际控制人之外的其他主体通过任何方式谋求发行人的实际控制人地位。

基于上述核查，本所律师认为，认定华虹国际为控股股东、华虹集团为实际控制人的依据充分，发行人控制权稳定，发行人相关股东已采取相应措施保障发行人控制权稳定。

- (二) 结合最近 2 年上海市国资委、上海联和、华虹集团、华虹国际、发行人等各层级间及跨层级间的重大事项决策、人事任免审批机制及实际履行情况，说明将上海市国资委认定为最终控制人而非实际控制人的规则依据及合理性，是否依据《企业国有资产法》的相关规定取得有关部门的明确授权，是否符合《科创板招股说明书格式准则》第四十一条的规定
  1. 《企业国有资产法》第十一条关于地方人民政府可授权其他部门、机构代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责的相关规定

《企业国有资产法》第十一条规定，国务院国有资产监督管理机构和地方人民政府按照国务院的规定设立的国有资产监督管理机构，根据本级人民政府的授权，代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。国务院和地方人民政府根据需要，可以授权其他部门、机构代表本级人民政府对国家出资企业履行出资人职责。

上述规定主要系指国有资产监督管理机构、其他部门、机构代表地方人民政府履行出资人职责时，需要取得地方人民政府的授权。国有资产监督管理机构等取得地方人民政府的授权后，亦可根据法律、法规以及规范性文件的规定将其权限范围内的事项进一步授权其他符合条件的监管企业履行相应职责；由政府直接授权特定企业履行出资人职责的模式则是近年来通过试点方式陆续开展的。前述授权模式在如下多项政策、规范性文件中亦有所体现：

序号	文件名称	成文日期	相关主要内容
(1)	中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见	2015年8月24日	国有资产监管机构依法对国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业履行出资人职责，并授权国有资本投资、运营公司对授权范围内的国有资本履行出资人职责……开展政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点。
(2)	国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见	2015年10月25日	(五)……将国有资产监管机构行使的投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利，授权国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业行使；……

			<p>(八) ……国有资产监管机构按照“一企一策”原则，明确对国有资本投资、运营公司授权的内容、范围和方式，依法落实国有资本投资、运营公司董事会职权。国有资本投资、运营公司对授权范围内的国有资本履行出资人职责， ……</p> <p>(十)开展政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的试点工作。中央层面开展由国务院直接授权国有资本投资、运营公司试点等工作。地方政府可以根据实际情况，选择开展直接授权国有资本投资、运营公司试点工作。</p>
(3)	国务院 关于 推进国有 资本投资、 运营公司 改革试点 的实施意 见	2018 年 7 月 14 日	按照国有资产监管机构授予出资人职责和政府直接授予出资人职责两种模式开展国有资本投资、运营公司试点。
(4)	国务院 关于 印发改革 国有资本 授权经营 体制方案 的通知	2019 年 4 月 19 日	二、优化出资人代表机构履职方式 ……出资人代表机构(指履行国有资本出资人职责的部门及机构)作为授权主体，要依法科学界定职责定位，加快转变履职方式，依据股权关系对国家出资企业开展授权放权。

2. 近年来国家及上海市层面陆续出台了关于以管资本为主推进国有

资产监管机构职能转变、将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业的规定

近年来，国家层面陆续出台了关于以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变、将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业的相关规定，相关规定中涉及前述事宜的主要内容如下：

文件名称	成文日期	相关主要内容
中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见	2015年8月24日	..... （十二）以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变。国有资产监管机构要准确把握依法履行出资人职责的定位，科学界定国有资产出资人监管的边界，建立监管权力清单和责任清单，实现以管企业为主向以管资本为主的转变。该管的要科学管理、决不缺位，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全；不该管的要依法放权、决不越位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业.....。
国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见	2015年10月25日	..... 二、推进国有资产监管机构职能转变 （三）准确把握国有资产监管机构的职责定位。国有资产监管机构.....专司国有资产监管，不行使政府公共管理职能，

		<p>不干预企业自主经营权。以管资本为主，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，更好服务于国家战略目标，实现保值增值……。</p> <p>（五）推进国有资产监管机构职能转变。……将国有资产监管机构行使的投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利，授权国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业行使；将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业；加强对企业集团的整体监管，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，由一级企业依法依规决策……。</p>
国务院办公厅关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知	2017年4月27日	<p>三、改进监管方式手段</p> <p>……</p> <p>（一）强化依法监管。严格依据公司法、企业国有资产法、企业国有资产监督管理暂行条例等法律法规规定的权限和程序行权履职。健全完善国有资产监管法规制度体系，建立出资人监管的权力和责任清单，清单以外的事项由企业依法自主决策。加强公司章程管理，规范董事会运作，严格选派、管理股东代表和董事、监事，注重通过国有企业法人治理结构依法履行出资人职责。</p>
国务院关于印	2019年	二、优化出资人代表机构履职方式

<p>发改革国有资本授权经营体制方案的通知</p>	<p>4月19日</p>	<p>……出资人代表机构（指履行国有资本出资人职责的部门及机构）作为授权主体，要依法科学界定职责定位，加快转变履职方式，依据股权关系对国家出资企业开展授权放权。</p> <p>（一）实行清单管理。制定出台出资人代表机构监管权力责任清单，清单以外事项由企业依法自主决策，清单以内事项要大幅减少审批或事前备案。将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，原则上不干预企业经理层和职能部门的管理工作，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。</p>
<p>国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见</p>	<p>2019年11月7日</p>	<p>一、以管资本为主转变国有资产监管职能</p> <p>……</p> <p>（一）转变监管理念，从对企业的直接管理转向更加强调基于出资关系的监管。坚持政企分开、政资分开，进一步厘清职责边界，依法对国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业履行出资人职责，将应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，确保该管的科学管理、决不缺位，不该管的依法放权、决不越位。</p>

	<p>.....</p> <p>二、突出管资本的重要内容</p> <p>深刻领会管资本的实质内涵，聚焦优化国有资本配置，管好资本布局；聚焦增强国有企业活力，管好资本运作；聚焦提高国有资本回报，管好资本收益；聚焦防止国有资产流失，管好资本安全；聚焦加强党的领导，管好国有企业党的建设。.....</p> <p>三、优化管资本的方式手段</p> <p>.....</p> <p>（十二）分类授权放权。加大授权放权力度，结合企业功能界定与分类、治理能力、管理水平等改革发展实际，根据国有资本投资、运营公司和其他直接监管企业的不同特点，有针对性地开展授权放权，充分激发微观主体活力。定期评估授权放权事项的执行情况和实施效果，建立动态调整机制。</p>
--	---

上述文件陆续提出以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变，国有资产监管机构要准确把握依法履行出资人职责的定位，科学界定国有资产出资人监管的边界，实现以管企业为主向以管资本为主的转变；重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全、加强党的领导；国有资产监管机构依法对国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业履行出资人职责；将国有资产监管机构行使的投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利，授权国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业行使；

将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业；加强对企业集团的整体监管，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，由一级企业依法依规决策。

上海市国资委亦出台了关于国有资产监管机构监管职能转变的相关规定，如在《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》（沪国资委法规〔2016〕393号）中，其第四条规定市国资委代表上海市人民政府对出资企业依法履行出资人职责，按照公司章程行使国有股东权利，不行使政府公共管理职能，不干预企业自主经营权。又如上海市人民政府于2019年9月发布的《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》中，其提出着力完善国资管理体制，实现以管企业为主向以管资本为主转变，开展国有资本授权经营体制改革试点，坚持授权与监管相结合、放活与管好相统一，进一步加大授权放权力度，推动国资监管机构内部职能的优化调整，修订完善权力清单和责任清单，将部分穿透式管理的审批权限予以下放。

2016年以来，国务院国有资产监督管理委员会还陆续出台了《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部令〔第32号〕，以下简称“32号令”）、《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令〔第36号〕，以下简称“36号令”）等规定，明确将部分产权管理等事项的审批权限赋予国家出资企业；32号令第六条亦明确规定，国有资产监督管理机构负责所监管企业的国有资产交易监督管理；国家出资企业负责其各级子企业国有资产交易的管理，定期向同级国资监管机构报告本企业的国有资产交易情况。

3. 华虹集团系上海市国资委直接监管企业，其核心人员由上海市国资委任命、重大事项由上海市国资委进行监管或审批，上海联和不参与对华虹集团的管理

- (1) 上海市国资委对华虹集团重大事项、重要人员的审批/任免情况

经本所律师核查，根据上海市国资委于 2022 年 6 月出具的《关于华虹集团及华虹半导体控制权有关情况的说明》，2018 年 10 月中国电子退出华虹集团后，华虹集团作为上海市国资委直接监管企业，其党的关系隶属上海市国资委党委，华虹集团董事长由上海市委任命，副董事长经上海市委备案同意后由上海市国资委任命；其重要财务监管事项（包括财务预算、财务决算等）、重大投融资事项、改制重组等重大事项由上海市国资委直接进行监管或审批。

经本所律师核查，上海市国资委为进一步贯彻落实十八届三中全会以及《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》精神，坚持以市场化为导向，以管资本为主履行出资人职责，曾于 2014 年 6 月发布《上海市国资委管好资本、服务企业履职清单（试行）》，其中明确规定履职清单内事项的操作依照相关法律法规及国资监管规定执行；履职清单外的企业日常经营管理事项，由企业依照相关法律法规、国资监管规定及公司章程自主决策。此后，上海市国资委分别于 2017 年、2020 年对前述履职清单进行了修订。

根据《上海市国资委管好资本、服务企业履职清单（2020 版）》，华虹集团需由上海市国资委事前审批/备案的重大

事项主要包括：（1）改制重组管理事项（包括华虹集团的改制、合并、分立、解散、破产等）；（2）章程制定与修改；（3）特定国有股权内部整合事项（包括需由国有资产监督管理机构审批的企业国有产权无偿划转、企业国有产权非公开协议转让、国有股东与上市公司资产重组、国有股东非公开协议转让上市公司股份、国有股东无偿划转上市公司股份等）；（4）国有资本权益变动事项（包括国有企业资本金变动、不实资产核销、国有股东控股上市公司吸收合并等）；（5）国有股权确权事项（包括国有股东证券账户标识管理、企业国有资产产权界定、国家出资企业产权登记等）；（6）特定股权转让受让事项（包括需由国有资产监督管理机构审批的国有股东通过证券交易系统转让上市公司股份、国有股东公开征集转让、国有股东间接转让上市公司股份、国有股东发行可交换公司债券、国有股东受让上市公司股份）；（7）法定代表人经营业绩考核和领导人员薪酬管理（包括对市管企业领导人员实施经营业绩考核、决定薪酬结构和水平等）；（8）财务预算事项；（9）财务决算事项；（10）企业领导人员任免及外部董事、外派监事委派事项（包括市国资委监管企业领导班子成员任免等）；（11）特定国有资产评估事项（包括需由国有资产监督管理机构进行的资产评估项目的核准/备案）；（12）其他需要国有资产监督管理机构审批/备案的事项。

(2) 上海联和不参与对华虹集团的管理

经本所律师核查，根据上海联和于 2022 年 6 月出具的《确认函》，自 2018 年 10 月中国电子退出华虹集团后，华虹集团系作为上海市国资委直接监管企业。

经本所律师核查，根据华虹集团提供的文件资料及出具的说明，上海联和等上海市属国有企业系根据上海市相关主管部门对华虹集团的战略定位及战略布局持有华虹集团股权；2018年10月中国电子退出华虹集团后，华虹集团作为上海市国资委直接监管企业，上海联和不参与对华虹集团的经营管理，在由上海联和持股的期间，华虹集团的重大事项亦系由华虹集团直接报请上海市国资委审批，未经由上海联和审批或转报。

4. 上海市国资委不直接参与对发行人的经营管理，华虹集团、华虹国际通过股东大会、董事会等机制参与华虹半导体重大事项等决策

(1) 发行人重大事项的审批/决策情况

经本所律师核查，根据 32 号令、36 号令、《关于印发〈国有控股上市公司（境外）实施股权激励试行办法〉的通知》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等的相关规定及华虹集团的说明，上海市国资委不直接参与对发行人的经营管理，主要系根据《企业国有资产交易监督管理办法》《上市公司国有股权监督管理办法》《关于印发〈国有控股上市公司（境外）实施股权激励试行办法〉的通知》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等国有资产监督管理的规定对其未下放权限的涉及发行人及其控股子公司的特定重大事项进行审批，前述事项主要包括：（1）发行人发行证券并导致国有股东持股比例低于合理持股比例的事项；（2）特定国有股权内部整合事项（包括需由国有资产监督管理机构审批的企业国有产权无偿划转、企业国有产权非公开协议转让、国有企业以非公开协议方式增资、国有股东与上市公司资产重组等）；（3）

特定国有资产评估事项（包括需由国有资产监督管理机构进行的资产评估项目的核准/备案）；（4）上海市地方国有控股上市公司股权激励等。最近两年以来，发行人由上海市国资委审批/备案的重大事项主要包括本次发行、华虹无锡以非公开协议方式增资及相关评估结果备案等。

经本所律师核查，根据华虹集团的说明及华虹集团《投资管理办法》的相关规定，华虹集团对子公司通过派出董事、监事行使股东权利，包括参与股东会、董事会决策，进行经营管理事项的监督管理等；子公司应根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，召集、召开股东会、董事会和监事会，确保华虹集团股东代表、派出董事或监事行使对子公司经营管理重大事项的知情权、决策权和质询权。

经本所律师核查，根据发行人于香港联交所公开披露的文件、发行人提供的文件资料、《公司章程》《香港法律审阅报告》《备忘录》及华虹集团的说明，发行人经营管理中的重大事项系按照《香港上市规则》《公司章程》等规定相应履行董事会、股东大会决策程序，华虹集团、华虹国际通过其推荐的董事、派出的股东代表等，经由董事会、股东大会会议等形式，参与对发行人重大事项的决策。最近两年以来，发行人涉及股本变动、股票期权激励计划、董事选举、年度财务报告等事项均在股东大会上获得华虹国际的赞成票并进而由股东大会审议通过；发行人涉及财务预算、派发股息、高级管理人员委任、战略投资等事项均在董事会会议上获得来自于华虹集团之董事的赞成票并进而由董事会会议审议通过。

(2) 发行人董事、高级管理人员的任免情况

经本所律师核查，根据《公司章程》《香港法律审阅报告》《备忘录》及华虹集团的说明，发行人董事、高级管理人员的任免未经由上海市国资委审批；发行人董事系由发行人董事会提名委员会提名，最近两年以来，发行人来自于华虹集团的非独立董事在发行人全体非独立董事中占比最高，发行人董事会主席亦系由华虹集团董事长担任；发行人高级管理人员由发行人董事会委任，最近两年以来，华虹集团推荐的发行人高级管理人员均获得委任，发行人现任五名高级管理人员中，总裁唐均君、执行副总裁周卫平（主要负责市场销售）及倪立华（主要负责制造工程与安全管理，同时系发行人核心技术人员）均系由华虹集团推荐。

- (3) 上海市国资委已出具说明文件确认华虹半导体系华虹集团下属国有实际控制上市公司

经本所律师核查，根据上海市国资委于 2022 年 6 月出具的《关于华虹集团及华虹半导体控制权有关情况的说明》，华虹半导体系华虹集团下属国有实际控制上市公司。

5. 《科创板招股说明书格式准则》第四十一条关于实际控制人披露的要求及发行人实际控制人的认定

根据《科创板招股说明书格式准则》第四十一条的规定，实际控制人应披露至最终的国有控股主体、集体组织、自然人等。经本所律师核查，认定发行人的实际控制人为华虹集团未违反前述规定，主要理由如下：

- (1) 华虹集团具有对发行人的实际控制权

- 1) 在股权结构及股东大会表决情况方面，自发行人于香港联交所上市以来，华虹国际始终系发行人单一持股比例最高的股东；最近两年以来，华虹国际出席了发行人所有股东大会，由华虹国际投赞成票的议案均获股东大会审议通过。
- 2) 在董事人选及董事会表决情况方面，最近两年以来，发行人来自于华虹集团的非独立董事在发行人全体非独立董事中占比最高；发行人董事会主席亦系由华虹集团董事长担任，其主持了最近两年内发行人所有的董事会会议，如在董事会会议表决中发生票数相等的情形，其将有权投第二票或决定票。最近两年以来，发行人来自于华虹集团之董事均出席了发行人所有董事会会议，前述董事同意的议案均获发行人董事会通过。
- 3) 在董事提名方面，发行人董事由董事会提名委员会提名，最近两年以来，发行人董事会主席（同时亦为华虹集团董事长）担任提名委员会主席；任何提名委员会会议上提出的问题须以出席会议的委员或其替任委员的多数票作出决定；如果票数相等，则委员会主席将有权投第二票或决定票。
- 4) 在发行人高级管理人员的任免方面，发行人高级管理人员由发行人董事会委任，最近两年以来，华虹集团推荐的发行人高级管理人员均获发行人委任，发行人现任五名高级管理人员中，总裁唐均君、执行副总裁周卫平（主要负责市场销售）及倪立华（主要负责制造工程与安全工程）均系由华虹集团推荐。

- 5) 在发行人的重大事项决策及日常经营管理方面，华虹集团、华虹国际通过其推荐的董事、派出的股东代表等，经由董事会、股东大会会议等形式，参与对发行人重大事项的决策；发行人的日常经营管理主要在高级管理人员的主持下开展。
- (2) 国有资产监管机构不断推进监管职能向以管资本为主转变，上海市国资委系作为国有资产监管机构依法对华虹集团履行出资人职责，其不直接参与对发行人的经营管理，发行人董事、高级管理人员等重要人员的任免亦未经由上海市国资委审批

近年来陆续出台的《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》《国务院办公厅关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》《国务院关于印发改革国有资本授权经营体制方案的通知》《国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》等文件，陆续提出以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变，国有资产监管机构要准确把握依法履行出资人职责的定位，科学界定国有资产出资人监管的边界，实现以管企业为主向以管资本为主的转变；重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全、加强党的领导；国有资产监管机构依法对国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业履行出资人职责；将国有资产监管机构行使的投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利，授权国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业行使；将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业；加强对企业集团的整体

监管，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，由一级企业依法依规决策（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第一（二）2项）。

经本所律师核查，根据上海市国资委陆续发布的管好资本、服务企业履职清单、《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》及于2022年6月出具的《关于华虹集团及华虹半导体控制权有关情况的说明》、华虹集团出具之说明，上海市国资委坚持以市场化为导向、以管资本为主履行出资人职责，不干预企业的自主经营权；华虹集团系上海市国资委直接监管企业，上海市国资委对华虹集团重大事项、人事任免等方面的审批系其对华虹集团履行出资人职责的体现；上海市国资委不直接参与对发行人的经营管理，发行人董事、高级管理人员等重要人员的任免亦未经由上海市国资委审批。

- (3) 上海市国资委已出具说明文件确认华虹半导体系华虹集团下属国有实际控制上市公司

经本所律师核查，根据上海市国资委于2022年6月出具的《关于华虹集团及华虹半导体控制权有关情况的说明》，华虹半导体系华虹集团下属国有实际控制上市公司。

- (4) 上述关于发行人实际控制人的认定亦未违反《企业国有资产法》第十一条的规定

《企业国有资产法》第十一条主要系规定在国有资产监督管理机构、其他部门、机构代表地方人民政府履行出资人职责时，需要取得地方人民政府的授权；该规定并未限制将国有资产监督管理机构权限范围内的事项依法进一步授权其他

符合条件的监管企业履行相应职责；近年来陆续出台的《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》《国务院国资委关于以管资本为主加快国有资产监管职能转变的实施意见》等文件陆续提出以管资本为主推进国有资产监管机构职能转变，将国有资产监管机构行使的投资计划、部分产权管理和重大事项决策等出资人权利，授权国有资本投资、运营公司和其他直接监管的企业行使；国务院国有资产监督管理委员会及财政部发布的 32 号令亦明确规定，国有资产监督管理机构负责所监管企业的国有资产交易监督管理，国家出资企业负责其各级子企业国有资产交易的管理（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第一（二）1 项）。

基于上述核查，本所律师认为，上海市国资委系代表上海市人民政府对华虹集团履行出资人职责并对其行使国有资产监督管理职能，未认定上海市国资委为发行人的实际控制人符合国资监管机构职能转变的相关文件精神，亦与发行人经营管理实际相符，认定依据充分，具有合理性；上海市国资委已出具相关说明文件，确认华虹集团系其直接监管企业、华虹半导体系华虹集团下属国有实际控制上市公司，相关认定未违反《企业国有资产法》第十一条及《科创板招股说明书格式准则》第四十一条的规定。

(三) 上海联和将所持华虹集团股份转让给上海市国资委并于 2020 年 12 月才完成工商变更登记的原因，发行人最近 2 年实际控制人是否发生变动

1. 上海联和将所持华虹集团股份转让给上海市国资委并于 2020 年 12 月才完成工商变更登记的原因

经本所律师核查，根据《备忘录》、华虹集团出具的说明，上海联和将所持华虹集团股份转让给上海市国资委的主要过程如下：

- (1) 2020年6月8日，上海市国资委出具《关于上海联和投资有限公司所持上海华虹（集团）有限公司全部股权无偿划转至市国资委的通知》，决定将上海联和持有的华虹集团全部股权无偿划转至上海市国资委，前述划转以2019年12月31日为基准日；同日，上海市国资委出具《关于市国资委所持上海华虹（集团）有限公司10%股权无偿划转至上海国际集团有限公司的通知》《关于市国资委所持上海华虹（集团）有限公司10%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的通知》《关于市国资委所持上海华虹（集团）有限公司10%股权无偿划转至上海仪电（集团）有限公司的通知》，决定将上海市国资委持有的华虹集团30%股权分别无偿划转予上海国盛、上海国际及仪电集团，前述划转以2020年1月1日为基准日（与上海联和股权无偿划转事宜以下合称“拟议重组”）。
- (2) 根据发行人提供的文件资料及《备忘录》，发行人作为香港联交所上市公司，其间接股东华虹集团上述股权无偿划转事宜可能涉及上海市国资委的强制要约义务；各方认为上述股权无偿划转符合香港规则项下可申请豁免强制要约义务的情形。HSF接受上海市国资委授权的华虹集团的委托以及华虹集团其他股东的正式授权，于2020年10月8日代为向香港证监会提交强制要约豁免申请。前述豁免申请所涉具体情况如下：
  - 1) 香港法规下关于强制要约的相关主要规定

- a. 《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”）第 26.1 条关于强制要约的总体规定

根据《收购守则》第 26.1 条的相关规定，除非获执行人员（根据《收购守则》的释义，指香港证监会企业融资部的执行董事或任何获其转授权力的人，下同）授予豁免，否则当：（a）任何主体不论是否透过在一段期间内的一系列交易而取得一家公司 30%或以上的投票权时；（b）两个或以上一致行动而持有一家公司的投票权合计不足 30%的主体中，任何一个或以上的主体取得投票权，结果使其合计持有该公司投票权的百分比增至 30%或以上时；……该主体（以下简称“收购方”）须根据《收购守则》第 26 条的规定，向该公司每类权益股本（不论该类权益股本是否附有投票权）的持有人，以及向收购方或与其一致行动的人持有的任何一类有投票权的非权益股本的股份持有人作出要约。

- b. 《收购守则》第 26.1 条注释 6（a）关于收购方从另一成员取得投票权时的强制要约及其豁免之主要规定

根据《收购守则》第 26.1 条注释 6（a）关于收购方从另一成员取得投票权的相关规定，如某一致行动集团持有一家公司合计 30%或以上的投票权，而该集团的个别成员因向另一成员取得投票权而持有 30%或以上的投票权，或如其持有量已介乎 30%至

50%之间，而在任何 12 个月期间再取得超过 2%投票权，通常便会产生作出要约的责任。…执行人员在考虑是否豁免发出要约的义务时将考虑的因素包括：

(i) 该集团的领导者或最大的个别持股量是否已有所改变及该集团内持有量的均势是否有重大改变；

(ii) 为取得该等股份所支付的价格；及

(iii) 一致行动人之间的关系及其采取一致行动的时长。

如果出现以下情况，执行人员通常会豁免取得该等投票权的收购方履行全面要约义务：

(i) 取得该等投票权的收购方为由一家公司及其子公司组成的公司集团的成员，且该收购方从该公司集团的另一成员处取得了投票权；…

- c. 《收购守则》第 26.1 条注释 8 关于连锁关系原则下可能仍需履行强制要约义务的相关规定

根据《收购守则》第 26.1 条注释 8 关于连锁关系原则的相关规定，某一主体或一致行动的一组主体在取得一家公司（该公司无需为适用《收购守则》的公司）的法定控制权（statutory control，指一家公司对其子公司的控制程度）后，或可能因此取得或巩固对另一家公司的控制权（根据《收购守则》的释义，控制权的定义为“除文意另有所指，控制权应被视为指持有或合计持有一家公司的 30%或以上的投票权，而不论该持有量或合计持有量是否构成

实际控制权”），原因是第一家公司本身直接或通过中间公司间接持有第二家公司的控制性权益，或第一家公司持有的投票权在与该主体或该组主体已经持有的投票权相加后能够取得或巩固对第二家公司的控制权。在上述情况下，执行人员通常不会要求根据《收购守则》第 26 条发出要约，除非出现以下情况之一：

(a) 在第二家公司的持有量构成第一家公司的重大部分。在衡量该等情况时，执行人员将会考虑若干因素，包括（如适用）各自公司的资产和利润。就此等相对价值而言，60%或以上将通常会视为构成重大部分；或

(b) 取得第一家公司控制权的一项主要目的是取得对第二家公司的控制权……。

2) 申请文件中关于上海市国资委可被豁免强制要约义务的理由

a. 发行人最终控股股东（ultimate controlling shareholder）未发生变更

鉴于在拟议重组前后，上海市国资委通过其全资子公司上海联和和华虹集团间接持有发行人 42% 的股份，拟议重组不涉及发行人最终控制人（ultimate controller）的变更，发行人的控制权亦未因拟议重组而发生任何巩固。

b. 拟议重组符合《收购守则》第 26.1 条注释 6 (a) 规定之可以豁免强制要约义务的情形

考虑到上海市国资委对于上海联和、仪电集团、上海国盛、上海国际和华虹集团的控制，上海市国资委、上海联和、仪电集团、上海国盛、上海国际、华虹集团按照《收购守则》之目的构成一致行动。根据《收购守则》第 26.1 条注释 6 (a) 中列出的因素，鉴于 (i) 拟议重组完成前后，一致行动集团的领导者（即上海市国资委）保持不变；(ii) 拟议重组将以零对价进行；及 (iii) 一致行动集团的成员在递交豁免申请前已经一致行动了很长一段时间，并非为规避《收购守则》项下的强制要约义务而短期成立，因此上海市国资委对发行人股东提出强制要约的义务应予豁免。

此外，《收购守则》第 26.1 条注释 6 (a) 第三段规定，如收购方为由一家公司及其子公司组成的公司集团的成员，且该收购方从该公司集团的另一成员处取得了投票权，则执行人员通常会豁免该收购方的全面要约义务。拟议重组属于前述规定的范围，其中的收购方，即上海市国资委，是由其本身及其子公司组成之一致行动集团的成员，并将从该一致行动集团的另一成员即上海联和处取得投票权。

- c. 拟议重组不属于《收购守则》第 26.1 条注释 8 规定之仍需履行强制要约义务的情形

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计的总资产、净资产和总收入在华虹集团中的占比约为 36.70%、

45.60%和 49.37%，均低于 60%，因此发行人在华虹集团中未构成《收购守则》第 26.1 条注释 8（a）所述的重大部分；上海市国资委在拟议重组前已拥有对发行人的最终控制权（ultimate control），拟议重组的主要目的不是取得发行人的控制权，因此强制要约义务未根据《收购守则》第 26.1 条注释 8（b）的规定被触发。

香港证监会于 2020 年 10 月 14 日在信函中确认，上海市国资委不会因《收购守则》第 26.1 条的规定就拟议重组产生对发行人股份发出强制要约的义务。

综上所述，上海市国资委被豁免于《收购守则》项下的强制要约义务主要系由于：（1）其作为长期保持一致行动的一致行动集团领导者，在拟议重组中系自一致行动集团的其他成员处无偿取得了投票权，且拟议重组未导致一致行动集团领导者发生变更；（2）发行人在华虹集团中未构成《收购守则》上述规定所述的重大部分；（3）上海市国资委在拟议重组前已拥有对发行人的最终控制权（ultimate control），拟议重组的主要目的不是取得发行人的控制权。就控制权的含义而言，《收购守则》对“控制权（Control）”的定义作出了明确规定，即除文意另有所指，控制权应被视为指持有或合计持有一家公司 30%或以上的投票权，而不论该持有量或合计持有量是否构成实际控制权。

据此，本所律师认为，上海市国资委系华虹集团的控股股东，认定发行人的实际控制人为华虹集团、未认定上海市国资委为发行人实际控制人与上述强制要约豁免申请及相关文件的内容不存在矛盾。

(3) 在取得香港证监会的上述回复后，华虹集团开始着手准备上述股权无偿划转事宜的内部决策程序，华虹集团股东会于2020年11月16日作出《关于公司股权划拨的决议》《关于公司股权划拨、公司章程变更和董、监事变更的决议》，并于2020年12月17日最终办理完成相应的变更登记。

## 2. 发行人最近2年实际控制人是否发生变动

经本所律师核查，自发行人于香港联交所上市以来，华虹国际始终系发行人单一持股比例最高的股东，华虹国际出席了发行人最近两年内所有股东大会，由华虹国际投赞成票的议案均获股东大会审议通过；最近两年以来，发行人来自于华虹集团的非独立董事在发行人全体非独立董事中占比最高，发行人董事会主席亦系由华虹集团董事长担任，前述董事均出席了最近两年内发行人所有董事会会议，来自于华虹集团之董事同意的议案均获发行人董事会通过；发行人的高级管理人员由发行人董事会委任，最近两年以来，华虹集团推荐的发行人高级管理人员均获发行人委任，发行人现任五名高级管理人员中，总裁唐均君、执行副总裁周卫平（主要负责市场销售）及倪立华（主要负责制造工程与安全管理，同时系发行人核心技术人员）均系由华虹集团推荐，发行人系在包括高级管理人员在内的经营管理层的领导下开展企业日常经营活动。华虹集团系华虹国际的唯一股东并持有华虹国际100%股权并可对华虹国际进行控制（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第一（一）项）。据此，华虹集团系发行人的实际控制人。

经本所律师核查，根据华虹集团的工商登记资料及本所律师对国家企业信用信息公示系统公开信息的查询，最近两年内，华虹集团上层股权架构曾发生变动，主要情况为：

于 2020 年 1 月 1 日，由上海市国资委持有 100% 股权的上海联和、上海国盛、上海国际、仪电集团依次分别持有华虹集团 81.34% 股权、8.48% 股权、8.48% 股权、1.71% 股权。2020 年 3 月，华虹集团股东会作出决议，同意上海市国资委增资入股华虹集团。前述增资完成后，上海联和持有华虹集团 80.22% 股权，上海国盛及上海国际分别持有华虹集团 8.36% 股权，仪电集团持有华虹集团 1.69% 股权，上海市国资委持有华虹集团 1.37% 股权。2020 年 6 月 8 日，上海市国资委出具关于华虹集团股权无偿划转相关事宜的批复，将上海联和所持有的华虹集团全部股权无偿划转予上海市国资委（前述划转以 2019 年 12 月 31 日为基准日），并将上海市国资委持有的华虹集团 30% 股权分别无偿划转予上海国盛、上海国际及仪电集团（前述划转以 2020 年 1 月 1 日为基准日）；前述股权无偿划转完成后，上海市国资委持有华虹集团 51.59% 股权，上海国际及上海国盛分别持有华虹集团 18.36% 股权，仪电集团持有华虹集团 11.69% 股权。前述股权无偿划转事宜已于 2020 年 12 月在市场监督管理部门办理完毕相应的变更登记手续。

经本所律师核查，根据上海市国资委于 2022 年 6 月出具的《关于华虹集团及华虹半导体控制权有关情况的说明》、上海联和于 2022 年 6 月出具的《确认函》及华虹集团的说明，2018 年 10 月中国电子退出华虹集团后，华虹集团作为上海市国资委直接监管企业，上海联和不参与对华虹集团的经营管理，在由上海联和持股的期间，华虹集团的重大事项亦系由华虹集团直接报请上海市国资委审批，未经由上海联和审批或转报。上海联和 2020 年退出华虹集团未导致前述管理方式发生变化（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第一（二）项）。

基于上述核查，本所律师认为，发行人最近两年实际控制人未发生变化。

- 二. 审核问询问题 2. 关于同业竞争：根据申报材料：（1）发行人与控股股东华虹集团控制的华力微、华力集（以下简称上海华力）均存在晶圆代工业务，发行人定位于特色工艺，上海华力定位于先进逻辑工艺，双方的产品服务在工艺技术方向上存在本质不同。发行人存在逻辑与射频工艺平台，且报告期内逻辑与射频产品收入增长，与上海华力均拥有 12 英寸晶圆厂，在产品类型、工艺节点（55nm）、客户、供应商等方面存在重合；（2）发行人通过子公司上海华虹宏力间接持有华力微 6.34%的股权，上海华虹宏力向华力微委派一席董事和一席监事，发行人与上海华力间存在董事、监事的交叉任职，华力微生产经营用主要场所向上海华虹宏力租赁，并由上海华虹宏力代收代付水电物业费，华力微向上海华虹宏力提供 65nm/55nm CMOS 工艺技术的开发及许可；（3）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业中，上海集成向上海华虹宏力提供 65nm CMOS 工艺技术，保荐工作报告提到“上海华虹科技发展有限公司主营业务涉及集成电路芯片制造及技术开发”；（4）华虹集团及华虹国际已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺未来如构成重大不利影响的同业竞争，将该等商业机会优先提供予发行人，或由发行人在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权。公开信息显示：2014 年，华虹集团曾在港交所相关文件中披露，“华虹集团旗下其他资产不会从事与华虹半导体现有业务具有竞争关系的业务”“并在未来的合适时机，将上海华力注入华虹半导体”等内容。请发行人说明：（1）上海华力及发行人在特色工艺、先进逻辑工艺方面的覆盖情况及具体差异，逻辑与射频业务是否存在重合，双方是否存在相同或类似业务，华虹集团对发行人、上海华力的业务定位及未来规划；（2）结合报告期内发行人与上海华力在工艺节点、工艺平台、代工产品、客户供应商等方面的重合情况，重合客户供应商交易的必要性、公允性及占比情况等，分析二者业务是否具有竞争性、替代性，是否构成同业竞争；（3）结合华力微掌握 65nm/55nm CMOS 工艺技术及产业化情况、上海华力与发行人在研产品/项目情况、发行人募投项目情况等，分析双方是否存在潜在的同业竞争，双方避免潜

在同业竞争的措施及其有效性、可行性；（4）结合报告期内发行人与上海华力竞争业务的收入、毛利及占比情况、未来发展趋势等，以及《科创板股票发行上市审核问答》问题 4 的要求，充分论证是否构成重大不利影响的同业竞争及相应的清理措施；（5）结合上海华力的股权结构，发行人与上海华力在房屋租赁、人员交叉任职、技术及业务合作等方面的情况，说明是否影响发行人与上海华力的独立性及相应保障措施，是否存在利益输送或让渡商业机会的情形；（6）发行人控股股东、实际控制人下属企业是否存在未披露的与发行人从事相同或类似业务的情形，控股股东及实际控制人出具承诺的履行情况，是否具有可行性、可操作性及实际约束力，发行人的同业竞争情况及相关承诺是否与联交所的公开披露信息存在冲突；（7）结合以上说明内容完善招股说明书重大事项提示及同业竞争事项的披露。请保荐机构、发行人律师对上述事项及控股股东、实际控制人下属企业与发行人是否存在同业竞争以及重大不利影响的同业竞争，是否符合《首发业务若干问题解答》问题 15、《科创板股票发行上市审核问答》问题 4 的规定进行核查，确保核查的充分完整性，并发表明确核查意见。

（一）上海华力及发行人在特色工艺、先进逻辑工艺方面的覆盖情况及具体差异，逻辑与射频业务是否存在重合，双方是否存在相同或类似业务，华虹集团对发行人、上海华力的业务定位及未来规划

1. 上海华力及发行人在特色工艺、先进逻辑工艺方面的覆盖情况及具体差异

（1） 半导体制造工艺分类

经本所律师核查，根据发行人的说明，先进逻辑工艺按照摩尔定律的规律，不断追求工艺节点的缩小，从而满足客户对于算力和速度提高、动态功耗降低的需求，同时需要更为先

进的设备和材料支持，其面对的典型应用是需要高算力的 CPU 和 GPU 等。与先进逻辑工艺相比，特色工艺在材料、工艺、器件结构与功能等方面均存在不同，其不单纯追求按照摩尔定律的规律缩小工艺节点，而是需要满足现实世界不同的物理需求，比如信号的感应、放大、转换、分隔、输出等，其产品线丰富程度较高，结构有特定的复杂性，需要在基础工艺之上投入大量的研发资源和时间成本，面对的典型应用也十分丰富。

(2) 上海华力及发行人在特色工艺、先进逻辑工艺方面的具体情况

1) 总体定位差异

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、招股说明书（申报稿）、发行人及华虹集团的说明，发行人和上海华力是华虹集团基于半导体制造行业的不同技术发展路径所设立的两大业务板块，发行人定位于特色工艺晶圆代工，上海华力定位于先进逻辑工艺晶圆代工，双方的基本情况如下：

主体名称	发行人		上海华力	
发展定位	特色工艺的领先者		先进逻辑工艺的追赶者	
厂区	8 英寸厂	12 英寸厂	12 英寸厂 (华力微)	12 英寸厂 (上海华力集成电路制造有限公司，以下简称“华力集”)

主要工艺节点	90nm 及以上	65/55nm 及以上	65/55nm 及以下	28nm
特色工艺覆盖情况	涉及		部分涉及	
先进逻辑工艺覆盖情况	不涉及		涉及	

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、招股说明书（申报稿）、发行人及华虹集团的说明，发行人与上海华力的工艺发展历程和发展方向存在显著差异：发行人以 8 英寸厂 0.35 μm 及以上的工艺节点为起点，专注发展特色工艺，2019 年发行人的工艺节点发展至 65/55nm；而上海华力 2010 年成立时，以 12 英寸 65/55nm 的工艺节点为基础和起点发展先进逻辑工艺，目前已将工艺节点推进至 28nm。

2) 各工艺节点上双方逻辑/特色工艺、工艺平台的具体分布情况

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团提供的文件资料及说明，发行人从事晶圆代工的主要工艺节点为 0.35μm - 65/55nm，主要覆盖五大工艺平台，即功率器件、模拟与电源管理、独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频；上海华力（包括华力微及华力集）的主要工艺节点为 65/55nm - 28nm，其中，华力微的 65/55nm 工艺主要覆盖三大工艺平台，即独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频，华力集的 28nm 工艺主要为先进逻辑工艺平台。双方在相关主要工艺节点上的主要工艺平台分布情况如下表所示：

工艺节点	主要工艺平台	
	发行人	上海华力
28nm	-	先进逻辑工艺
65/55nm	独立式非易失性存储器	独立式非易失性存储器
	嵌入式非易失性存储器	嵌入式非易失性存储器
	逻辑与射频	逻辑与射频
	模拟与电源管理	-
65/55nm 以上	五大工艺平台	-

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团提供的文件资料及说明，发行人涉及的五大工艺平台均主要为特色工艺；上海华力层面，华力集在 28nm 工艺节点主要定位先进逻辑工艺，华力微在 65/55nm 工艺节点涉及独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器和逻辑与射频三大工艺平台，其中独立式非易失性存储器及嵌入式非易失性存储器为特色工艺平台。双方业务均涉及的逻辑与射频工艺平台包括基础逻辑工艺，发行人系在此基础上通过器件优化升级形成特色工艺。

2. 双方存在重合工艺节点及工艺平台，但不构成竞争

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、发行人的说明，报告期内，发行人和上海华力存在重合的工艺平台即独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频，但双方工艺平台的代工能力存在差异，不构成竞争，具体如下：

(1) 双方在不同工艺节点上的代工能力存在差异

1) 客户设计的产品只能通过特定的工艺节点实现

经本所律师核查，根据发行人的说明，对晶圆代工企业而言，工艺节点是晶圆制造的生产线中能加工的最小尺寸；对芯片设计公司而言，工艺节点是设计中采用的最小设计尺寸单位。发行人及上海华力从事晶圆代工服务，主要客户为芯片设计公司，该等客户在产品定义阶段就会确定芯片产品所使用的线宽，并按照确定的线宽以及对应工艺的设计包进行设计，晶圆代工企业根据客户确定的线宽采用相应工艺节点的生产线进行生产。

2) 重合工艺平台在不同工艺节点上的具体差异

a. 独立式非易失性存储器

经本所律师核查，根据发行人的说明，在独立式非易失性存储器平台，主要代工产品为 NOR Flash，随着工艺节点的前进，产品存储单元面积不断缩小，存储容量和工作温度的上限不断提升。工艺节点在 90nm 及以上的相关产品以存储容量小于 16Mb 为主，主要应用于一般消费类产品；而工艺节点在 65/55nm 及以下的相关产品以存储容量大于 32Mb 为主，主要应用于高端消费类、工控与汽车等领域的产品。

b. 嵌入式非易失性存储器

经本所律师核查，根据发行人的说明，在嵌入式非易失性存储器平台，主要代工产品为 MCU，工艺节点在 90nm 及以上的相关产品以追求超低漏电（超低静态功耗）为主，运算速度较低，通常应用于小于 100MHz、长待机模式的产品，如智能穿戴、胎压监测、各类表计等；而工艺节点在 65/55nm 及以下的相关产品则更加追求高速运算等性能的提升，通常应用于大于 100MHz、常运行模式的产品，如工业控制、汽车域控、智能家电等。

c. 逻辑与射频

经本所律师核查，根据发行人的说明，在逻辑与射频平台，主要代工产品为逻辑/视频芯片，工艺节点在 90nm 及以上的相关产品以低速应用为主，如无线键鼠、收音机等产品；而工艺节点在 65/55nm 及以下的相关产品则更加追求主频等性能的提升，如应用于蓝牙、WiFi 的产品。

(2) 双方在重合工艺节点上的代工能力亦存在差异

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团提供的文件资料、发行人的说明，在 65/55nm 工艺节点，发行人与华力微重合的工艺平台为独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器、逻辑与射频；综合考虑代工产品的工艺技术和性能、性价比/成本、资源配置（产能和各项配套服务）等因素，双方代工能力存在显著差异，不构成竞争。前述事宜的具体情况如下：

1) 差异化的代工能力影响客户选择，客户群体存在显著差异

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团提供的文件资料、发行人的说明，在工艺技术和产品性能、性价比/成本方面，发行人与上海华力的制造设备差异和器件优化方向差异对代工产品形成了不同的影响：1) 发行人通过器件优化升级发展各类特色工艺，对 65/55nm 基础逻辑工艺进行优化升级后，实现静态漏电降低，同时通过工艺优化实现在 65/55nm 采用价格相对较低的干法光刻机进行生产，实现产品性价比的提升。对于不追逐产品算力性能而关注产品功耗、可靠性等方面性能和性价比的客户而言，发行人的技术优化方向与其对产品的需求更加吻合；2) 华力微采用的浸没式光刻机凭借在分辨率和套刻误差方面的技术优势，可以提升产品运算速度等性能，满足追逐产品算力性能提升的客户需求。

在资源配置方面，基于上述不同的代工能力，发行人将产能等更多资源更多支持独立式非易失性存储器、嵌入式非易失性存储器以及逻辑与射频中追逐产品性价比的客户，华力微则主要支持逻辑与射频中追逐算力等性能提升的客户。此外，发行人还通过提供对相关 IP 模块设计和工艺整合方面的服务，以及特色工艺产品的测试程序开发和晶圆量产测试服务，进一步提升对客户的吸引力。

双方差异化的代工能力影响客户对代工企业的选择并导致了客户群体的差异，报告期内，发行人与上海华力仅少量客户存在重合。

2) 重合工艺平台在相同工艺节点（65/55nm）上的主要差异

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团提供的文件资料、发行人的说明，发行人及华力微在 65/55nm 工艺节点上相关重合工艺平台间的主要差异如下：

- a. 在独立式非易失性存储器平台，发行人为客户提供的主要是定制化的服务，华力微为客户提供的技术方案则以通用方案为主；报告期内，双方在该平台上仅存在一个重合客户客户三，该客户基于定制化需求目前主要与发行人合作，报告期内其与华力微并无新产品的合作。
- b. 在嵌入式非易失性存储器平台，发行人采用自主研发的 NORD 技术，在闪存器件的结构和形成方式上进行了优化改进，能够满足更多不同容量、不同应用（如工业、车规等）的客户需求，主要追求产品可靠性的提升，面向温度覆盖范围广、擦写次数高的产品，如工业控制与车规类产品；而华力微在该平台上系采用 SONOS 技术，以消费类市场为主。
- c. 在逻辑与射频平台，发行人和华力微基于不同的制造设备形成的不同技术解决方案：发行人的生产设备覆盖 65/55nm 及以上的工艺节点，并通过工艺优化升级，实现在 65/55nm 工艺节点采用成本优势较为明显的干式 ArF 光刻机，发行人的技术解决方案以满足客户对性价比的需求为主；华力微的生产设

备能够覆盖 65/55nm 及以下的工艺节点，且采用较为高端的浸没式光刻机，其分辨率更高，套刻误差更小，从而使得芯片产品的集成度和性能更高，因此华力微的技术解决方案以满足客户对集成度、算力、传输速度等性能提升的需求为主。

3. 发行人与上海华力均存在逻辑与射频平台，但不构成竞争

经本所律师核查，根据发行人的说明，发行人与上海华力均存在逻辑与射频平台，但基于技术解决方案满足的是客户不同的需求方向，双方在该工艺平台重合客户较少，不构成竞争（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第二（一）2 项）。

4. 华虹集团对发行人、上海华力的业务定位及未来规划

(1) 业务定位

经本所律师核查，根据华虹集团出具之相关说明、发行人及华虹集团提供之相关文件资料、本所律师与上海华力相关人员的访谈，发行人工艺技术定位于特色工艺，不完全依赖向更小线宽的工艺节点演进，通过持续优化器件结构与制造工艺，发挥不同器件的物理特性以提升产品性能及可靠性，主要覆盖嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件（MOSFET、IGBT 等）、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺晶圆代工；上海华力定位于遵循摩尔定律使线宽不断缩小的先进逻辑工艺领域，主要覆盖逻辑集成电路代工服务。华虹半导体与上海华力在经营思路、工艺技术、市场布局等方面存在明显差异。

(2) 未来规划

经本所律师核查，根据发行人的说明，基于半导体行业工艺平台、产品领域众多的特征，发行人强调多元化的产品路线，在嵌入式非易失性存储器及功率器件等特色工艺平台建立起了丰富的工艺和产品组合，未来仍将围绕该优势工艺领域，打造更具竞争力，工艺制程更多元化的代工能力。具体而言，在非易失性存储器领域，发行人将巩固嵌入式产品优势并进一步开发独立式存储产品，向更小存储单元面积、更大存储容量和更优读写性能的代工产品迈进；在功率器件领域，发行人将继续巩固高压 MOSFET 和 IGBT 工艺平台的已有优势，继续优化产品性能指标，丰富器件规格，以满足工业应用、汽车电子和新能源等应用领域快速增长的需求，从而巩固发行人特色工艺平台的核心竞争力；在电源管理领域，持续优化 BCD 平台工艺水平，力争开发更丰富的器件种类和集成度更高的工艺，持续满足海内外知名客户的需求。随着华虹无锡项目产能持续爬坡，未来进一步的资本投入将大幅提升 12 英寸生产线的产能，在各个工艺节点上，提升各项工艺平台代工的产品组合丰富度，巩固作为全球领先的半导体特色工艺代工厂的行业地位。

经本所律师核查，根据华虹集团于 2022 年 12 月出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，发行人与上海华力均从事晶圆代工业务，但双方基于各自定位进行错位发展，发行人主要定位于特色工艺，上海华力主要定位于先进逻辑工艺，双方在业务定位、制程、工艺平台、客户及产品应用上存在显著差异；华虹集团承诺其及其控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业未来不会在 65/55nm 工艺节点上扩充产能。

基于上述核查，本所律师认为，华虹半导体定位于特色工艺晶圆代工，上海华力定位于先进逻辑工艺晶圆代工，双方的工艺发展历程和未来发展方向存在显著差异；双方存在重合工艺节点和工艺平台，但同一工艺平台不同工艺节点的产品在性能方面存在显著差异，在相同工艺节点上双方亦以不同的技术解决方案形成了差异化的代工能力，且华虹集团已承诺其及其控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业未来不会在65/55nm工艺节点上扩充产能，前述情形未构成竞争。

- (二) 结合报告期内发行人与上海华力在工艺节点、工艺平台、代工产品、客户供应商等方面的重合情况，重合客户供应商交易的必要性、公允性及占比情况等，分析二者业务是否具有竞争性、替代性，是否构成同业竞争

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、发行人及华虹集团的说明以及本所律师对上海华力相关人员的访谈，上海华力中，华力集主要定位于28nm的先进逻辑工艺，与发行人在工艺节点方面存在显著差异，二者业务不具有竞争性、替代性；除65/55nm以外，发行人与华力微目前在其他工艺节点不存在重合，客户设计的产品只能通过特定的工艺节点实现，不同工艺节点的代工产品性能和终端应用均存在显著差异，相互不构成竞争和替代（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第二（一）项）；双方在重合的65/55nm工艺节点所涉及之工艺平台、代工产品、客户供应商等方面的主要对比情况如下：

#### 1. 工艺平台及代工产品

经本所律师核查，根据发行人的说明，报告期内，在65/55nm工艺节点，发行人与华力微均涉及嵌入式/独立式非易失性存储器平台和逻辑与射频平台，但生产工艺经各自的发展后已存在显著差异：

在独立式非易失性存储器平台，发行人和华力微分别采用定制化和通用化的技术解决方案为客户代工 NOR Flash 产品；在嵌入式非易失性存储器平台，发行人主要采用自主研发的 NORD 技术为客户代工 MCU 产品，其闪存器件的结构和形成方式与华力微采用的 SONOS 技术存在差异；在逻辑与射频平台，发行人的技术解决方案主要用于满足客户对代工产品性价比的需求，而华力微的方案则主要用于满足客户对代工产品性能提升的需求，发行人还对基础逻辑工艺进行优化升级形成了 RF-SOI 等特色工艺。

## 2. 客户供应商

### (1) 客户重合情况

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、发行人的说明、本所律师对发行人相关客户的访谈，在 65/55nm 工艺节点，发行人与华力微存在三家重合客户：在 65/55nm 嵌入式/独立式非易失性存储器等特色工艺平台上，发行人与华力微的重合客户为客户三；在 65/55nm 逻辑与射频工艺平台上，发行人与华力微的重合客户为客户十一和客户十二。

经本所律师核查，根据发行人的说明及本所律师对上述部分重合客户的访谈，上述重合系因该等客户早期委托华力微代工相关产品，后续因其自身对晶圆代工的需求增加而华力微已不在 65/55nm 的工艺节点上扩产，该等客户自主选择与华虹半导体进行合作；发行人在所采用的工艺技术等方面与华力微存在差异，为客户代工的产品亦存在差异，重合客户难以直接在发行人和华力微之间进行产品切换。

经本所律师核查，根据发行人的说明及本所律师对客户三、客户十一进行的访谈，就客户三而言，其产品设计因为技术平台差异性，需要重新设计、制作新光罩并配套不同的软硬件以应对不同工艺的生产需求，其在发行人和华力微代工产品确有不同；就客户十一而言，其在华力微生产的产品主要应用于音频，在发行人生产的产品主要应用于 WIFI、视频等，上述产品在设计规则、规格要求、产品管控等方面存在差异，需要分别与发行人和华力微的工艺平台进行匹配。

## (2) 供应商重合情况

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、发行人的说明，并经本所律师对发行人相关供应商的访谈，发行人和华力微存在部分重合供应商，主要系半导体设备、半导体材料供应商的全球行业集中度较高所致。

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团的说明，报告期内，双方与客户、供应商间的业务均系独立开展。

基于上述核查，鉴于华力集主要定位于 28nm 的先进逻辑工艺，与发行人在工艺节点方面存在显著差异，二者业务不具有竞争性、替代性；发行人与华力微目前在 65/55nm 工艺节点上的非易失性存储器、逻辑与射频等工艺平台存在少量重合，双方工艺技术存在显著差异，发行人与华力微仅存在少量重合客户，双方为客户代工的产品存在差异且重合客户难以直接在发行人和华力微之间进行产品切换，华虹集团亦已承诺其及其控制的其他企业未来不会在 65/55nm 工艺节点上扩充产能，本所律师

认为，发行人的特色工艺业务与上海华力的特色工艺及先进逻辑工艺业务均未形成竞争和替代关系，不构成同业竞争。

(三) 结合华力微掌握 65nm/55nm CMOS 工艺技术及产业化情况、上海华力与发行人在研产品/项目情况、发行人募投项目情况等，分析双方是否存在潜在的同业竞争，双方避免潜在同业竞争的措施及其有效性、可行性

1. 华力微掌握 65nm/55nm CMOS 工艺技术及产业化情况、上海华力与发行人在研产品/项目情况、发行人募投项目情况

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团提供的文件资料、华虹集团出具之说明及《关于避免同业竞争的承诺函》，华力微掌握的 65nm/55nm CMOS 工艺技术是上海华力初创期发展先进逻辑工艺的基础和起点，上海华力主要在先进逻辑工艺上进行研发投入，未来上海华力将不再于 65/55nm 的工艺节点上扩产。

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料，发行人专注于发展特色工艺，主要投入的研发项目如下：

序号	研发项目	具体方向	研发目标与先进性	所处阶段	研发模式
1	嵌入式非易失性存储器平台研发项目	55 纳米嵌入式闪存工艺	(1) 自主专利的闪存单元 NORD Flash cell, 实现国内在该平台工艺突破及大规模量产； (2) 闪存单元面积比业界主流代工企业的同节点技术显著缩小，未来计划进一步提升工艺水平和产品性能； (3) 工艺光刻层数较业界主流水平大幅	工艺优化升级	自主研发

			减少； (4) 重点将相关工艺技术平台延申至新能源汽车等新兴领域，使 Flash IP 可靠性进一步提升。		
		90 纳米嵌入式闪存工艺优化	进一步优化嵌入式存储器平台工艺流程，缩短工艺时间。	工艺优化升级	自主研发
2	功率器件平台研发项目	IGBT 12 英寸项目工艺与技术开发	(1) 12 英寸功率器件晶圆代工生产线，IGBT 性能和可靠性和业界领先水平相当； (2) 未来重点向新能源汽车领域延伸发展。	产品量产，工艺持续优化	自主研发
3	模拟与电源管理平台研发项目	模拟与电源管理工艺开发	(1) 国内率先将 BCD 与 flash 集成在同一个工艺平台，符合电源管理芯片智能化的技术与市场发展趋势； (2) 结合了 BCD 工艺低导通电阻以及 flash 高可靠性的特点，满足车规级汽车电子芯片需求，未来进一步探索新能源汽车等新兴领域的应用。	产品量产，工艺持续优化	自主研发
4	逻辑与射频平台研发项目	预研项目	提升“特色 IC”工艺水平。	工艺优化升级	自主研发

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及招股说明书（申报稿），发行人募投项目均围绕特色工艺开展，其中虹制造（无锡）项目拟建设一条月产能达到 8.3 万片的 12 英寸、工艺节点 65/55nm - 40nm 的特色工艺生产线，主要用于满足不断增长的晶圆产品的代工需求。

经本所律师核查，根据发行人的说明，随着整体行业技术的发展进步及工艺节点的不断向前推进，原有工艺节点上的逻辑工艺发展成熟后通常不再属于先进逻辑工艺的范畴，但仍然是该工艺节点上的基础逻辑工艺，也是发展特色工艺的基础；发行人的特色工艺在工艺节点方面亦会逐步向前发展，发行人与上海华力在发展定位、代工能力、产品发展方向等方面存在显著差异。

基于上述核查，本所律师认为，双方不存在潜在的构成重大不利影响的同业竞争。

## 2. 双方避免潜在同业竞争的措施及其有效性、可行性

经本所律师核查，发行人实际控制人华虹集团已于 2022 年 8 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

- (1) 发行人与其控制的上海华力均从事晶圆代工业务，但定位及主要工艺技术平台不同，发行人主要定位于特色工艺，上海华力主要定位于先进逻辑工艺，双方的产品服务在工艺技术的方向上存在本质不同，上海华力与发行人及其控股子公司间不存在构成重大不利影响的同业竞争（重大不利影响按照上交所科创板相关规则中的定义进行界定，下同）。
- (2) 截至该承诺函出具之日，除上海华力外，其及其直接或间接控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”）均未从事或参与与发行人及其控股子公司主营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务，未来亦不会主动从事或参与任何与发行人及其控股子公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务。

- (3) 自该承诺函出具之日起，如其及其控制的其他企业从任何第三方获得的商业机会与发行人经营的业务构成重大不利影响的同业竞争，其将立即通知发行人，以适当方式将该等商业机会优先提供予发行人，或由发行人在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权以避免与发行人构成重大不利影响的同业竞争的情况。
- (4) 上述承诺在其作为发行人实际控制人期间有效。
- (5) 自该承诺函出具之日起，若因其违反该承诺函任何条款而致使发行人遭受或产生的任何损失或开支，其将予以全额赔偿。

经本所律师核查，为进一步避免与发行人的同业竞争，华虹集团已于 2022 年 12 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其及其控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业未来不会在 65/55nm 工艺节点上扩充产能。

基于上述核查，本所律师认为，发行人实际控制人的上述承诺有利于避免其及其控制的其他企业与发行人的潜在同业竞争，相关承诺自作出之日起对其具有法律约束力，上述避免同业竞争的措施具有可行性。

- (四) 结合报告期内发行人与上海华力竞争业务的收入、毛利及占比情况、未来发展趋势等，以及《科创板股票发行上市审核问答》问题 4 的要求，充分论证是否构成重大不利影响的同业竞争及相应的清理措施

经本所律师核查，根据发行人提供的资料、发行人及华虹集团的说明及承诺、本所律师对华力微相关人员的访谈，发行人与上海华力虽然均属于晶圆代工，但发行人的特色工艺与上海华力的特色工艺和先进逻辑工艺均未形成竞争和替代关系，不构成同业竞争（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第二（一）（二）项）；因此发行人不适用《科创板股票发行上市审核问答》问题4的相关规定。

(五) 结合上海华力的股权结构，发行人与上海华力在房屋租赁、人员交叉任职、技术及业务合作等方面的情况，说明是否影响发行人与上海华力的独立性及相应保障措施，是否存在利益输送或让渡商业机会的情形；

#### 1. 上海华力的股权结构

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及本所律师于国家企业信用信息公示系统的查询，上海华力的股权结构情况具体如下：

##### (1) 华力微

经本所律师核查，华力微设立于2010年1月，设立时注册资本为660,000万元。经过数次股权变动，截至本补充法律意见书出具之日，华力微的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例(%)
1.	华虹集团	1,187,239.7280	53.79
2.	大基金	880,000	39.87
3.	上海华虹宏力	140,000	6.34
	合计	2,207,239.7280	100.00

(2) 华力集

经本所律师核查，华力集原系华力微出资于 2016 年 8 月 8 日设立的全资子公司，设立时注册资本为 15,000 万元。经过增资扩股，截至本补充法律意见书出具之日，华力集的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1.	华力微	1,600,000	54.05
2.	大基金	1,160,000	39.19
3.	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	200,000	6.76
合计		2,960,000	100.00

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、华虹集团出具的说明及本所律师对华力微相关人员的访谈，上海华力自设立之日起即独立开展生产经营、研发等活动，发行人子公司上海华虹宏力仅作为上海华力的少数股东之一，并未直接参与上海华力的日常经营，不存在因上海华虹宏力持有华力微的股权而导致发行人与上海华力之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面未相互独立或存在利益输送或让渡商业机会的情形。

2. 房屋租赁及代收代付水电物业费

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及华虹集团出具的说明，华力集生产经营用主要场所为自有厂房；华力微生产经营主要场所系向上海华虹宏力租赁，主要原因系考虑到项目建设厂房周期

较长，而华力微承担国家“909”工程升级改造项目，通过租赁上海华虹宏力的厂房，可以加快项目建设。

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、华虹集团出具的说明，上海华虹宏力将其位于上海市浦东新区张江高科技园区 13 街坊 2 丘的厂房出租予华力微使用，华力微与上海华虹宏力的经营场地均可识别、可区分，不存在生产经营场所混同的情况；根据双方签订的厂房租赁合同及相关补充协议，直接供应生产之动力源（包括生产用电、生产用水等）由双方同意的接引点衔接，加装双方认可的计量分表，依实际用量根据双方约定的计费方式付费；非生产用运行费（包括华力微承租区域范围内的所有非生产用电力费用等）由双方考虑各项实际情况估算并确定每月的固定费用；华力微承租区域的办公及照明用电，按照其实际独用部分面积以及按此分摊的实际公用面积计算。

### 3. 发行人董事、高级管理人员存在担任上海华力董事、监事的情形

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、华虹集团出具的说明，上海华虹宏力作为持有华力微 5%以上股权的股东，向华力微委派一名董事（唐均君）和一名监事（王鼎）。上述安排系上海华虹宏力基于股权关系及华力微公司章程的规定，通过向华力微委派董事、监事的方式依法依规保护自身作为小股东的利益。上海华虹宏力向华力微委派的董事、监事按照《公司法》及华力微公司章程的规定在各自职责范围内行使职权。

### 4. 技术及业务合作

经本所律师核查，根据上海华虹宏力与华力微于 2018 年 11 月 23

日签订的《技术开发协议》，华力微提供 65nm/55nm CMOS 工艺技术的开发，向上海华虹宏力交付与前述工艺技术相关的技术文档，并在全球范围内向上海华虹宏力及其关联公司提供永久的、非独家、不可转让的使用和开发专利成果之许可（以下简称“华力微开发技术”，前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第三（一）项）。

经本所律师核查，根据华虹无锡与上海华力于 2019 年 9 月 27 日签订的《晶圆代工服务协议》、发行人与华虹集团于 2021 年 12 月 31 日签订的《关连交易框架协议》及发行人于香港联交所公告的信息，上海华力为发行人提供相关晶圆代工服务，相关服务的具体内容包括：（1）为华虹无锡提供 12 英寸工程晶圆用以测试华虹无锡生产线并提供相关工艺支持；（2）向华虹无锡提供与晶圆生产有关的服务及协助。根据《审计报告》，报告期内，发行人向上海华力采购商品的金额分别为 61,211,050 元, 12,635,932 元, 3,349,068.96 元和 124,740 元。

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及于香港联交所公告的信息，上海华虹宏力由华力微开发相关技术主要系为避免重复研发投入、快速通过技术验证并实现投产，相关技术仅系发行人在 65/55nm 新工艺节点上进行特色工艺产品量产的基础工艺，发行人在前述许可技术的基础上，通过自主研发、优化与升级形成了自身的特色工艺技术（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第三（二）项）；华虹无锡委托上海华力提供上述晶圆代工服务主要系为满足 12 英寸晶圆产线建设初期关于产品测试、工艺验证等需求，12 英寸晶圆产线大规模投产后，上海华力与华虹无锡就上述晶圆代工服务事宜发生的交易金额已大幅下降。

5. 是否影响发行人与上海华力的独立性及相应保障措施，是否存在利益输送或让渡商业机会的情形

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、华虹集团出具的说明文件及本所律师对华力微相关人员的访谈，上海华虹宏力基于自身战略发展需要投资华力微；上海华虹宏力作为华力微参股股东，向华力微分别委派一名董事及一名监事，系其依据股权关系及华力微章程的规定行使股东权利并依法依规保护自身作为中小股东的利益；上海华虹宏力向华力微出租的房屋可识别、可区分，双方独立核算水电物业费等并据实结算；华力微授权发行人使用 65/55nm CMOS 工艺技术，并在华虹无锡 12 英寸厂建设初期由上海华力提供部分工艺支持及试制晶圆测试等服务，但上述安排主要系为发行人 12 英寸产线建设初期尽快实现量产，发行人已在华力微授权技术基础上通过自主研发和升级改造，形成了独立的生产工艺技术和特色工艺平台体系。据此，上述事宜未影响发行人与上海华力之间的独立性。

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、华虹集团出具的说明、本所律师对华力微相关人员的访谈，发行人定位于特色工艺晶圆代工，上海华力定位于先进逻辑工艺晶圆代工，发行人与上海华力的相关业务均系由自身独立获取，双方不存在利益输送或让渡商业机会情形。

经本所律师核查，根据招股说明书（申报稿）、《审计报告》并经发行人确认，发行人已建立完整、独立的研发、采购、生产和销售等运营管理体系，合法拥有或使用发行人生产经营所需的主要资产，发行人主要资产不存在被发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；发行人依法设立了董事会和经营管理

层，聘任了总裁、执行副总裁、首席财务官等高级管理人员，设立了与生产经营和发展所需相适应的内部经营管理机构和相关职能部门并独立行使经营管理职权；发行人单独设立了财务机构并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，并作为独立纳税人依法独立履行纳税义务；发行人高级管理人员（包括总裁、执行副总裁、首席财务官）、财务人员未在发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。

经本所律师核查，发行人控股股东华虹国际、实际控制人华虹集团已出具《关于保持华虹半导体有限公司独立性的承诺函》，承诺将严格遵守中国证监会、上交所有关规章及《公司章程》等的相关规定，依法行使权利、履行义务，不利用控股股东/实际控制人地位谋取不当利益或干预发行人内部组织机构独立经营、决策、运作，亦不通过下属企业从事前述行为，保证发行人在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。

基于上述核查，本所律师认为，上述事项未对发行人与上海华力的独立性造成重大不利影响，发行人已通过上述方式保障自身在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性，发行人控股股东、实际控制人已就保持发行人独立性事宜进一步出具相关承诺，发行人与上海华力不存在利益输送或让渡商业机会的情形。

- (六) 发行人控股股东、实际控制人下属企业是否存在未披露的与发行人从事相同或类似业务的情形，控股股东及实际控制人出具承诺的履行情况，是否具有可行性、可操作性及实际约束力，发行人的同业竞争情况及相关承诺是否与联交所的公开披露信息存在冲突

1. 发行人控股股东、实际控制人下属企业是否存在未披露的与发行人从事相同或类似业务的情形

经本所律师核查，根据华虹集团提供的文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统、中国货币网等网站的公开查询及本所律师与上海华力、上海集成相关人员的访谈，华虹集团系上海市国资委控股的地方国有企业，旗下涵盖集成电路制造、集成电路公共服务平台等业务板块，业务覆盖半导体产业链上下游。在集成电路制造板块中，华虹集团及其控制的企业（含发行人）共计拥有 6 条晶圆代工生产线，其中，发行人控股子公司上海华虹宏力拥有 3 条 8 英寸生产线、发行人控股子公司华虹无锡拥有 1 条 12 英寸生产线，上海华力拥有 2 条 12 英寸生产线，除此之外，华虹集团控制的其他企业均不涉及晶圆代工业务；上海华力从事开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品业务，与发行人主营业务存在一定相似性，但不构成同业竞争（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第二（二）项）。在集成电路公共服务平台板块中，华虹集团下属企业上海集成是产学研合作的国家级集成电路研发中心，是一个独立的面向全行业集成电路企业、大学及研究单位开放的公共研发机构，主要涉及先进共性工艺技术的研发、国产设备、材料和零部件验证评估、设计支持服务、合作研发等，不涉及晶圆代工业务。此外，就设计服务而言，发行人的 IP 设计服务主要系向客户提供与工艺平台配套的 IP 模块，面向的客户主要为芯片设计公司，而华虹集团下属企业涉及的集成电路设计业务系设计完整的芯片产品，面向的客户主要为芯片的应用终端或相关模组的厂商，前述业务不涉及同业竞争。华虹集团下属企业不存在其他尚未披露的与发行人从事相同或类似业务的情形。

2. 控股股东及实际控制人出具承诺的履行情况，是否具有可行性、可操作性及实际约束力

(1) 发行人于香港联交所上市时相关主体出具的相关承诺

经本所律师核查，根据《备忘录》及华虹集团等相关方（以下合称“不竞争契诺人”）于2014年9月23日以发行人为受益人订立的《不竞争契据》，前述《不竞争契据》的主要内容为：

- 1) 于受限期间内（指上市日期开始至下列最早日期届满的期间：①股份不再于香港联交所上市及买卖的日期；②就各不竞争契诺人而言，其本身及其联系人不再持有何发行人股份的日期；及③该等契诺人（包括彼等各自的联系人）共同或个别不再有权在发行人股东大会上行使30%或以上表决权或控制该等表决权的行使的日期），不竞争契诺人及其联系人将不会直接或间接为其本身或连同或代表或通过任何人士、企业、公司或组织直接或间接在与受限业务（指发行人于香港联交所上市时在签署日期为2014年10月3日的招股说明书中描述的业务，主要为8英寸晶圆代工业务，以下简称“受限业务”）构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有权益或者从事该等受限业务，或协助他人拥有权益或从事该等受限业务（在各种情况下，不论作为股东、合伙人、代理人、雇员或其他身份及不论是否获得利益、回报或其他）。

上述承诺在下述范围不适用于该等契诺人或各自的联系

人：1、于发行人任何成员公司的股份中的权益；或 2、发行人及其成员以外公司（其股份在联交所或其他认可的证券交易所上市）的股份中的权益，前提是该等契诺人（包括彼等各自的联系人）各自分别持有的股份或证券总数不得超过该公司有关类别的已发行股份或证券的 5%，且不竞争契诺人及其联系人（不论个别或共同行事）无权委任该公司董事会的大多数成员。

- 2) 于受限期间内，不竞争契诺人如获提供有关受限业务或与受限业务竞争或可能与受限业务竞争的任何新商业机会，其将向发行人转介该项商业机会，并提供有关所需数据，令发行人能够评估商业机会的价值。不竞争契诺人将提供所有有关合理协助，使发行人可按不逊于该等契诺人初次获得商业机会时给予的条款及条件取得商业机会。在发行人全权酌情决定不接受商业机会或未能于不竞争契诺人将商业机会转介予发行人日期起计 6 个月内接受商业机会前，该等契诺人不得接受商业机会。

经本所律师核查，根据《备忘录》及华虹集团等相关方（以下合称“优先购买权契诺人”）于 2014 年 6 月 10 日以发行人为受益人订立的《优先购买权契据》，前述《优先购买权契据》的主要内容为：优先购买权契诺人承诺，于承诺有效期内的任何时间，在并未首先向发行人提供收购华力微业务或权益的权利前，优先购买权契诺人及其联系人（发行人除外）等不得向任何人士出售其持有的华力微的股份，并将促使华力微不得向任何人出售其任何核心资产或业务或其子公司的权益（如有），或保留业务（指华力微在中国经营的

12 英寸晶圆代工业务，以下简称“保留业务”）中的任何权益。如果优先购买权契诺人打算出售其于华力微或保留业务中的权益，须首先向发行人提供收购有关业务或权益的权利并提供交易价格及付款条款等相关资料。交易价格需要发行人委托的具有合格资格的第三方作出的独立评估。

经本所律师核查，根据发行人于香港联交所公告的年度报告及提供的文件资料，发行人已复核华虹集团有关遵守《不竞争契据》《优先购买权契据》内承诺的书面声明；独立非执行董事已复核遵守情况，并确认《不竞争契据》《优先购买权契据》下的全部承诺均获有关订约方遵守。

(2) 发行人控股股东、实际控制人于本次发行中出具的相关承诺

经本所律师核查，发行人控股股东华虹国际已于 2022 年 8 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

- 1) 截至该承诺函出具之日，其及其直接或间接控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”）均未从事或参与与发行人及其控股子公司主营业务构成竞争的业务，未来亦不会从事或参与任何与发行人及其控股子公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务。
- 2) 自该承诺函出具之日起，如其及其控制的其他企业从任何第三方获得的商业机会与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争，其将立即通知发行人，以适当方式将

该等商业机会优先提供予发行人，或由发行人在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权以避免与发行人形成同业竞争的情况。

- 3) 上述承诺在其作为发行人控股股东期间有效。
- 4) 自该承诺函出具之日起，若因其违反该承诺函任何条款而致使发行人遭受或产生的任何损失或开支，其将予以全额赔偿。

经本所律师核查，发行人实际控制人华虹集团已于 2022 年 8 月出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

- 1) 发行人与其控制的上海华力均从事晶圆代工业务，但定位及主要工艺技术平台不同，发行人主要定位于特色工艺，上海华力主要定位于先进逻辑工艺，双方的产品服务在工艺技术的方向上存在本质不同，上海华力与发行人及其控股子公司间不存在构成重大不利影响的同业竞争（重大不利影响按照上交所科创板相关规则中的定义进行界定，下同）。
- 2) 截至该承诺函出具之日，除上海华力外，其及其直接或间接控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业（以下简称“控制的其他企业”）均未从事或参与与发行人及其控股子公司主营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务，未来亦不会主动从事或参与任何与发行人及其控股子公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务。

- 3) 自该承诺函出具之日起，如其及其控制的其他企业从任何第三方获得的商业机会与发行人经营的业务构成重大不利影响的同业竞争，其将立即通知发行人，以适当方式将该等商业机会优先提供予发行人，或由发行人在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权以避免与发行人构成重大不利影响的同业竞争的情况。
- 4) 上述承诺在其作为发行人实际控制人期间有效。
- 5) 自该承诺函出具之日起，若因其违反该承诺函任何条款而致使发行人遭受或产生的任何损失或开支，其将予以全额赔偿。

经本所律师核查，华虹集团已在上述承诺函的基础上于 2022 年 12 月进一步出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其及其控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业未来不会在 65/55nm 工艺节点上扩充产能。

基于上述核查，本所律师认为，发行人控股股东华虹国际及实际控制人华虹集团的上述承诺具有可行性、可操作性及法律约束力。

3. 发行人的同业竞争情况及相关承诺是否与联交所的公开披露信息存在冲突

经本所律师核查，发行人在其于香港联交所上市时的申请材料中披

露，华力微专注于提供 12 英寸晶圆代工服务，发行人专注于提供 8 英寸晶圆代工服务。发行人实际控制人华虹集团已以发行人为受益人分别订立了《不竞争契据》《优先购买权契据》，前述承诺的具体内容详见本补充法律意见书第一部分第二（六）2（1）项。

经本所律师核查，根据发行人于香港联交所公告的年度报告及提供的文件资料，发行人已复核华虹集团有关遵守《不竞争契据》《优先购买权契据》内承诺的书面声明；独立非执行董事已复核遵守情况，并确认《不竞争契据》《优先购买权契据》契据下的全部承诺均获有关订约方遵守。

经本所律师核查，发行人于香港联交所上市后，已就其开展 12 英寸晶圆代工业务相关事宜在香港联交所进行公开披露，前述信息与本次发行申报文件中同业竞争情况不存在实质冲突；《不竞争契据》系华虹集团等不竞争契诺人承诺不进入发行人的相关业务领域（当时主要为发行人从事的 8 英寸晶圆代工业务），发行人进入 12 英寸晶圆代工业务领域未导致不竞争契诺人违反《不竞争契据》；《优先购买契据》系约定优先购买权契诺人转让华力微股权时，发行人享有同等条件下的优先购买权，发行人于香港联交所上市后，优先购买权契诺人未违反《优先购买契据》。

基于上述核查，本所律师认为，发行人的同业竞争情况及相关承诺与发行人于香港联交所公开披露的信息不存在实质冲突。

(七) 结合以上说明内容完善招股说明书重大事项提示及同业竞争事项的披露

经本所律师核查，发行人已在招股说明书（申报稿）“重大事项提示”、第七节“公司治理与独立性”之“八、同业竞争”中补充披露关于同业竞争的相关事项。

- (八) 控股股东、实际控制人下属企业与发行人是否存在同业竞争以及重大不利影响的同业竞争，是否符合《首发业务若干问题解答》问题 15、《科创板股票发行上市审核问答》问题 4 的规定

根据《首发业务若干问题解答（2020 修订）》问题 15 的相关规定，同业竞争的“同业”是指竞争方从事与发行人主营业务相同或相似业务，核查认定该相同或相似的业务是否与发行人构成“竞争”时，应按照实质重于形式的原则，结合相关企业历史沿革、资产、人员、主营业务（包括但不限于产品服务的具体特点、技术、商标商号、客户、供应商等）等方面与发行人的关系，以及业务是否有替代性、竞争性、是否有利益冲突、是否在同一市场范围内销售等，论证是否与发行人构成竞争；不能简单以产品销售地域不同、产品的档次不同等认定不构成同业竞争。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》问题 4 的相关规定，申请在科创板上市的企业，如存在同业竞争情形，认定同业竞争是否构成重大不利影响时，保荐机构及发行人律师应结合竞争方与发行人的经营地域、产品或服务的定位，同业竞争是否会导致发行人与竞争方之间的非公平竞争、是否会导致发行人与竞争方之间存在利益输送、是否会导致发行人与竞争方之间相互或者单方让渡商业机会情形，对未来发展的潜在影响等方面，核查并出具明确意见。竞争方的同类收入或毛利占发行人该类业务收入或毛利的比例达 30%以上的，如无充分相反证据，原则上应认定为构成重大不利影响。

经本所律师核查，根据发行人及华虹集团提供的文件资料、本所律师于国家企业信用信息公示系统等网站的公开查询、华虹集团出具之说明、本所律师与上海华力相关人员的访谈，发行人控股股东、实际控制人控制的下属企业中，上海华力从事开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品业务，与发行人主营业务存在一定相似性；双方在历史沿革、资产、人员方面相互独立，不存在利益输送或让渡商业机会的情形，不构成同业竞争；除上海华力外，华虹集团及其直接或间接控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业均未从事或参与与发行人及其控股子公司主营业务构成重大不利影响的同业竞争的业务，未来亦不会主动从事或参与任何与发行人及其控股子公司主营业务构成竞争或可能存在竞争的业务（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第二（一）（二）（四）（五）（六）项）。

基于前述核查，本所律师认为，发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争，未违反《首发业务若干问题解答》问题 15 及《科创板股票发行上市审核问答》问题 4 的规定。

- 三. 审核问询问题 4. 关于技术许可、技术开发：根据申报材料：（1）发行人子公司上海华虹宏力与上海集成签订《技术许可协议》，上海集成将 65nm CMOS 工艺技术以非独家、不可转让的许可方式许可予上海华虹宏力用于 12 英寸特色工艺集成电路生产线的研发和建设，并由上海集成向其提供技术服务；（2）上海华虹宏力与华力微签订《技术开发协议》，华力微基于上海华虹宏力及其关联公司的技术及项目要求进行 65nm/55nm CMOS 工艺技术的开发，向上海华虹宏力交付与前述工艺技术相关的技术文档，并在全球范围内向上海华虹宏力及其关联公司提供永久的、非独家、不可转让的使用和开发专利成果之许可；（3）发行人及其控股子公司通过与第三方 IP 供应商的合作，为客户提供不同种类的标准单元库、存储器编译器和其他 IP 类型；（4）报告期各期末，发**

行人无形资产中的非专利技术账面原值分别为 175,274.31 万元、187,918.89 万元、187,918.89 万元和 187,918.89 万元。请发行人说明：（1）上述协议的签署背景及主要内容，技术许可/开发费用的金额、定价公允性、实际支付情况，许可期限及到期后的续约安排，是否存在交叉授权，与华力微的《技术开发协议》未约定开发成果归发行人所有的原因，华力微、上海集成是否从事上述技术相关业务、是否授权给第三方；（2）上述许可技术在发行人研发、生产中的运用情况及重要程度，是否属于底层技术，报告期内的收入、毛利贡献情况，发行人 CMOS 技术的掌握情况、是否对许可技术存在重大依赖，相关风险是否充分揭示；（3）发行人 IP 的授权/被授权情况，与第三方 IP 供应商的业务合作模式，非专利技术使用权的主要构成、来源、授权期限、在产品中的具体应用情况及重要性。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

（一）上述协议的签署背景及主要内容，技术许可/开发费用的金额、定价公允性、实际支付情况，许可期限及到期后的续约安排，是否存在交叉授权，与华力微的《技术开发协议》未约定开发成果归发行人所有的原因，华力微、上海集成是否从事上述技术相关业务、是否授权给第三方

1. 上述协议的签署背景及主要内容，技术许可/开发费用的金额、定价公允性、实际支付情况，许可期限及到期后的续约安排，是否存在交叉授权

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、本所律师对华力微、上海集成的访谈及上海集成出具的相关确认，上述协议的背景、主要内容、定价及实际支付情况、许可期限及到期后的续约安排等具体情况如下：

序号	协议名称	合同 相对方	背景	协议主要内容	技术许可/ 开发费用	定价依据	实际支 付情况	许可期 限及续 约安排	是否 交叉 授权
1.	技术许可 协议	上海 集成	发行人拟建设 12 英寸生产线并需使用 65/55nm CMOS 工艺技术，鉴于上海集成已自第三方获得相关专利授权并积累了部分自研技术，华力微亦已形成自主研发的 65/55nm CMOS 相关生产工艺技术，为避免重复研发投入、快速通过技术验证并实现投产，上海华虹宏力分别与上海集成、	(1) 上海集成授予上海华虹宏力非独家、不可转让的技术许可（转让给关联公司的除外，以下简称“上海集成许可技术”）；上海集成许可技术包括其自第三方授权取得的 65nm CMOS 技术及专利、其自主研发并拥有所有权的 65/55nm CMOS 技术有关的工艺技术及专利； (2) 上海集成向上海华虹宏力及其关联公司提	477 万美元 (含税)	根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2018]第 2100 号《资产评估报告》，于评估基准日 2018 年 9 月 30 日，上海集成许可技术使用权评估价值为 477 万美元。本次交易价格系参考评估价值并考虑市场情况后经协商确定。	已支付	永久	否

			华力微签订了相关技术许可/开发协议。	供辅助的技术咨询服务。					
2.	技术开发协议	华力微		<p>(1) 华力微提供65/55nm CMOS 工艺技术开发，并在全球范围内向上海华虹宏力及其关联公司提供永久、非独家、不可转让的使用和开发专利成果的许可；</p> <p>(2) 向上海华虹宏力及其关联公司提供辅助的技术咨询服务，包括采购咨询服务、有关设备、工艺及软件的咨询服务及工艺技术引入的咨询服务。</p>	1,710 万美元 (含税)	根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2018]第 2101号《资产评估报告》，于评估基准日 2018 年 9 月 30 日，华力微开发技术使用权评估价值为 1,710 万美元。本次交易价格系参考评估价值并考虑市场情况后经协商确定。	已支付	永久	否

经本所律师核查，根据上海集成出具的确认，上海集成已通过协议等书面形式取得第三方的同意或确认，其有权将自第三方处取得的65nm CMOS 工艺技术及专利转许可给上海华虹宏力及其关联公司使用；上海集成自第三方处取得的技术及专利许可期限及上海集成有权转许可的期限均为永久。

2. 与华力微的《技术开发协议》未约定开发成果归发行人所有的原因

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及本所律师对华力微相关人员的访谈，上海华力系以65/55nm工艺节点为起点发展先进逻辑工艺，并通过自主研发形成了其自身的65/55nm CMOS 生产工艺技术，现已将工艺节点推进至28nm；上海华虹宏力在《技术开发协议》项下由华力微开发的工艺技术系在华力微自主研发的65/55nm CMOS 生产工艺技术基础上形成，由于上海华力在其先进逻辑工艺相关业务发展过程中亦需继续使用该等自主研发的工艺技术，因此双方《技术开发协议》未约定开发成果归发行人所有。

3. 华力微、上海集成是否从事上述技术相关业务、是否授权给第三方

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、本所律师对华力微相关人员的访谈，华力微存在运用65nm/55nm CMOS 从事相关业务的情形（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第二（三）项）；除上海华虹宏力、华力微控股子公司华力集外，华力微目前不存在向其他第三方授权使用上述技术的情形。

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及本所律师对上海集成相关人员的访谈，上海集成及其控制的企业主要从事半导体芯片

设计及技术研发，未从事晶圆代工业务。除上海华虹宏力外，上海集成目前不存在向其他第三方授权使用上述技术的情形。

- (二) 上述许可技术在发行人研发、生产中的运用情况及重要程度，是否属于底层技术，报告期内的收入、毛利贡献情况，发行人 CMOS 技术的掌握情况、是否对许可技术存在重大依赖，相关风险是否充分揭示

经本所律师核查，根据发行人的说明，CMOS 工艺技术是集成电路制造领域中一种主流、通用的工艺技术，以集成度高、功耗低、抗干扰能力强、温度稳定性好等优点而被广泛采用，其存在大量公开的技术信息，亦形成了各种不同特点的衍生架构。在华虹无锡设立前，发行人已具备成熟的基于 8 英寸产线的 90nm 及以上节点的 CMOS 特色工艺技术。

经本所律师核查，根据发行人的说明，随着集成电路发展的不断进步，特色工艺平台的工艺节点也在向前迈进，根据摩尔定律的规律，上一代工艺节点向新一代工艺节点演进时，各项工艺平台均需完成参数积累、工艺模块调试、器件性能优化和可靠性验证、生产良率提高、配套器件模型建立等大量步骤，耗时较多，单一公司通过自身研发及调试向先进节点迈进需要较大的资本和时间投入。因此，在发行人华虹无锡项目建设时，为避免重复研发投入、快速通过技术验证并实现投产，上海华虹宏力与上海集成及华力微分别签订了《技术许可协议》与《技术开发协议》，将上海集成许可技术、华力微开发技术，延用到无锡 12 英寸生产线的建设、调试与试生产过程中，使得发行人大大缩短了在新一代工艺节点上进行重复的参数积累、生产工艺调试的时间和成本。

经本所律师核查，根据发行人的说明，上海集成与华力微向发行人授权使用的技术系发行人在 65/55nm 工艺节点进行特色工艺产品量产的基础工艺，发行人在华力微开发技术及上海集成许可技术的基础上，基于 CMOS 工艺的公开信息和自身原有 CMOS 工艺技术的经验，进一步在工艺

设备、器件架构、工艺技术、应用材料及客户特定需求开发等方面进行研发、优化与升级，并形成了自主的基于 12 英寸生产线的 CMOS 技术及衍生的特色工艺技术。

经本所律师核查，根据发行人的说明，报告期内，发行人在相关技术许可的基础上通过自主研发形成了自身完整的 65/55nm 节点的特色工艺平台，因此无法界定仅依靠相关技术许可形成的收入及毛利贡献情况。

基于上述核查，本所律师认为，发行人已具备成熟的基于 8 英寸产线的 90nm 及以上节点的 CMOS 特色工艺技术，并在华力微开发技术及上海集成许可技术的基础上形成了自主的基于 12 英寸生产线的 CMOS 技术及衍生的特色工艺技术；CMOS 工艺技术系集成电路制造领域中被广泛使用的技术，本身存在大量公开的技术信息，上海集成与华力微向发行人授权使用技术系发行人在 65/55nm 工艺节点进行特色工艺产品量产的基础工艺，发行人在前述授权技术的基础上形成了自主的基于 12 英寸生产线的 CMOS 技术及衍生的特色工艺技术，发行人对华力微开发技术及上海集成许可技术不存在重大依赖。

经本所律师核查，发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“三、法律风险”之“（四）知识产权的风险”中补充披露相关技术授权风险。

(三) 发行人 IP 的授权/被授权情况，与第三方 IP 供应商的业务合作模式，非专利技术使用权的主要构成、来源、授权期限、在产品中的具体应用情况及重要性

1. 发行人 IP 的授权/被授权情况，与第三方 IP 供应商的业务合作模式

(1) IP 服务及授权的业务模式

经本所律师核查，根据发行人的说明，随着超大规模集成电路设计的日益复杂，产品形态多样化、研发资源投入和成本持续增加，芯片设计产业进一步细分演化出 IP 服务产业，其旨在提供经过重复验证的功能化 IP 模块或架构，供各类芯片设计公司或晶圆代工厂商使用，使其可以更专注于产品的设计或制造环节，进而降低设计风险和研发成本，提升芯片设计、制造的运行效率。在 IP 服务产业中，IP 授权的主要采购主体为芯片设计公司等具有芯片开发设计需求的厂商，其需要在芯片设计过程中融入各类 IP 功能模块，辅助其完成芯片设计，提高芯片集成度和性能；晶圆代工企业在为相关芯片设计企业提供晶圆代工制造服务的过程中，亦需要自行开发 IP 或自第三方 IP 供应商取得含有相关 IP 的芯片制造授权，用于生产制造含有相关 IP 模块的芯片。前述模式属于行业通用的业务模式。

(2) 发行人 IP 授权情况

经本所律师核查，根据发行人的说明，发行人在为客户提供晶圆代工服务过程中，在部分具备技术优势的领域会结合客户的实际需求，向客户提供其基于自身生产工艺平台开发设计的配套自有 IP 模块，供客户进行芯片定制化设计及开发，并向客户收取相关费用。除前述基于晶圆代工服务向客户提供自有 IP 外，发行人及其子公司不存在独立对外提供 IP 授权的情形。

(3) 发行人 IP 被授权情况及与第三方 IP 供应商的业务合作模式

经本所律师核查，根据发行人与第三方 IP 供应商签署的相关授权协议，发行人与第三方 IP 供应商的业务合作模式主要为第三方 IP 供应商将其设计的具备特定功能的集成电路模块或拥有的特定 IP 基础单元授权给发行人用于使用授权 IP 生产产品；第三方 IP 供应商通常一次性向发行人收取授权金，并在产品实现量产或销售时按照晶圆量产数或者产品销售价格的一定比例收取提成费；该模式符合行业惯例。

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料并根据发行人的说明，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人自第三方 IP 供应商获得 30 余项 IP 授权，主要类型包括嵌入式非易失性存储 IP、标准单元库及存储器编译器、模拟 IP、接口 IP 及 CPU IP 等，授权期限的主要类型包括：（1）5 年及以上长期授权，到期根据协议的约定续期；（2）除非根据协议的约定终止，授权协议自签署生效日起有效。

经本所律师核查，根据发行人与第三方 IP 供应商签署的相关授权协议、发行人的说明，发行人自第三方 IP 供应商取得的 IP 授权通常为不可转让的许可，发行人可使用相关 IP 生产、销售产品；发行人自第三方 IP 供应商取得含有相关 IP 的芯片制造授权并向客户销售产品的行为不属于向其他第三方转授权的情形。

经本所律师核查，根据发行人的说明，晶圆代工企业作为产业链分工体系的一部分，主要承担将集成或应用相关 IP 并完成了整体设计的芯片进行生产制造的职能，其需要获得相关 IP 的芯片制造授权，并在调试、验证后提供相应的晶圆

代工制造服务；IP 授权是辅助晶圆代工企业完成芯片生产制造的组成部分，但其主要应用于芯片设计，与代工制造分别对应了不同的技术体系，并不直接构成发行人从事晶圆代工业务的核心部分。如果未来无法与相关 IP 供应商继续保持合作，发行人需要寻找其他可替代的 IP 供应商或自主开发相关 IP 并验证生产工艺。基于下述因素，发行人无法维持上述 IP 授权的可能性较低，即使无法获取部分 IP 供应商授权，亦不会对发行人持续经营产生重大不利影响：

- 1) IP 供应商授权 IP 供集成电路设计、制造企业使用是行业普遍商业模式和合作的基础，发行人与该等 IP 供应商均保持了长久、良好的合作关系，该等合作无法维持的可能性较低；
  - 2) 相关 IP 授权主要为长期授权，发行人将密切保持与相关供应商的良好合作，维持相关合同的正常履行及续期；
  - 3) 发行人高度重视 IP 供应商的替代备选工作，随着半导体产业及国内半导体企业的不断发展，已经可以逐渐找到相关 IP 授权的替代或部分替代；同时，发行人亦积极通过研发设计自有 IP 降低对授权 IP 的依赖。
2. 非专利技术使用权的主要构成、来源、授权期限、在产品中的具体应用情况及重要性

经本所律师核查，根据发行人提供的资料及发行人的说明，发行人的非专利技术主要由早期定向产品开发技术、华力微开发技术以及

上海集成许可技术构成：其中，占账面原值比重较高的早期定向产品开发技术，在报告期初余值已为零，其主要系发行人于 2000 年左右基于向客户提供定向产品开发及代工的需要，从第三方获得的技术授权，并主要应用于进行早期工艺节点的存储器工艺平台等产品，如现已停产的动态随机存取存储器（DRAM）。由于相关技术形成于近二十年以前，随着发行人生产工艺的迭代、工艺平台的演进、新产品的开发和客户需求的变化，前述技术在发行人现有产品的应用程度及重要性不断下降。华力微开发技术及上海集成许可技术的来源、授权期限、产品运用及重要性详见本补充法律意见书第一部分第三（一）（二）项的具体内容。

- 四. **审核问询问题 11. 关于募投项目及产线审批备案：根据申报材料：（1）发行人现有三条 8 英寸晶圆生产线、一条 12 英寸晶圆生产线，募投项目拟建设一条 12 英寸晶圆生产线，并对 8 英寸厂的部分生产线进行优化升级。申报材料未说明现有产线是否符合主管部门政策要求、取得项目备案、环评手续的情况，募投项目中 12 英寸线未完成项目备案、环评手续，未说明土地使用权的取得情况，8 英寸厂产线升级项目未办理环评手续；（2）募投项目拟新建的 12 英寸晶圆生产线项目实施主体存在股权结构发生变动的风险，发行人保证自身为项目实施主体的控股股东；（3）公司整体产能利用率较为饱和，华虹制造（无锡）项目计划建设的 12 英寸特色工艺生产线投产后月产能将达到 8.3 万，预计总投资 67 亿美元。请发行人说明：（1）对照相关产业政策规定及上述产线的建设进度，说明发行人各条晶圆产线（含 8 英寸产线升级项目）建设运行是否履行了完备的审批备案程序，是否符合主管部门相关政策要求，题干中列举的相关产线项目备案、环评手续、土地使用权的取得进展、预计完成时间，是否存在取得障碍及对发行人本次发行上市的影响，8 英寸产线升级项目无需办理环评手续的规则依据；（2）新建 12 英寸产线项目实施主体股权结构可能发生变动的原因及具体安排，发行人保证自身控股股东地位的有效措施，少数股**

东是否拟同比例提供资金；募投项目涉及跨境资金流动的外商投资和外汇手续办理安排；（3）结合现有产能、主要客户、在手订单及下游市场需求等影响因素，量化分析募投项目新增产能消化的可行性；结合新增固定资产投资金额、募投项目预计建成时间和募投项目实施后新增折旧、摊销等具体测算对发行人经营业绩的潜在影响。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

（一）对照相关产业政策规定及上述产线的建设进度，说明发行人各条晶圆产线（含 8 英寸产线升级项目）建设运行是否履行了完备的审批备案程序，是否符合主管部门相关政策要求，题干中列举的相关产线项目备案、环评手续、土地使用权的取得进展、预计完成时间，是否存在取得障碍及对发行人本次发行上市的影响，8 英寸产线升级项目无需办理环评手续的规则依据

1. 对照相关产业政策规定及上述产线的建设进度，说明发行人各条晶圆产线（含 8 英寸产线升级项目）建设运行是否履行了完备的审批备案程序，是否符合主管部门相关政策要求，题干中列举的相关产线项目备案、环评手续、土地使用权的取得进展、预计完成时间，是否存在取得障碍及对发行人本次发行上市的影响

（1） 发行人现有生产线及募投项目所涉相关产业政策规定

经本所律师核查，并根据发行人的说明，发行人主要从事半导体晶圆代工业务，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《战

战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），发行人所处行业为战略性新兴产业分类中的“新型电子元器件及设备制造”（分类代码：1.2.1）、“集成电路制造”（分类代码：1.2.4）及“电力电子基础元器件制造”（分类代码：6.5.2）。

经本所律师核查，《产业结构调整和指导目录（2011 年本）》及《产业结构调整和指导目录（2019 年本）》均将“半导体、光电子器件、新型电子元器件等电子产品用材料”列为鼓励类。

经本所律师核查，根据招股说明书（申报稿）及发行人提供的文件资料，发行人各条晶圆产线及本次募集资金运用围绕发行人主营业务进行，本次募投项目的实施有助于进一步扩大产能规模，增强研发实力，丰富工艺平台，以更好地满足市场需求、提升发行人在晶圆代工行业的市场地位和核心竞争力。对照《产业结构调整指导目录》，发行人各条晶圆产线（含 8 英寸产线升级项目）符合上述国家产业政策规定。

- (2) 发行人各条晶圆产线及募投项目建设运行履行的项目审批/备案、环评手续、土地使用权等审批备案情况

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及发行人出具的说明，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司各条晶圆产线及募投项目取得的主要审批/核准/备案、环评手续、土地使用权情况如下：

序号	晶圆	实施	项目名称	项目审批/	环评批复	土地
----	----	----	------	-------	------	----

	产线类别	主体		核准/备案		使用权
已建/在建项目						
1.	8英寸产线	上海华虹 宏力（一厂）	九〇九工程 8英寸0.5 微米集成电路 芯片生产线项目（已建）	计机轻 [1996]617号	环监 [1996]464号	已取得沪 （2020） 浦字不动 产权第 074885号 不动产权 证书
2.			上海华虹 NEC电子有 限公司集成 电路扩产项 目（已建）	信部规 [2000]1231号	环审 [2001]210号	
3.			上海华虹 NEC电子有 限公司增资 扩产项目 （已建）	发改高技 [2004]2745号	环审 [2004]175号	
4.			上海华虹 NEC电子有 限公司大功 率MOS集成 电路生产线 扩产项目 （已建）	沪外资委协 [2006]2638号	沪环保许管 [2006]974号	
5.		上海华虹	上海华虹 NEC电子有	发改高技 [2004]2745号	环审 [2004]175号	

		宏力 (二 厂)	限公司增资 扩产项目 (已建)			(2015) 第 010982 号不动产权 证书
6.		上海 华虹	上海宏力半 导体制造有 限公司工程 项目(已建)	沪外资委批字 (2000)第 67 号	环函 [2000]399 号	已取得沪 (2021) 浦字不动 产权第 132930 号 不动产权 证书
7.		宏力 (三 厂)	上海宏力半 导体制造有 限公司增资 扩产项目 (已建)	发改高技 [2008]2916 号	环审 [2008]298 号	
8.			华虹无锡 (已建)	新吴经发备 [2017]209 号	锡环表新复 [2018]473 号	
9.	12 英寸 产线	华虹 无锡	华虹半导体 (无锡)有 限公司扩产 项目(在建) (注)	锡新行审投备 [2020]1261 号	锡行审环许 [2020]7599 号	已取得苏 (2020) 无锡市不 动产权第 0178538 号不动产权 证书
10.			华虹半导体 (无锡)有 限公司一期 增资扩产 2.95 万片/ 月项目(在 建)	锡新行审投备 [2022]310 号	锡行审环许 [2022]7091 号	
募投/拟建项目						

1.	8 英寸项目	上海 华虹 宏力	8 英寸厂优化升级项目（拟建）	《上海市外商投资项目备案证明》（项目代码分别为 2208-310115-04-02-898613、2208-310115-04-02-347082、2208-310115-04-02-202491）	/	不涉及新增取得土地使用权，该项目在上述 1-7 项土地使用权范围内实施
2.	12 英寸项目	无锡 华虹 制造	华虹制造（无锡）项目（拟建）	锡新行审投备[2023]9 号	锡行审环许[2023]7005 号	相关手续办理进展详见下文

注：华虹半导体（无锡）有限公司扩产项目已完成竣工环保验收，目前尚有部分配套工艺设备仍在安装调试中。

经本所律师核查，就上述上海华虹宏力已建 8 英寸项目，根据发行人的说明，主管部门相关政策要求系于上海华虹宏力已建 8 英寸项目建成投产后开始实施，上述已建 8 英寸项目进行项目审批、核准等时间较早，因此不涉及违反主管部门相关政策要求的情况；本所律师进一步咨询了上海市张江科学城建设管理办公室（系上海华虹宏力部分已建 8 英寸项目的项目备案主管机构）相关工作人员，就其管理范围内项目，上海华虹宏力已依照规定办理项目备案，上海华虹宏力已履行项目信息告知义务，项目基本信息完整，未发现项目属于产业政策禁止投资建设或不属于项目备案机关权限的情形。

经本所律师核查，就本次募投项目之“8 英寸厂优化升

级项目”，根据发行人的说明，本项目已完成项目备案程序，不涉及新设项目、新增较大产能、新增取得土地使用权等情形，符合主管部门相关政策要求。

经本所律师核查，就本次募投项目之“华虹制造（无锡）项目”，根据发行人于 2023 年 1 月 18 日在香港联交所披露的《（1）有关合营协议、合营投资协议及土地转让协议的主要交易及（2）有关土地转让协议的关连交易》公告、发行人提供的文件资料及发行人的说明，“华虹制造（无锡）项目”建设地点位于无锡高新区（新吴区）内高新技术产业开发区内，华虹无锡将以其已取得的部分土地使用权转让予无锡华虹制造作为该项目的募投用地，转让总对价为 170,100,450 元（不包括税项）；前述转让的完成尚需履行发行人股东特别大会批准、取得抵押权人同意、相关主管部门的审批/登记/备案等程序，并需无锡华虹制造的各股东按照相关合资协议的约定向无锡华虹制造及时全部支付各自第一笔投资款。根据本所律师与发行人相关业务负责人的访谈及发行人的说明，预计无锡华虹制造将于 2023 年上半年完成该等土地使用权分割转让手续并取得不动产权证。

经本所律师核查，并根据发行人的说明，上海华虹宏力报告期内未受到立项、环保等主管部门的重大行政处罚。上海华虹宏力于 2022 年 4 月 16 日向上海市浦东新区生态环境局生态环境保护处出具《情况说明》，确认其自 2019 年 1 月 1 日以来生产经营不存在因违反环境保护法律、法规、规章及环境保护标准而受到行政处罚或不良记录的情形；上海市浦东新区生态环境局生态环境保护

处已盖章确认上海华虹宏力前述《情况说明》。根据上海市浦东新区城市管理行政执法局生态环境执法支队于2022年11月10日出具的《关于上海华虹宏力半导体制造有限公司环保行政管理情况的证明》，上海华虹宏力自2022年4月1日至2022年9月30日期间，在生产经营活动中能够遵守环境保护法律、法规或规章的规定，未发生环境污染事故，未涉及环境污染投诉，未有因违反环保相关法律、法规或规章的规定而受到环保部门行政处罚。根据本所律师于国家企业信用信息公示系统、信用中国、项目备案及环保主管部门官方网站的公开查询，截至本补充法律意见书出具之日，不存在上海华虹宏力因上述情形受到主管部门行政处罚的记录。

经本所律师核查，并根据发行人的说明，华虹无锡报告期内未受到立项、环保等主管部门的重大行政处罚。华虹无锡于2022年4月19日出具《情况说明》，确认其自2019年1月1日至2022年4月19日，未因违反生态环境方面的法律、法规及规章的规定而受到新吴区生态环境主管部门的行政处罚；无锡市新吴生态环境局已确认前述情况属实。华虹无锡于2022年10月24日出具《情况说明》，确认其自2022年4月1日至2022年9月30日，未因违反生态环境方面的法律、法规及规章的规定而受到新吴区生态环境主管部门的行政处罚；无锡市新吴生态环境局已确认前述情况属实。根据本所律师于国家企业信用信息公示系统、信用中国、项目备案及环保主管部门官方网站的公开查询，截至本补充法律意见书出具之日，不存在华虹无锡因上述情形受到主管部门行政处罚的记录。

基于上述核查，本所律师认为，发行人现有已实施晶圆生产线符合主管部门相关政策要求、已取得项目审批/核准/备案文件、环境影响评价相关事宜的批复、土地使用权；本次募投项目之“8英寸厂优化升级项目”已完成项目备案程序；“华虹制造（无锡）项目”符合主管部门相关政策要求、已取得项目备案文件及环境影响评价相关事宜的批复，后续将依法并根据协议约定办理土地使用权分割转让的相关手续；前述手续办理完成后，华虹制造（无锡）项目的项目建设不存在法律障碍，亦不会对本次发行造成不利影响。

## 2. 8英寸产线升级项目无需办理环评手续的规则依据

经本所律师核查，根据《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，建设项目的环境影响评价文件经批准后，在建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况下，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

基于上述核查并根据本所律师与上海市张江科学城建设管理办公室、上海金桥经济技术开发区管理委员会分管人员的咨询访谈及发行人出具的说明，鉴于集成电路行业技术更迭较快，发行人将在现有产能范围内根据未来技术发展及届时实际需求等情况逐步购置所需设备以实施本次募投项目之“8英寸厂优化升级项目”；预计该项目仅对现有生产线部分设备进行同等规模更新，不涉及对原有产能、生产工艺及排污等的增加。鉴于该项目仅对现有生产线部分设备进行同等规模更新，不涉及对原有产能、生产工艺及排污等的增加，因此无需重新办理环境影响评价程序。

(二) 新建 12 英寸产线项目实施主体股权结构可能发生变动的原因及具体安排，发行人保证自身控股股东地位的有效措施，少数股东是否拟同比例提供资金；募投项目涉及跨境资金流动的外商投资和外汇手续办理安排

1. 新建 12 英寸产线项目实施主体股权结构可能发生变动的原因及具体安排，发行人保证自身控股股东地位的有效措施，少数股东是否拟同比例提供资金

经本所律师核查，根据发行人于 2023 年 1 月 18 日在香港联交所披露的《（1）有关合营协议、合营投资协议及土地转让协议的主要交易及（2）有关土地转让协议的关连交易》公告、发行人提供的文件资料及发行人的说明，华虹制造（无锡）项目预计总投资额为 67 亿美元，投资金额较大，除发行人拟就该项目投入的 125 亿元募集资金外，发行人尚需自行或筹集较大金额的资金投入该项目；为筹措该项目建设资金，进一步扩大 12 英寸晶圆业务，并深化与大基金等相关主体的合作，强化发行人在各类晶圆领域的市场地位及竞争力，发行人、上海华虹宏力、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及无锡锡虹国芯投资有限公司签订相关合资协议，约定引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及无锡锡虹国芯投资有限公司等作为无锡华虹制造股东。

经本所律师核查，根据发行人于 2023 年 1 月 18 日在香港联交所披露的《（1）有关合营协议、合营投资协议及土地转让协议的主要交易及（2）有关土地转让协议的关连交易》公告、发行人提供的文件资料及发行人的说明，发行人、上海华虹宏力、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及无锡锡虹国芯投资有限公司将分别向无锡华虹制造投资 88,038 万美元、116,982 万美元、116,580 万美元及 80,400 万美元以分别持有无锡华虹制造 21.9%、29.1%、29%、20%的股权；各股东将按出资比例分三期对无锡华虹制造出资，

各期出资的主要付款条件如下：

付款进度	付款比例	主要付款条件
第一笔付款	15%	(1) 合资各方及无锡华虹制造内部已经批准该交易； (2) 发行人股东已批准本次交易； (3) 该交易及华虹制造（无锡）项目符合主管部门相关政策要求，并取得立项核准或备案文件； (4) 关于该交易的交易文件都已正式签署； (5) 工商变更等程序已完成。
第二笔付款	60%	(1) 合资各方第一笔出资全部缴纳完毕后九个月（或各方一致同意的其他期限）内； (2) 无锡华虹制造已办理完毕相应的国有资产产权登记； (3) 发行人已完成首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市。
第三笔付款	25%	合资各方第二笔出资全部缴纳完成后三个月内。

经本所律师核查，根据发行人于 2023 年 1 月 18 日在香港联交所披露的《（1）有关合营协议、合营投资协议及土地转让协议的主要交易及（2）有关土地转让协议的关连交易》公告、发行人提供的文件资料及发行人的说明，上述增资完成后，发行人及其全资子公司上海华虹宏力将合计持有无锡华虹制造 51% 的股权，而国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司和无锡锡虹国芯投资有限公司持股比例分别为 29% 和 20%，均未超过 30%；发行人同时有权提名

总经理和财务副总经理，可决定无锡华虹制造日常经营管理方面的重大事项。因此，发行人及上海华虹宏力仍可保持对无锡华虹制造的控股地位。

## 2. 募投项目涉及跨境资金流动的外商投资和外汇手续办理安排

经本所律师核查，根据《存托凭证跨境资金管理办法（试行）》的相关规定，境外发行人在境内发行股票，应在获得中国证监会核准发行后 10 个工作日内，委托其境内主承销商（或境内相关代理机构）到其上市境内证券交易所所在地国家外汇管理局分局或外汇管理部办理登记；境外发行人应在股票发行结束后 10 个工作日内，通过其境内主承销商（或境内相关代理机构）将更新后的登记表报送所在地外汇局。已办理登记的境外发行人，如需将募集资金汇出境外，应持业务登记凭证到开户行办理相关资金汇出手续；如将募集资金留存境内使用，应符合现行直接投资、全口径跨境融资等管理规定。

经本所律师核查，并根据发行人的说明，发行人本次发行募集的资金主要将留存境内使用，发行人可通过增资或提供股东借款的方式将募集资金投入具体使用该等资金的境内控股子公司，其中涉及的外商投资及外汇手续主要如下：

### (1) 向境内控股子公司增资

经本所律师核查，发行人以募集资金向外商投资企业性质的境内控股子公司增资的，需向市场监督管理部门申请办理变更登记（备案）手续，并于办理变更登记（备案）手续时通过企业登记系统向商务主管部门提交变更报告；被投资的境内控股子公司应向注册地银行就增资事宜申请办理外汇变

更登记。境内控股子公司在使用增资的资金时，还应当遵守外汇管理部门关于境内机构使用资本项目外汇收入的相关规定。

(2) 向境内控股子公司提供股东借款

经本所律师核查，发行人以募集资金向境内控股子公司提供借款的，使用该等资金的境内实施主体应当遵守跨境融资风险加权余额上限的限制，并应到外汇管理部门办理外债登记手续。

(三) 结合现有产能、主要客户、在手订单及下游市场需求等影响因素，量化分析募投项目新增产能消化的可行性；结合新增固定资产投资金额、募投项目预计建成时间和募投项目实施后新增折旧、摊销等具体测算对发行人经营业绩的潜在影响

1. 募投项目新增产能消化的可行性分析

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、招股说明书（申报稿），于报告期期末，发行人的产能利用率已饱和；目前市场主流晶圆尺寸为 8 英寸和 12 英寸，发行人亦主要生产前述尺寸的晶圆产品。根据 IC Insights 的预测数据，预计全球 2019-2024 年 8 英寸晶圆产能复合增速为 5%，全球各大晶圆厂 8 英寸产能增长较为缓慢，由于更大尺寸的晶圆更具规模经济，主流晶圆尺寸不断延伸，从 8 英寸转向 12 英寸已成为行业趋势。基于前述，随着各个产品线的不断上量以及国内市场需求日益旺盛，发行人目前已有的产能情况可能制约发行人的未来发展，因此发行人积极布局 12 英寸产能，通过扩大生产规模从而进一步提高市场竞争地位。

经本所律师核查，根据招股说明书（申报稿）、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的《华虹半导体制造（无锡）有限公司（筹）华虹制造（无锡）项目项目建设方案》，发行人的客户覆盖中国大陆、中国台湾地区、美国及欧洲等多地，产品广泛应用于汽车、通讯、工业、消费电子等多个终端领域。发行人目前已与多家全球排名前 50 名的芯片产品公司开展了业务合作，其中多家与发行人达成研发、生产环节的战略合作。丰富的全球客户资源以及多样化的终端市场，使得发行人可以较为准确地进行工艺平台技术研发以及更新升级，从而在市场竞争中保持领先优势。截至 2021 年底，发行人 12 英寸产线已导入客户近 200 家，其中已量产客户近百家；发行人已与多家国内外知名半导体设计公司建立战略合作关系，为后续业务发展打下坚实基础。

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及发行人的说明，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人在手订单金额约为 37.72 亿元，同时，发行人已与各大主要客户签署了框架协议，预计可支撑新增产能的消化。

经本所律师核查，根据招股说明书（申报稿），近年来，随着新能源汽车、工业智造、新一代移动通讯、物联网、新能源等新兴市场的不断发展，半导体行业市场规模整体呈现增长趋势。就国内半导体产业发展而言，一方面，国家陆续出台政策支持境内晶圆代工行业的发展，较好地满足上述国内半导体市场需求；另一方面，部分境内半导体设计企业积极寻找满足其需求的境内晶圆代工产能，以保证境内供应链持续稳定。在以上的产业环境下，预计未来中国境内晶圆代工行业产能需求将保持较高速的增长趋势。

基于上述核查，本所律师认为，本次发行募投项目新增产能消化预计不存在实质性障碍。

2. 本次发行募投项目新增固定资产投资情况等对发行人经营业绩的影响

经本所律师核查，根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的《华虹半导体制造（无锡）有限公司（筹）华虹制造（无锡）项目项目建设方案》，发行人募投项目之华虹制造（无锡）项目拟新增固定资产投资金额约 67 亿美元，该项目达产后预计每年新增折旧金额、年新增收入和利润总额情况如下：

单位：亿美元

项目	华虹制造（无锡）项目
预计年均新增折旧金额	5.79
预计年均新增收入金额	15.27
预计年均新增利润总额（注）	2.14

注：该等预计年均新增利润总额已考虑新增折旧的影响。

基于上述核查，本所律师认为，发行人上述募投项目建成后的资产折旧对发行人未来经营业绩不存在重大不利影响。

**五. 审核问询问题 12. 关于房地产业务：根据申报材料：（1）发行人的控股子公司无锡置业及联营企业华虹置业均具有房地产开发资质，经营范围均包含“房地产开发经营”，目前承诺为将在“最短时限内”或“及时”注销房地产开发资质；（2）无锡置业正在开发建设的“华虹无锡集成电路产业配套及人才用房”（以下简称无锡置业项目）系华虹无锡项目的配套保障，项目总面积 69,501**

平方米，宗地规划用途包括住宅、办公及少量商业和配套；（3）无锡置业项目住房定向销售给无锡市重大集成电路产业 12 英寸晶圆代工项目的管理人员、专业技术人员和相关人才，销售定价原则上将考虑土地成本、开发成本以及资金成本等因素予以合理确定，最高不超过 16,800 元/平方米（毛坯价格），购买人自产证办理后 5 年内不得上市交易，本项目商业配套、办公用房均由无锡置业自持；（4）华虹置业的“华虹创新园”项目系自华虹 NEC 处承接而来，土地用途为工业用地，华虹置业自持、出售或出租前述房产。请发行人说明：

（1）无锡置业项目建设的必要性及合理性、建设资金来源，不同宗地规划用途的面积，“管理人员、专业技术人员和相关人才”是否均为公司职工，是否保证职工在职期间及离职若干年后不得对公司员工以外人员销售（在此期间不为员工办理房屋产权证书）、仅以建设成本作为销售价格，住宅销售计划、商业配套及办公用房拟自持等全部安排是否已履行完毕所有相关手续；（2）华虹置业自持、出售、出租房产的具体情况，包括房产面积、具体用途、出售/出租的收入情况及定价依据等，华虹置业长期未完成土地增值税清算的原因，相关土地系工业用地但华虹置业持有《房地产开发企业暂定资质证书》《上海市商品房预售许可证》的原因；（3）测算无锡置业、华虹置业及发行人其他控股、参股公司（如有）涉及房地产业务的收入、净利润（参股公司的投资收益）占发行人合并报表收入、净利润的比重情况，房地产开发资质的预计注销时间；（4）发行人保障募集资金尤其是其中的补充流动资金不会用于房地产的有效措施。请保荐机构、发行人律师对上述事项及发行人涉房业务是否符合国家房地产调控政策的要求进行核查并发表明确意见。请发行人、保荐机构、发行人律师提交关于涉房业务的自查报告和专项核查报告。

（一）无锡置业项目建设的必要性及合理性、建设资金来源，不同宗地规划用途的面积，“管理人员、专业技术人员和相关人才”是否均为公司职工，是否保证职工在职期间及离职若干年后不得对公司员工以外人员销售（在此期间不为员工办理房屋产权证书）、仅以建设成本作为销售价格，住宅销售计划、商业配套及办公用房拟自持等全部安排是否已履行完毕所有相关手续

## 1. 无锡置业项目建设的必要性及合理性

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件材料，鉴于无锡市人民政府有意在无锡推动建设和发展集成电路制造基地，吸引企业和人才落户无锡，无锡市人民政府与华虹集团于 2017 年 8 月 2 日签订了《战略合作协议》，约定：1) 无锡市人民政府将全力支持华虹集团来无锡发展和投资，在无锡市新吴区提供符合华虹集团需求的生产制造、科研办公用地。2) 华虹集团将确定投资主体，在无锡市新吴区启动建设自主可控技术的集成电路研发和制造基地项目（以下简称“无锡基地项目”），以市场需求为导向，规划和分期建设数条 12 英寸集成电路生产线。3) 无锡市人民政府将无锡基地项目列入无锡市重大产业项目，为该项目提供所需办公和生活配套园区用地或提出其他可行的住房等生活设施保障措施，协调解决新设企业员工的生活配套等需求。

经本所律师核查，发行人及上海华虹宏力在无锡市设立华虹无锡以在当地建设 12 英寸晶圆产线；华虹无锡于 2020 年 9 月出资设立全资子公司无锡置业用于持有无锡基地项目所需的办公及居住用地，无锡置业于 2020 年 12 月 28 日与无锡市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，受让宗地面积为 69,501 平方米，宗地的用途为居住用地、办公用地（其中办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于 26%，且上浮不超过 1,000 平方米）。

经本所律师核查，华虹无锡及无锡置业系根据上述与无锡市人民政府签订的《战略合作协议》而设立的无锡基地项目建设主体，无锡置业项目系无锡市集成电路特别重大项目的组成部分，该项目的建设一方面有利于解决无锡市集成电路特别重大项目产业配套和人

才公寓问题，另一方面有利于满足华虹无锡员工在无锡当地安居乐业的现实需求，促进华虹无锡更好地保持团队稳定、吸引更多人才，推动华虹无锡快速发展并保持持续竞争力。

## 2. 无锡置业项目的建设资金来源及不同宗地规划用途的面积

### (1) 建设资金来源

经本所律师核查，根据无锡置业于 2020 年 12 月 28 日与无锡市自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》及相关付款凭证，无锡置业于 2020 年 12 月向无锡市国土资源交易中心支付国有建设用地使用权出让价款 6.7613 亿元。无锡置业已与招商银行股份有限公司无锡分行签订了《固定资产借款合同》，约定贷款种类为房地产开发贷款，贷款金额为 14 亿元，贷款期限自 2022 年 1 月 21 日至 2027 年 1 月 20 日，贷款用途为无锡置业项目非地价建设支出。截至 2022 年 9 月 30 日，无锡置业已支出建设资金 2.3 亿元，预计总建设资金 14.52 亿元，无锡置业项目资金来源主要为发行人及其控股子公司的自有资金及银行借款。

### (2) 不同宗地规划用途的面积

经本所律师核查，根据无锡置业于 2020 年 12 月 28 日与无锡市自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权出让合同》及无锡置业持有的不动产权证书，无锡置业持有相关土地的宗地总面积为 69,501 平方米，宗地的用途为居住用地、办公用地（其中办公核定建筑面积占总核定建筑面积的比例不小于 26%，且上浮不超过 1,000 平方米）。

经本所律师核查，根据无锡置业持有的《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》并经发行人说明，无锡置业项目的总面积为 201,043 平方米，其中：地上面积为 140,833 平方米，包含住宅面积 98,029 平方米，公建面积 42,751 平方米（其中办公面积 36,143 平方米，商业面积 3,305 平方米，配套用房面积 3,074 平方米，保温层面积 229 平方米），大门面积 53 平方米；地下面积为 60,210 平方米。

3. “管理人员、专业技术人员和相关人才”是否均为公司职工，是否保证职工在职期间及离职若干年后不得对公司员工以外人员销售（在此期间不为员工办理房屋产权证书）、仅以建设成本作为销售价格，住宅销售计划、商业配套及办公用房拟自持等全部安排是否已履行完毕所有相关手续

经本所律师核查，无锡置业项目目前尚处于开发建设阶段，就无锡置业项目的相关安排，发行人在 2022 年 8 月 14 日出具的原《关于房地产业务的承诺函》基础上，进一步增加了管理人员、专业技术人员和相关人才的定义、保证职工在职期间及离职若干年后不得对公司员工以外人员销售安排、仅以建设成本作为销售价格等内容，于 2023 年 1 月出具了更新后的《关于房地产业务的承诺函》，承诺在无锡置业作为发行人控股子公司期间，将履行如下承诺：

- (1) “本项目所涉住宅房产属于定向限价房，认购对象仅可以为无锡市重大集成电路产业的 12 英寸晶圆代工项目的管理人员、专业技术人员和相关人才（以下简称“相关人员”），相关人员仅限于本公司及本公司控制的子公司的员工，公司不会向员工以外的其他第三方销售该等房屋，也不会向社会公众销售，但由政府回购的除外；

- (2) 无锡置业将要求相关人员购房时签署相关承诺，承诺购买上述住宅房产的员工在职期间及离职2年内，不得对本公司员工以外的人员销售其购买的住宅房产，在此期间，本公司不为员工办理房屋产权证书；
- (3) 在本项目竣工后，无锡置业在转让住宅房产给员工时，销售定价将不高于根据土地成本、开发成本等核算确定的综合成本价。本公司出售相关住宅房产不以营利为目的；
- (4) 本项目商业配套均由无锡置业自持，仅用于本项目所需的食堂、小超市、健身房等，以满足社区的基本生活要求；
- (5) 本项目的办公用房仅由本公司及其控股子公司自持或政府回购，不向其他第三方出售；
- (6) 截至本承诺函出具之日，除本项目外，无锡置业不存在其他房地产开发业务或有关其他房地产开发项目的计划，目前及未来亦不会从事其他房地产开发业务；本项目尚处于开发建设阶段；
- (7) 本项目竣工后，在相关法律法规及主管部门允许的最短时限内，无锡置业将及时向主管部门提交房地产开发资质注销的相关申请资料，及时注销房地产开发资质，并删除经营范围中涉及“房地产开发”的有关内容；
- (8) 如本承诺函出具日后，国家关于房地产的相关政策发生变动，本公司将相应调整本承诺函的承诺事项；

(9) 本项目不会使用本公司本次发行的募集资金。”

经本所律师核查，根据发行人出具的上述房地产业务的承诺函，发行人已就无锡置业项目的相关房产作出安排，具体如下：

(1) “管理人员、专业技术人员和相关人才”是否均为公司职工

经本所律师核查，“管理人员、专业技术人员和相关人才”仅限于发行人及发行人控制的子公司的员工，发行人不会向相关人员以外的其他第三方销售住宅房产，也不会向社会公众销售住宅房产，但由政府回购的除外。

(2) 是否保证职工在职期间及离职若干年后不得对公司员工以外人员销售（在此期间不为员工办理房屋产权证书）

经本所律师核查，发行人已更新出具《关于房地产业务的承诺函》，发行人将要求购房员工购房时签署相关承诺，承诺其在职期间及离职2年内，不得对发行人员工以外的人员销售其购买的住宅房产；在此期间，发行人不为员工办理房屋产权证书。

(3) 仅以建设成本作为销售价格

经本所律师核查，发行人已更新出具《关于房地产业务的承诺函》，承诺无锡置业在转让住宅房产给员工时，销售定价将不高于根据土地成本、开发成本等核算确定的综合成本价。发行人出售相关住宅房产不以营利为目的。

- (4) 住宅销售计划、商业配套及办公用房拟自持等全部安排是否已履行完毕所有相关手续

经本所律师核查，根据无锡市新吴区人民政府与无锡置业分别于 2020 年 12 月 18 日签署的《投资发展监管协议》，无锡置业取得上述土地主要用于解决无锡市集成电路特别重大项目产业配套和人才公寓的问题；就上述无锡置业取得的相关土地，无锡置业必须要进行整体开发，不得分割转让，不得股权转让；上述土地上的办公用房须 50%自持；上述土地上的人才公寓销售价格最高限价为 16,800 元/平方米（毛坯房），应定向销售给无锡市重大集成电路产业的 12 英寸晶圆代工项目的管理人员、专业技术人员和相关人才，且购买人自产证办理五年内不得上市交易。在满足人才公寓需求后仍有余房，余房可由新吴区政府按照原核定价格回购。根据无锡市新吴区人民政府与无锡置业于 2022 年 7 月 28 日签署的《投资发展监管协议补充协议一》及无锡市新吴区人民政府于 2022 年 7 月 28 日出具的《关于华宏置业（无锡）有限公司清源路南侧地块项目用房相关情况的说明》，无锡置业项目土地上的办公用房应由发行人及其控股子公司 100%自持或政府回购，不得向第三方出售；上述土地上的商业用房均系满足社区基本生活的商业配套。

经本所律师核查，发行人已更新出具的《关于房地产业务的承诺函》的内容与无锡市新吴区人民政府和无锡置业签署的《投资发展监管协议》《投资发展监管协议补充协议一》及无锡市新吴区人民政府出具的《关于华宏置业（无锡）有限公司清源路南侧地块项目用房相关情况的说明》（以下合称“《监管协议》”）的内容比较如下：

序号	承诺函的内容	《监管协议》 的内容	差异情况	差异情况是 否会导致执 行障碍
1.	本项目所涉住宅房产属于定向限价房，认购对象仅可以为无锡市重大集成电路产业的 12 英寸晶圆代工项目的管理人员、专业技术人员和相关人才（以下简称“相关人员”），相关人员仅限于本公司及本公司控制的子公司的员工，公司不会向员工以外的其他第三方销售该等房屋，也不会向社会公众销售，但由政府回购的除外	人才公寓定向销售给无锡市重大集成电路产业的 12 英寸晶圆代工项目的管理人员、专业技术人员和相关人才。在满足人才公寓需求后仍有余房，余房可由新吴区政府按照原核定价格回购	发行人进一步明确了“无锡市重大集成电路产业的 12 英寸晶圆代工项目的管理人员、专业技术人员和相关人才”为发行人及发行人控制的子公司的员工	承诺函与《监管协议》不存在实质性冲突，差异情况不会导致执行障碍
2.	无锡置业将要求相关人员购房时签署相关承诺，承诺购买上述住宅房产的员工在职期间及离职 2 年内，不得对本公司	购买人自产证办理后 5 年内不得上市交易	承诺函主要是对产证办理的时间及产证办理前的对外销售进行约定，而《监管协议》则是对于产证办	承诺函与《监管协议》不存在实质性冲突，差异情况不

	员工以外的人员销售其购买的住宅房产，在此期间，本公司不为员工办理房屋产权证书		理后的交易情况进行约定，发行人及无锡置业将会同时遵守承诺函与《监管协议》的相关要求并促使相关员工遵守前述要求	会导致执行障碍
3.	在本项目竣工后，无锡置业在转让住宅房产给员工时，销售定价将不高于根据土地成本、开发成本等核算确定的综合成本价。本公司出售相关住宅房产不以营利为目的	人才公寓须全部为成品住宅，成品住宅装修按《成品住宅装修技术标准》执行，该地块人才房（毛坯房）销售最高限价为16800元/平方米	发行人承诺将按照成本价进行销售，根据发行人目前测算，人才房（毛坯房）的成本价预计将不超过16800元，承诺函与《监管协议》不存在实质性冲突	承诺函与《监管协议》不存在实质性冲突，差异情况不会导致执行障碍
4.	本项目商业配套均由无锡置业自持，仅用于本项目所需的食堂、小超市、健身房等，以满足社区的基本生活要求	“XDG-2020-71号”地块中所开发的商业用房均系落实无锡市新吴区人民政府整体招商引资方案，满足社区基本生活的商业配套	发行人进一步承诺商业配套均由无锡置业自持	承诺函与《监管协议》不存在实质性冲突，差异情况不会导致执行障碍

5.	本项目的办公用房仅由本公司及其控股子公司自持或政府回购，不向其他第三方出售	无锡置业在“XDG-2020-71号”地块的办公用房均应由华虹半导体及其控股子公司自持或政府回购，不得向第三方出售	不存在差异	不存在差异，不会导致执行障碍
6.	除本项目外，无锡置业不存在其他房地产开发业务或有关其他房地产开发项目的计划，目前及未来亦不会从事其他房地产开发业务；本项目尚处于开发建设阶段	未进行约定	仅发行人单方进行承诺，未违反《监管协议》的相关内容	差异情况不会导致执行障碍
7.	本项目竣工后，在相关法律法规及主管部门允许的最短时限内，无锡置业将及时向主管部门提交房地产开发资质注销的相关申请资料，及时注销房地产开发资质，并删除经营	未进行约定	仅发行人单方进行承诺，未违反《监管协议》的相关内容	差异情况不会导致执行障碍

	范围中涉及“房地产开发”的有关内容			
8.	如本承诺函出具日后，国家关于房地产的相关政策发生变动，本公司将相应调整本承诺函的承诺事项	未进行约定	仅发行人单方进行承诺，未违反《监管协议》的相关内容；若发行人后续对承诺进行调整且调整事项涉及《监管协议》的相关内容，发行人将与无锡市新吴区人民政府进一步协商沟通	差异情况不会导致执行障碍
9.	本项目不会使用本公司本次发行的募集资金	未进行约定	仅发行人单方进行承诺，未违反《监管协议》的相关内容	差异情况不会导致执行障碍

经本所律师核查，发行人住宅销售计划详见本补充法律意见书第一部分第五（一）3（1）（2）及（3）项；就商业配套及办公用房拟自持事宜，发行人已更新出具《关于房地产业务的承诺函》，承诺：“本项目商业配套均由无锡置业自持，仅用于本项目所需的食堂、小超市、健身房等，以满足社区的基本生活要求；本项目的办公用房仅由本公司及其控股子公司自持或政府回购，不向其他第三方出售。”

基于上述核查，本所律师认为，发行人已就该项目住宅销售计划、

商业配套及办公用房拟自持事宜更新出具《关于房地产业务的承诺函》，且无锡置业与无锡市新吴区人民政府签署《监管协议》对无锡置业房地产项目的相关事宜进行安排，《关于房地产业务的承诺函》与《监管协议》的差异情况不会导致执行障碍，发行人已就该项目住宅销售计划、商业配套及办公用房拟自持事宜履行完毕所有的相关手续。

- (二) 华虹置业自持、出售、出租房产的具体情况，包括房产面积、具体用途、出售/出租的收入情况及定价依据等，华虹置业长期未完成土地增值税清算的原因，相关土地系工业用地但华虹置业持有《房地产开发企业暂定资质证书》《上海市商品房预售许可证》的原因

1. 华虹置业自持、出售、出租房产的具体情况，包括房产面积、具体用途、出售/出租的收入情况及定价依据等

经本所律师核查，根据华虹置业提供的不动产权证书、租赁协议及房产出售协议并根据华虹置业的说明，华虹置业持有位于金桥出口加工区 51 街坊 2/3 丘的工业用地，分别于 2012 年 12 月 3 日、2013 年 8 月 21 日及 2014 年 6 月 27 日完成前述土地上的三期建设项目（以下简称“华虹创新园”）的竣工验收手续，并取得了沪（2021）浦字不动产权第 099317 号、沪（2021）浦字不动产权第 056284 号《不动产权证书》（其中土地的宗地面积为 107,893.2 平方米，土地用途为工业用地；房屋的建筑面积为 305,721.31 平方米，主要房屋用途为厂房）。华虹置业自持、出售、出租房产的具体情况如下：

单位：元

序号	情况	主要用途	面积/m <sup>2</sup> (注)	2019年度 收入	2020年度 收入	2021年度 收入	2022年1月 至9月收入	定价依据
1.	自持 房产	物业管理、办公	42,493.36	-	-	-	-	-
2.	出租 房产	厂房、研发办公、 宿舍	192,119.62	105,360, 463.79	114,776, 510.70	158,191, 171.60	108,197,23 1.70	参考周边 房产租赁 的定价， 依据华虹 置业制定 的租赁定 价方案确 定
3.	出售 房产	厂房、研 发办公	37,189.40	0	0	0	0	-

注：指截至2022年9月30日，华虹置业相应类别房产的面积。

## 2. 华虹置业长期未完成土地增值税清算的原因

经本所律师核查，《土地增值税清算管理规程》第九条规定纳税人符合下列条件之一的，应进行土地增值税的清算：（一）房地产开发项目全部竣工、完成销售的；（二）整体转让未竣工决算房地产开发项目的；（三）直接转让土地使用权的。《土地增值税清算管理规程》第十条规定，对符合以下条件之一的，主管税务机关可要求纳税人进行土地增值税清算：（一）已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上，或该比例虽未超过85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的；（二）取得销售（预售）许可证满三年仍未销售完毕的；（三）纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的；

（四）省（自治区、直辖市、计划单列市）税务机关规定的其他情况。

经本所律师核查，根据华虹置业的说明，由于华虹置业向第三方出售房产的相关转让登记手续尚未办理完毕，该项目的房产销售尚未完成，华虹置业不属于上述《土地增值税清算管理规程》第九条规定的应当进行土地增值税清算的情形；华虹置业的主管税务机关已于 2022 年 7 月通知华虹置业进行土地增值税清算，华虹置业预计将于 2023 年上半年完成相关手续。

3. 相关土地系工业用地但华虹置业持有《房地产开发企业暂定资质证书》《上海市商品房预售许可证》的原因

经本所律师核查，根据《城市房地产开发经营管理条例》的规定，房地产开发经营指房地产开发企业在城市规划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设，并转让房地产开发项目或者销售、出租商品房的行为；房地产开发企业拟预售商品房（参考上海市房屋土地管理局印发的《新建商品房用地面积分摊技术规定》，商品房亦包含标准厂房），应当取得预售许可证明。根据《房地产开发企业资质管理规定》的规定，房地产开发企业应当按照该规定申请核定企业资质等级（包括暂定资质证书），未取得房地产开发资质等级证书的企业，不得从事房地产开发经营业务。前述规定均未禁止对工业用地进行开发利用的相关企业办理《房地产开发企业暂定资质证书》《上海市商品房预售许可证》。

经本所律师核查，华虹置业持有的工业用地主要用于开发建设“华虹创新园”项目，除华虹置业自持部分房产及历史上曾出售部分房产外，“华虹创新园”的相关厂房目前主要用于出租给第三方。华虹置业已取得上海市浦东新区发展和改革委员会、上海市浦东新区

科技和经济委员会、上海市浦东新区规划和自然资源局于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于认定上海华虹置业有限公司为浦东新区产业园区开发平台公司有关事项的通知》，前述单位已认定华虹置业为浦东新区产业园区开发平台公司（指承担上海市、区级各类园区建设、运营管理的平台型公司），并要求华虹置业在开发运营过程中严格落实土地全生命周期管理，实行整体开发，服务实体经济，满足优秀企业发展空间需求，提升科创研发功能，促进园区能级提升。

经本所律师核查，根据华虹置业提供的房产出售协议及房产租赁协议并根据华虹置业的说明，华虹置业开发建设“华虹创新园”及出售部分房产属于《城市房地产开发经营管理条例》《房地产开发企业资质管理规定》规定的需办理房地产开发企业资质证书、商品房预售许可证的情形，因此相应办理了《房地产开发企业暂定资质证书》《上海市商品房预售许可证》等证书。

- (三) 测算无锡置业、华虹置业及发行人其他控股、参股公司（如有）涉及房地产业务的收入、净利润（参股公司的投资收益）占发行人合并报表收入、净利润的比重情况，房地产开发资质的预计注销时间

#### 1. 房地产业务收入及净利润占比情况

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件材料，报告期内发行人控股子公司及参股公司中仅无锡置业、华虹置业涉及房地产业务，报告期内，无锡置业房地产业务收入目前未产生任何收入，华虹置业房地产业务收入占发行人营业收入的比例分别为 1.62%、1.70%、1.49%和 0.88%；无锡置业房地产业务净利润占发行人归属于母公司所有者的净利润的比例分别为 0%、-0.28%、-1.37%和 -0.91%，华虹置业房地产业务净利润占发行人归属于母公司所有者

的净利润的比例分别为 1.32%、3.46%、1.94%和 1.13%。

经本所律师核查，根据发行人说明，无锡置业项目预计于 2024 年竣工，并将于 2024 年开始对员工进行销售，计划于 2027 年完成销售。发行人预计 2024 年至 2027 年期间无锡置业的房地产业务收入分别约为 5.14 亿元、5.14 亿元、5.14 亿元及 1.71 亿元，预计占发行人届时相应年度营业收入的比例均不超过 10%，各年度预计销售收入的的具体情况如下表所示：

单位：亿元

项目	销售预计	2024 年度	2025 年度	2026 年度	2027 年度
住宅 销售	住宅计容面积合计 96,720 平方米，计 划按 30%, 30%, 30%, 10%分四年出售	4.79	4.79	4.79	1.60
车位 销售	约 840 个车位，销售 计划与住宅同步	0.35	0.35	0.35	0.12
<b>合计</b>		<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	<b>5.14</b>	<b>1.71</b>

注：合计数与各部分数直接相加之和如存在尾数差异，系由四舍五入原因造成

## 2. 房地产开发资质的预计注销情况

经本所律师核查，就无锡置业持有的房地产开发资质，发行人已出具《关于房地产业务的承诺函》，承诺无锡置业房地产项目竣工后，在相关法律法规及主管部门允许的最短时限内，无锡置业将及时向主管部门提交房地产开发资质注销的相关申请资料，及时注销房地

产开发资质。

经本所律师核查，就华虹置业持有的房地产开发资质，华虹置业已出具《关于房地产业务的承诺函》，承诺华虹置业将于完成土地增值税的清算后，及时向主管部门提交《中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书》注销的相关申请资料并注销前述资质，且华虹置业将不再使用《上海市商品房预售许可证》（经与主管部门沟通，华虹置业无法主动注销该资质）。根据华虹置业的说明，华虹置业的主管税务机关已于 2022 年 7 月通知其进行土地增值税清算，华虹置业预计将于 2023 年上半年完成相关手续。

(四) 发行人保障募集资金尤其是其中的补充流动资金不会用于房地产的有效措施

经本所律师核查，根据发行人说明，截至本补充法律意见书出具之日，无锡置业项目的土地出让金已全额支付，且发行人及其控股子公司的自有资金、银行借款已为后续的开发建设提供了充足的资金储备，无锡置业项目不存在资金不足的情形；除无锡置业项目外，无锡置业不存在其他房地产开发业务或有关其他房地产开发项目的计划，目前及未来亦不会从事其他房地产开发业务，待无锡置业项目竣工后，在相关法律法规及主管部门允许的最短时限内，无锡置业将及时注销房地产开发资质，并删除经营范围中涉及“房地产开发”的有关内容。

经本所律师核查，发行人首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后的净额计划投入华虹制造（无锡）项目、8 英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金，发行人亦已出具《关于房地产业务的承诺函》承诺无锡置业项目不会使用发行人本次发行的募集资金；前述投向均不涉及房地产项目。发行人已制定了《华虹半导体有限公司募集资金管理制度》，未来募集资金将存放于募集资金专户集中管

理，并由发行人与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；发行人将按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，发行人董事会、保荐机构亦将对募集资金的存放及使用情况持续监督并进行定期披露，前述措施可以保障募集资金不会用于房地产业务。

基于上述核查，本所律师认为，发行人已采取相应措施保障募集资金尤其是其中的补充流动资金不会用于房地产开发。

(五) 发行人涉房业务是否符合国家房地产调控政策的要求

经本所律师核查，国务院及中国证监会对涉房企业上市融资的主要国家房地产调控政策要求如下：

序号	法规名称	主要监管要求	情况
1.	《国务院 关于促进 节约集约 用地的通 知》（国 发 [2008]3 号）	加强对节约集约用地工作的监管。国土资源部要会同监察部等有关部门持续开展用地情况的执法检查，重点查处严重破坏、浪费、闲置土地资源的违法违规案件，依法依规追究有关人员的责任。要将企业违法用地、闲置土地等信息纳入有关部门信用信息基础数据库。金融机构对房地产项目超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年，完成土地开发面积不足1/3或投资不足1/4的企业，应审慎贷款和核	发行人及其控股子公司与华虹置业报告期内不存在超过土地出让合同约定的动工开发日期满一年，完成土地开发面积不足1/3或投资不足1/4的情形，不存在严重破坏、浪费、闲置土地资源

		准融资，从严控制展期贷款或滚动授信；对违法用地项目不得提供贷款和上市融资，违规提供贷款和核准融资的，要追究相关责任人的责任。	的违法违规行 为。
2.	《国务院 关于坚决 遏制部分 城市房价 过快上涨 的通知》 (国发 [2010]10 号)	加强对房地产开发企业购地和融资的监管。国土资源部门要加大专项整治和清理力度，严格依法查处土地闲置及炒地行为，并限制有违法违规行为的企业新购置土地。房地产开发企业在参与土地竞拍和开发建设过程中，其股东不得违规对其提供借款、转贷、担保或其他相关融资便利。严禁非房地产主业的国有及国有控股企业参与商业性土地开发和房地产经营业务。国有资产和金融监管部门要加大查处力度。商业银行要加强对房地产企业开发贷款的贷前审查和贷后管理。对存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业，商业银行不得发放新开发项目贷款，证监部门暂停批准其上市、再融资和重大资产重组。	发行人及其控 股子公司与华 虹置业报告期 内不存在土地 闲置及炒地行 为。
3.	《国务院 办公厅关 于继续做	对存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的房地产开发企业，有关部门要建	发行人及其控 股子公司与华 虹置业报告期

	好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17号）	立联动机制,加大查处力度。国土资源部门要禁止其参加土地竞买,银行业金融机构不得发放新开发项目贷款,证券监管部门暂停批准其上市、再融资或重大资产重组,银行业监管部门要禁止其通过信托计划融资。	内不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。
4.	《上市一部关于上市公司并购重组、再融资涉及房地产业务提交相关报告的函》（上市一部函〔2013〕591号）	上市公司并购重组、再融资涉及房地产业务时（房地产行业上市公司、非房地产行业上市公司通过再融资募集资金投向涉及住宅房地产开发业务或重大资产重组置入住宅房地产开发业务），在向证监会提交行政许可申报材料时，同时分别提交涉及用地和商品房开发的专项核查报告，核查是否涉及闲置用地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。	本次发行不涉及上市公司并购重组、再融资，本次募投资金亦不涉及用于房地产项目的开发建设，因此不涉及提交土地及商品房开发的专项核查报告。发行人及其控股子公司与华虹置业报告期内不存在闲置用地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。
5.	《证监会调整上市公司再融	上市公司申请涉房类再融资、并购重组项目时，应当公开披露报告期内相关房地产企业是否存	经查询国土资源部门网站，发行人及其控股

	<p>资、并购重组涉及房地产业务监管政策》(2015年1月16日)</p>	<p>在违法违规行为,是否存在被行政处罚或正在被(立案)调查的情况,以及相应整改措施和整改效果。上市公司的董事、高级管理人员及其控股股东、实际控制人或者其他信息披露义务人(包括上市公司重大资产重组或发行股份购买资产的交易对方)应当在信息披露文件中作出公开承诺,相关房地产企业如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资者造成损失的,将承担赔偿责任。</p> <p>保荐机构或独立财务顾问、律师应当出具专项核查意见。在专项核查意见中明确说明是否已查询国土资源部门网站,相关房地产企业是否存在违法违规行为,是否存在被行政处罚或正在被(立案)调查的情况。</p> <p>涉房企业申请首次公开发行股票参照上述政策执行。</p>	<p>子公司与华虹置业报告期内不存在因违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)调查的情况。</p>
6.	<p>《科创属性评价指引(试行)》(中国证券监督管理委员会</p>	<p>限制金融科技、模式创新企业在科创板上市。</p> <p>禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。</p>	<p>发行人主要从事半导体晶圆代工业务,根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-20</p>

	员会公告 [2021]8 号)		17)，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。发行人不属于房地产企业，符合监管要求。
7.	证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问	<p>一、恢复涉房上市公司并购重组及配套融资。允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产；发行股份购买资产时，可以募集配套资金；募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司，参照房地产行业上市公司政策执行，支持“同行业、上下游”整合。</p> <p>二、恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资。</p> <p>三、调整完善房地产企业境外市场上市政策。与境内 A 股政策保</p>	未对发行人上市进行限制。

		<p>持一致，允许以房地产为主业的 H 股上市公司再融资；允许主业非房地产业务的其他涉房 H 股上市公司再融资。</p> <p>三、调整完善房地产企业境外市场上市政策。与境内 A 股政策保持一致，允许以房地产为主业的 H 股上市公司再融资；允许主业非房地产业务的其他涉房 H 股上市公司再融资。</p>	
--	--	---	--

经本所律师核查，根据无锡市自然资源和规划局于 2022 年 4 月 24 日及 2022 年 11 月 3 日出具的《核查证明》，无锡置业从 2020 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，在该市范围内不存在因为违反土地管理法律法规而受到行政处罚的情形。根据无锡市住房和城乡建设局于 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 10 月 31 日出具的《证明》，无锡置业自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日未发生因违反住建领域相关法律法规规章受该局行政处罚的情形。

基于上述核查，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，发行人涉房业务符合上述国家房地产调控政策的要求。

- 六. 审核问询问题 13. 关于公司治理差异与投资者保护：根据申报材料：发行人现行公司治理结构与适用境内法律、法规和规范性文件的上市公司在利润分配机制、重大事项决策程序、剩余财产分配、三会设置及具体职责等方面存在一定差异。如发行人董事会有权审议部分应由 A 股上市公司股东大会审议的事项，发行人未设置监事会，独立董事的任职年限、兼任公司数量及连任时间等与境内存在差异，董事会可自行选出董事以填补临时空缺或增加董事名额等。**

请发行人说明：（1）结合境内法律法规及规范性文件对包括但不限于上述公司治理结构和内部控制制度的规定，逐项比对发行人相关制度的建立情况及具体差异，是否满足投资者权益保护水平总体上不低于境内法律、法规规定的要求；（2）本次发行形成的股本溢价是否属于可向投资者进行股利分配的科目，发行人关于募集资金监管的措施及其有效性；（3）发行人是否设置了A股、H股类别股东分类表决制度或其他相比普通股股东的特殊权利，是否符合现行监管要求；（4）结合境内外相关法律法规规定等，说明境内投资者向发行人及相关主体提起境内外诉讼的事项范围、程序，以及相关裁决的可执行性，是否制定了相应的保障措施。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

（一）结合境内法律法规及规范性文件对包括但不限于上述公司治理结构和内部控制制度的规定，逐项比对发行人相关制度的建立情况及具体差异，是否满足投资者权益保护水平总体上不低于境内法律、法规规定的要求

经本所律师核查，根据《国务院办公厅转发证监会〈关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见〉的通知》（国办发〔2018〕21号）及《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》（证监会公告〔2018〕13号）等相关法律法规的规定，试点红筹企业股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定，但关于投资者权益保护的安排，包括资产收益、参与重大决策、剩余财产分配等权益，总体上应不低于中国境内法律、行政法规以及中国证监会规定的要求。发行人现有治理架构以及目前执行的公司治理制度主要是根据注册地、境外上市地相关适用法律法规及证券监管机关要求而搭建和制定的。发行人相关制度的建立情况及与境内法律法规及规范性文件要求的具体差异主要如下：

事项	境内相关法律法规规定	发行人相关制度、发行人注册地、境外上市地相关适用法律法规规定	比较结果
利润分配政策	<p>《公司法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》对公司利润分配的规定主要如下：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前述规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会或者董事会违反上述规定，在公司</p>	<p>《公司条例》规定公司应以利润为来源支付股息，此外《公司条例》中并无《公司法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》对于前述利润分配前法定扣减事项等的相关规定或限制。根据《公司章程（A股上市后适用稿）》的相关规定，在适用法律法规、上市规则及遵守股东于股东大会上以普通决议案批准之任何股息分配计划之规限下，发行人可透过普通决议案宣派股息，惟该等股息不得超过董事会建议之额度。股息只能从发行人可供分派之溢利或其他可分配之储备中支付。</p> <p>为保障股东权益，发行人董事会及股东大会已经批准了《华虹半导体有限公司首次公开</p>	<p>发行人的利润分配政策系根据《公司条例》等发行人注册地、境外上市地相关适用法律法规制定，与一般根据《公司法》设立并在中国境内注册登记的A股上市公司（以下简称“境内A股上市公司”）的利润分配政策相比更为灵活。除此之外，发行人的利润分配政策与境内法律法规及规范性文件要求不存在实质差异。</p>

	<p>弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不得分配利润。</p>	<p>发行人民币普通股（A 股）并在上海证券交易所科创板上市后三年股东分红回报规划》，对本次发行后三年内发行人股东分红回报规划原则、利润分配形式、现金分红条件、现金形式分红的比例与时间间隔、发放股票股利的条件、利润分配的决策程序和机制等内容进行了规定，具体如下：</p> <p>“一、股东分红回报规划的原则</p> <p>公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立非执行董事和公众投资者的意见。</p> <p>二、股东分红回报规划的具体方案</p>	
--	--	---	--

		<p>(一) 公司的利润分配形式</p> <p>公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规及规范性文件允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>(二) 公司现金分红的条件</p> <p>在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：</p> <p>1、公司累计未分配利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司持续经营和长期发展的需要；</p>	
--	--	--	--

		<p>2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（本次发行的募集资金投资项目除外）；</p> <p>4、满足法律、法规及规范性文件规定的其他现金分红条件。</p> <p>（三）公司现金形式分红的比例与时间间隔</p> <p>在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配</p>	
--	--	---	--

		<p>利润的 30%。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在满足现金分红条件的前提下，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>3、当公司发展阶段属成长期且有重大资金支</p>	
--	--	---	--

		<p>出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p> <p>当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p>（四）发放股票股利的条件</p> <p>若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出实施股票股利分配预案。采用股票股利进行股利分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。</p>	
--	--	---	--

		<p>(五) 利润分配的决策程序和机制</p> <p>公司董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事项，独立非执行董事应当发表明确意见。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东（尤其是中小股东）进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。</p> <p>(六) 公司利润分配政策调整的决策机制和程序</p> <p>公司认为确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的，应当将修订后的利润分配政策提交股东大会审议。</p> <p>公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红</p>	
--	--	--	--

		政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定执行。”	
发行人未设置监事会	<p>根据《公司法》及《上市公司章程指引(2022年修订)》的相关规定,境内A股上市公司按照规定设有监事会,监事会可行使如下职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;</p> <p>(二)检查公司财务;(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(六)向股东大会提出提</p>	<p>发行人已依据《香港上市规则》的相关规定建立了独立非执行董事制度,于本补充法律意见书出具之日,发行人董事会由8名董事组成,其中包括3名独立非执行董事。根据《香港上市规则》的相关规定,独立非执行董事的主要职权包括:参与董事会会议,在涉及策略、政策、公司表现、问责性、资源、主要委任及操守准则等事宜上,提供独立的意见;在出现潜在利益冲突时发挥牵头引导作用;应邀出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;仔细检查公司的表现是否达到既定的企业目标和目的,并监察汇报公司表现;出席股东大会;每年审核持续关连交易,并就有关交易或安排的条款是否公平合理,以及有关交易或安排是否符合发行人</p>	<p>发行人目前聘任了独立非执行董事并设置了审核委员会等董事会下设专门委员会,其可以有效替代行使监事会的大部分职责。同时,根据《公司条例》《香港上市规则》等相关规定及发行人的相关公司治理制度,前述规定通过给予相关股东股东大会召集权及提案权、股东提起派生诉讼的权利等措施保障投资者的相关权益。因此,发行人未设置监事会不会导致发行人对投资者保护造成不利</p>

	<p>案：（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）公司章程规定的其他职权。</p> <p>根据《公司法》的相关规定，监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。</p> <p>根据《证券法》的相关规定，发行人的监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见。</p>	<p>及其股东整体利益而向股东给予意见。本次发行后，发行人适用法律法规、《香港上市规则》及本次发行后适用的公司治理制度等有关规定要求发行人独立非执行董事就相关事项发表意见或履行相应职责的，发行人的独立非执行董事将遵照执行。《香港上市规则》等相关规定对独立非执行董事的任职资格、职权等方面的要求与境内独立董事相关规定存在差异，但境内相关规定与《香港上市规则》均要求上市公司董事会中独立董事（独立非执行董事）至少占董事会成员人数的三分之一，且至少一名独立董事（独立非执行董事）必须具备适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长；同时，《香港上市规则》等相关规定要求独立非执行董事发表意见的关联交易、并购重组、重大投融资活动等事项与境内相关规定要求独立董事发表意见的事项一致。</p>	<p>影响。</p>
--	---	---	------------

	<p>监事应当签署书面确认意见。发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。</p>	<p>发行人已依据《香港上市规则》的相关规定设置了审核委员会等董事会下设专门委员会。根据《华虹半导体有限公司审核委员会的职权范围》，审核委员会委员有权审阅发行人的财务资料；监管发行人的财务申报制度、风险管理及内部监控系统；对于涉及高级管理人员的欺诈行为、导致财务报表重大误报的欺诈行为以及涉及在内部监控体系中担任重要职务的管理人员或其他员工的欺诈行为，与管理层、内部审计及外部审计师共同探讨其性质及影响。任何能协助委员会履行董事会所给予的权力及职责之事项。</p> <p>根据《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）股东大会事规则》，在一股一票的基准下，单独或者合计持有发行人发行在外有表决权股份总数的5%</p>	
--	---	---	--

		<p>或以上股份的股东有权向董事会请求召开股东大会。单独或合并持有发行人发行在外有表决权股份总数的 3%以上（含 3%）有权提出提案。</p> <p>根据《公司章程》等相关规定，如果董事、高级管理人员对公司作出不当行为，包括欺诈、疏忽、违反规定或责任等情形，经法院许可，公司股东名册所登记的股东可代表公司提起衍生诉讼。</p> <p>发行人本次发行后适用的《审核委员会的职权范围》规定，审核委员会的职责包括：监察发行人的财务报表以及年度报告及账目、半年度报告及（若拟刊发）季度报告的真实性和完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见。</p>	
--	--	---	--

		<p>发行人本次发行后适用的《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）信息披露管理制度》规定，发行人的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。</p>	
<p>股东大会、董事会具体职责</p>	<p>《公司法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》对于股东大会和董事会的职权进行了明确规定，其中由股东大会审议的事项包括：（1）决定公司的经营方针和投资计划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会报告；（5）审议批</p>	<p>发行人已结合《公司条例》《香港上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》《科创板上市规则》等相关规定，对《公司章程》进行了修订，同时修订了《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）股东大会议事规则》《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）董事会议事规则》等相关治理制度，明</p>	<p>发行人未设置监事及监事会，因此发行人股东大会审议事项不包括选举或更换监事、审议批准监事会报告等不适用于发行人的事项。根据《公司章程（A股上市后适用稿）》，在适用法律、上市规则允许的范围</p>

	<p>准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；(8) 对发行公司债券作出决议；(9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(10) 修改公司章程；(11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(12) 审议批准相关法律法规或公司章程规定须经股东大会审议通过的担保事项；(13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；(14) 审议批准变更募集资金用途事项；(15) 审议股权激励计划；(16) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。《科创板上市规则》等相关规定亦列举了应当提请股东大会</p>	<p>确定了股东大会、董事会等机构的权责范围和工作程序，前述修订将于发行人本次发行完成后生效。</p> <p>根据《公司章程（A 股上市后适用稿）》，在适用法律法规、上市规则、本章程细则规定下，本公司股东大会可行使下列职权：(a) 审议批准本公司增加已发行在外股份总数（包括发行股票（含优先股）、可转换为股份的证券、认股权证等影响本公司股本的证券）；(b) 注销于有关决议案通过当日仍未被任何人士认购或同意认购的任何股份；(c) 任命及罢免董事（在适用法律法规及本章程细则中允许董事会任命或罢免的情况除外）；(d) 批准在合同规定权益外，因免职或退休而向任何董事或前任董事支付任何补偿；(e) 审议批准本公司的股息分派方案；(f) 审议</p>	<p>内，发行一般债券（须取得股东批准的可换股债券发行除外）等事项将由董事会决定，而根据境内相关规定，境内 A 股上市公司一般需将前述事项提交股东大会审议。但关于发行人增加已发行在外股份总数（包括发行股票（含优先股）、可转换为股份的证券、认股权证等影响发行人股本的证券）、减少发行人已发行在外股份总数（包括股东在股东大会上授予的一般授权未涵盖的任何股票赎回或回购）、发行人的股息分派方案、发行人业务的根本变</p>
--	---	--	---

	<p>会审议的重大交易、重大对外担保以及重大关联交易等事项的具体标准。</p>	<p>批准董事会的年度报告；（g）决定本公司业务的根本变化；（h）对本公司聘用、解聘负责年审的核数师作出决议；（i）审议批准适用法律法规、上市规则规定应当由股东大会批准的对外担保；（j）审议批准本公司的股权激励计划和员工持股计划；（k）审议批准适用法律法规及上市规则规定的应当由股东大会批准的重大交易；（l）审议批准适用法律法规及上市规则规定的应当由股东大会批准的关连或关联交易；（m）在遵守适用法律法规、本章程细则及公司条例其他要求的基础上，减少本公司已发行在外股份总数（包括股东在股东大会上授予的一般授权未涵盖的任何股票赎回或回购）；（n）批准修改本章程细则，或者通过本公司新章程细则；（o）审议批准本公司在一年内购买或出售重大资产超过本公司最近一期经审计总资产 30%的</p>	<p>化、修改公司章程或通过新公司章程、发行人合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式等发行人重大事项的审议权限仍归属于股东大会；同时，发行人董事由股东大会任命和罢免（在适用法律法规及《公司章程（A 股上市后适用稿）》中允许董事会任命或罢免的情况除外）。因此《公司章程（A 股上市后适用稿）》等本次发行后适用的公司治理制度中关于发行人股东大会及董事会职权的规定未损害股东参与发行人重大决策的权利。</p>
--	---	--	--

		<p>事项；（p）审议批准适用法律法规及规范性文件、上市规则规定的须由股东大会批准的变更募集资金用途事项；（q）批准本公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式；（r）批准任何主动撤回股票在现有证券交易所的交易，并决定不再在现有证券交易所交易，或转而申请在其他股份交易平台买卖或转让；（s）审议批准适用法律法规、上市规则、本章程细则及其他规定订明由股东大会审议批准的其他事项。</p> <p>在适用法律法规、上市规则允许范围内，股东大会可通过适当程序将有关职权授予董事会行使。若适用法律法规、上市规则允许任何事项以股东书面同意或决议形式代替股东大会批准，则本条不应被视为要求该等事项必须以股东大会形式批准。</p>	
--	--	--	--

		<p>根据适用法律法规、上市规则、本章程细则及本公司股东大会议事规则的规定，股东大会审议事项以普通决议或特别决议通过。不拘于本章程细则的其他约定，若适用法律法规、上市规则、本章程细则或本公司股东大会议事规则规定某些决议需经有权投票的公司股东在股东大会亲身或（若允许委任代表）由受委任代表或（如股东为公司）由其正式授权的代表以不少于出席会议股东所持表决权三分之二的票数通过，则从其规定。</p>	
<p>剩余财产分配</p>	<p>根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，应按照股东持有的股份比例进行分配。</p>	<p>根据《公司章程（A股上市后适用稿）》，如发行人清盘，偿付所有债权人后的剩余资产应按股东所持股份之已缴股本比例分派予股东，及如剩余资产不足以偿还全部已缴股本，则该等资产之分派将尽量按股东所持股份之已缴股本比例分担亏损。然而，该条受可能按特别条款及条件发行之任何股份的持</p>	<p>不存在实质差异。</p>

		有人权利所限制。	
独立非执行董事任职年限、数量、时间等要求	根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。	在独立非执行董事任职方面，《香港上市规则》要求上市公司董事会必须包括至少三名独立非执行董事，独立非执行董事至少占董事会成员人数的三分之一。若独立非执行董事在任已过9年，其是否获续任应以独立决议案形式由股东审议通过。	发行人关于独立非执行董事任职年限等相关制度系根据《香港上市规则》的相关规定设置，其中独立非执行董事数量与境内相关法律法规的规定不存在实质差异；《香港上市规则》对独立非执行董事的任职年限、连任时间等规定长于境内相关规定的要求，但如在任时间已过9年的，是否获续任应以独立决议案形式由股东审议通过，前述差异未实质影响发行人独立非执行董事的独立性。
董事选举	根据《上市公司章程指引（2022年修订）》	根据《公司章程（A股上市后适用稿）》，	根据《公司章程（A股上市

	<p>《科创板上市规则》的相关规定：</p> <p>(1) 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务；该等决议由股东大会以普通决议通过；</p> <p>(2) 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向股东大会提出提案，提名董事候选人；</p> <p>(3) 董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。</p>	<p>在适用法律法规、上市规则、《公司章程》规限下，发行人股东大会可任命及罢免董事（在适用法律法规及《公司章程》中允许董事会任命或罢免的情况除外）。</p> <p>根据《公司章程（A 股上市后适用稿）》，董事会可委任愿意担任董事职位之人士为董事，以填补空缺或作为新增董事，惟该等委任不应导致董事人数超出已定上限。任何按此获委任的董事仅任职至本公司在其获委任后的首个股东周年大会为止，并于该大会上合资格膺选连任，惟于厘定将于会上轮换卸任的董事或董事人数时不会计入其中。</p>	<p>后适用稿)》，董事会可自行选出董事以填补临时空缺或增加董事名额，与 A 股上市公司董事产生的程序要求存在差异。但董事会委任的董事至下一次股东周年大会召开时仍需经股东周年大会审议后方可连任，上述制度安排系对董事席位空缺或为完善董事会成员结构的情况下，对董事会成员的补足机制，增补董事有利于完善公司决策机制，实质上不会损害投资者的权益。</p>
--	---	---	---

基于上述核查，本所律师认为，虽存在上述差异，发行人本次发行后适用的公司治理制度对境内投资者权益的保护总体上不低于境内法律法规及中国证监会的要求。

(二) 本次发行形成的股本溢价是否属于可向投资者进行股利分配的科目，发行人关于募集资金监管的措施及其有效性

经本所律师核查，根据 HSF 于 2022 年 12 月出具的《备忘录》，2014 年 3 月 3 日生效的《公司条例》废除了香港注册公司票面价值和股本溢价的概念，股票发行的收益将记入公司股本科目，公司仅能从“可供分派的利润”中进行股利分配。根据发行人的说明并经安永华明确认，本次发行募集的资金（包括股本溢价）将计入股本科目，不属于“可供分派的利润”。

经本所律师核查，根据发行人分别于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 27 日召开之董事会会议及股东特别大会审议通过的《人民币股份发行及特别授权》《关于人民币股份发行募集资金用途之建议》，公司针对本次 A 股发行的募集资金投向已有明确的规定，本次发行上市的募集资金将用于公司主营业务，具体将用于华虹制造（无锡）项目、8 英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金。

经本所律师核查，发行人于 2022 年 5 月 12 日召开之董事会审议通过了《HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED（华虹半导体有限公司）募集资金管理制度》，该制度适用于发行人在中国境内通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行人民币证券募集的

资金，但不包括发行人实施股权激励计划募集的资金，并将自发行人本次发行完成之日起生效。根据前述制度，发行人募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用。发行人募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立非执行董事、保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见后方可变更。

基于上述核查，本所律师认为，发行人本次发行形成的股本溢价不属于可向投资者进行股利分配的科目，且发行人已制定了有效的募集资金监管措施。

- (三) 发行人是否设置了 A 股、H 股类别股东分类表决制度或其他相比普通股股东的特殊权利，是否符合现行监管要求

经本所律师核查，根据《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）的相关规定：“本公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。”“公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。”根据《香港上市规则》附录 13D 第 f 项规定，在中国境内注册成立的发行人应在其章程中载入“除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东”。根据《必备条款》的相关规定：“公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第八十一条至第八十五条分别召集的股东会议上通过，方可进行。”

经本所律师核查，发行人系一家注册于中国香港的公司，依据中国香港

相关法律法规成立并在香港联交所上市，无需适用《必备条款》关于类别股东及类别表决机制的安排。此外，《香港上市规则》亦未明确规定发行人本次发行的 A 股必须与目前在香港联交所上市流通的普通股设定为不同类别的股份。

经本所律师核查，本次发行前，发行人在香港联交所上市流通的股票为无面值的普通股。根据发行人于 2022 年 6 月 27 日召开之股东特别大会审议通过的《有关人民币股份发行及特别授权的决议案》，本次发行的 A 股属于人民币普通股。《公司章程（A 股上市后适用稿）》中未规定人民币普通股存在与其他普通股股东差异化权利安排。

根据《H 股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》（以下简称“《业务指引》”）的相关规定：“本指引所称‘全流通’，是指 H 股公司<sup>1</sup>的境内未上市股份（包括境外上市前境内股东持有的未上市内资股、境外上市后在境内增发的未上市内资股以及外资股东持有的未上市股份）到香港联交所上市流通。”发行人系一家注册于中国香港的公司，依据中国香港相关法律法规成立并在香港联交所上市，不属于《业务指引》规定的“H 股公司”，因此发行人不适用《业务指引》关于“全流通”的相关规定。此外，根据《备忘录》，流通股系境内法律项下概念，不适用于香港公司；根据发行人于 2022 年 11 月 23 向香港公司注册处递交的备案，发行人的所有普通股均已全部缴足或视为已缴足。受限于《公司章程》和适用法律法规规定，以及股东可能在其持有的股份上设置或施加的任何其他权利负担和/或禁售承诺，一般来说，获配发和发行已缴足股款股份的公司股东对该等股份的交易不受限制。香港法律法规项下可能适用的限制包括，如《证券及期货条例》规定的禁止内幕交易的规定及《香港上市规则》附录 10 项下的禁售期。

---

<sup>1</sup> 根据《业务指引》的相关规定，H 股公司系指在香港联交所上市的境内股份有限公司。

基于上述核查，本所律师认为，发行人未设置 A 股、H 股类别股东分类表决制度或其他相比普通股股东的特殊权利，符合中国境内相关法律法规的规定。

- (四) 结合境内外相关法律法规规定等，说明境内投资者向发行人及相关主体提起境内外诉讼的事项范围、程序，以及相关裁决的可执行性，是否制定了相应的保障措施。

经本所律师核查，发行人的公众股东可以依据《证券法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国民事诉讼法》《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》等法律法规及其相关的司法解释，在中国境内有管辖权的人民法院提起民事诉讼，追究发行人及其他相关责任人的法律责任，范围包括在发行人的信息披露内容出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并致使公众股东在证券交易中遭受损失时，公众股东可追索赔偿责任。

境内投资者在有管辖权的的中国境内法院向发行人提起诉讼并取得生效的司法判决、裁定的，可根据生效的裁判文书，通过法定程序向中国境内有管辖权的法院申请强制执行，但如果涉及中国内地司法判决、裁定在中国境外执行，则需要依据中国与其他国家或地区签署的与民商事司法协助相关的双边协定/条约、境外法律规定和互惠原则向其他国家或地区申请承认和执行内地法院判决，内地司法判决、裁定能否在境外获得承认与执行，亦存在一定的不确定性。

公众股东可以依据中国相关法律法规向有管辖权的人民法院提起诉讼、申请执行发行人的境内资产。发行人注册于香港，受香港法院管辖，如公众股东向香港法院起诉发行人寻求保护自己的权利，根据《关于内地

和香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排》的相关规定，内地人民法院和香港特别行政区法院在具有书面管辖协议的民商事案件中作出的须支付款项的具有执行力的终审判决，当事人可以向内地人民法院或者香港特别行政区法院申请认可和执行。但在一定情形下，有关法院可裁定不予认可和执行，因此香港法院判决能否在境内获得承认与执行，仍存在一定的不确定性。同时，本次发行后，公众股东持有的发行人股票将统一登记、存管在中国境内的证券登记结算机构。如某一公众股东拟依据香港法律向发行人提起证券诉讼或其他民事诉讼，该名公众股东须按中国境内相关业务规定取得具有法律效力的证券登记记录，该等程序和限制可能导致境内投资者需承担额外的跨境行使权利或者维护权利的成本和负担。

为保障境内投资者可依据相关法律规定在中国境内有管辖权的人民法院提起民事诉讼，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员分别出具了《关于适用法律和管辖法院的承诺函》，承诺：若因发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在上交所科创板上市以及发行人在科创板上市期间所发生的纠纷，将适用中华人民共和国（仅为该承诺函之目的，不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）（以下简称“中国”）法律，并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。承诺人不会对上述法律适用及法院管辖提出异议。

根据上述承诺，中国境内法院就境内投资者提起的相关纠纷具有管辖权。根据《最高人民法院关于上海金融法院案件管辖的规定》第三条的规定，在上海证券交易所科创板上市公司的证券发行纠纷、证券承销合同纠纷、证券上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件，由上海金融法院管辖。因此，如发生前述纠纷，境内投资者有权在上海金融法院提起相关诉讼请求。

基于上述核查，本所律师认为，发行人就境内投资者向发行人及相关主体提起境内外诉讼事宜已制定了相应的保障措施。

- 七. 审核问询问题 14. 关于信息披露及豁免申请：根据申报材料：（1）重大事项提示及风险因素中部分内容的披露不充分、针对性不强，存在竞争优势的表述，如“未能紧跟技术迭代的风险”“宏观经济波动和行业周期性的风险”等，对发行人与境内上市公司在公司治理制度等方面的差异提示不充分等；（2）招股说明书对形成主营业务收入的发明专利、商标等披露过于冗长；（3）最近一期末，发行人合并报表层面存在累计未弥补亏损，招股说明书未披露对应的投资者保护及承诺事项；（4）发行人控股股东、实际控制人出具的欺诈发行上市股份购回承诺不符合《关于切实提高招股说明书（申报稿）质量和问询回复质量相关注意事项的通知》的要求；（5）信息披露豁免申请文件未充分说明对相关客户名称进行豁免的理由及依据。请发行人按照《科创板招股说明书格式准则》等相关规则要求：（1）结合公司实际情况梳理“重大事项提示”“风险因素”各项内容，突出重大性、增强针对性，充分披露风险产生的原因和影响，删除竞争优势的表述；（2）对发行人公司治理制度与境内上市公司的主要差异进行充分提示，对“依赖境内运营子公司股利分配的风险”“公司作出的承诺在实际履行时的相关风险”“境外持续信息披露监管与境内可能存在差异的风险”等进行重大事项提示；（3）以投资者需求为导向精简招股说明书，重点披露对主营业务有重要影响的专利、商标情况；（4）按照《科创板股票发行上市审核问答》问题 2 的要求补充披露投资者保护措施及承诺，发行人控股股东、实际控制人按照相关规定重新出具欺诈发行上市的股份购回承诺；（5）完善信息披露豁免申请文件，充分说明对部分客户名称进行豁免披露的依据和理由。请保荐机构、发行人律师、申报会计师对发行人信息披露豁免申请是否符合《科创板股票发行上市审核问答》问题 16 的要求进行核查并发表明确意见。

经本所律师核查，根据《华虹半导体有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市信息豁免披露的申请报告》，鉴于发行人回复本次审核问询函及拟在招股说明书中披露部分信息属于商业秘密或商业敏感信息，发行人已申请豁免公开披露相关信息，信息豁免披露的具体内容及原因详见《华虹半导体有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市信息豁免披露的申请报告》。

经本所律师核查，根据发行人提供的资料，发行人已制定《企业秘密管理规程》等信息保密管理制度，建立了相应的保密工作制度，实行保密工作责任制度；发行人在业务开展过程中加强涉密员工管理，积极开展保密宣传教育，定期组织保密检查，按照发行人内部保密工作管理制度的相关规定开展业务。

经本所律师核查，根据发行人说明，发行人董事会主席已在豁免申请文件中签字确认，发行人已就本次豁免披露信息履行了发行人内部审批程序，豁免披露的信息尚未泄漏。

经本所律师核查，发行人目前的相关信息披露文件均按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号-科创板公司招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 42 号-首次公开发行股票并在科创板上市申请文件》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》等相关规定进行文件制作和信息披露，符合相关规定要求。

经本所律师核查，发行人本次相关信息披露豁免申请不会实质性影响投资者对发行人情况的理解，不会实质性影响投资者决策判断。

基于上述核查，本所律师认为，发行人目前的信息豁免披露符合《科创板股票发行上市审核问答》问题 16 的要求。

八. 审核问询问题 15.1 关于股东及股权变动：根据申报材料：（1）发行人设立以来实施了两期股票期权激励计划并分多次授予，申报材料未充分说明截至目前期权是否已授予完毕；（2）申报材料对发行人收购华虹 NEC 股权后至联交所上市前的股权变动介绍不清晰，2019 年发行人现金分红 34,130.55 万元，申报材料对股权变动、分红等涉及外汇、税收、国资审批及评估备案程序的履行情况说明不充分；（3）股东信息披露专项核查工作将持股比例 5%以上作为股东核查、证监会系统离职人员核查及主要股东信息披露的标准，未充分说明其余主体未进行核查的原因及规则依据。请发行人说明：发行人股票期权激励计划是否已授予完毕、截至目前的最新进展，历次股票期权激励计划的授予及行权是否符合股东大会、董事会及国资批复的相关要求。请保荐机构、发行人律师：（1）对上述事项进行核查并发表明确意见；（2）对发行人股权变动、分红等涉及外汇、税收、国资及其他相关主管部门审批程序的履行情况及合法合规性等进行核查并发表明确意见；（3）按照股东核查的相关规定完善股东信息披露专项核查报告及主要股东信息披露工作，如确实无法穿透核查的应按照相关规则提供充分依据。

（一） 发行人股票期权激励计划是否已授予完毕、截至目前的最新进展，历次股票期权激励计划的授予及行权是否符合股东大会、董事会及国资批复的相关要求，对上述事项进行核查并发表明确意见

1. 股票期权激励计划的授予情况

（1） 2015 年 9 月第一期股票期权激励计划

经本所律师核查，发行人股东特别大会于 2015 年 9 月 1 日作出决议，同意采纳股票期权计划，并授权董事会自计划批

准日 7 年内任何时间全权决定授予参与者按行权价认购一定数量发行人股票的权利；该股票期权计划项下拟授出的所有期权及发行人任何其他股票期权计划项下拟授出的任何期权获行使时可予发行的股票总数，合计不得超过当时的已发行股本总数的 10%，且该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过发行人总股本的 3%。

经本所律师核查，上海市国资委已于 2015 年 8 月 14 日出具沪国资委分配（2015）278 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划的批复》，原则同意上述期权激励计划。

经本所律师核查，根据发行人股东大会的上述授权，发行人董事会于 2015 年 9 月 4 日作出决议，同意于 2015 年 9 月 4 日向董事及雇员授出股票期权。发行人本次授出 30,250,000 份期权，前述期权可按行权价 6.912 港元认购合计最多 30,250,000 股股票，本次期权分三期归属，并将于 2022 年 9 月 3 日失效。

(2) 2018 年 12 月第二期股票期权激励计划第一次授予

经本所律师核查，发行人董事会于 2018 年 12 月 18 日作出决议，同意于 2018 年 12 月 24 日及 2019 年 12 月 23 日向若干雇员和/或董事配发股票期权，但该等期权计划的实施须根据国资监管部门的要求取得发行人股东的批准为前提。发行人于 2018 年 12 月 24 日向发行人若干员工及当时的董事授出 34,500,000 份期权（该等期权须经发行人股东大会批准后方可生效）。前述期权可按行权价 15.056 港元认购合计最多 34,500,000 股股票，其中，就发行人副总裁及以上

级别的雇员（连同董事）而言，本次期权分四期归属；就其他雇员而言，本次期权分三期归属；前述期权将于 2025 年 12 月 23 日失效。

经本所律师核查，上海市国资委于 2019 年 3 月 12 日出具沪国资委分配（2019）44 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划（二期）的批复》，原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划（二期）方案》，并应按有关规定提交发行人股东大会审议。

经本所律师核查，发行人股东特别大会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意根据发行人于 2015 年 9 月 1 日采纳的股票期权计划于 2018 年 12 月 24 日授出 34,500,000 份股票期权，并同意于 2019 年 12 月 23 日或前后进一步授出 4,000,000 份股票期权（具体授出情况详见下述第（3）与（4）项）。

(3) 2019 年 3 月第二期股票期权激励计划第二次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及发行人股东大会的授权，发行人董事会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意于 2019 年 3 月 29 日向唐均君授出 500,000 份期权，前述期权可按行权价 18.40 港元认购合计最多 500,000 股股票；本次期权分四期归属，并将于 2026 年 3 月 28 日失效。

(4) 2019 年 12 月股票期权激励计划第三次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及发行人股东大会的授权，发行人董事会于 2019 年 11 月 12 日作出决议，同意于 2019 年 12 月 23 日向华虹无锡具有重要技术专

长及/或担任核心管理职位的 101 名员工授予 2,482,000 份期权。前述期权可按行权价 17.952 港元认购合计最多 2,482,000 股股票，其中，就华虹无锡副总裁或以上级别的职员而言，本次期权分四期归属；就其他雇员而言，本次期权分三期归属。前述期权将于 2026 年 12 月 22 日失效。

(5) 2021 年 11 月发行人股票期权激励计划调整

经本所律师核查，发行人股东特别大会于 2021 年 11 月 26 日作出决议，鉴于发行人的总股本已发生变更，为使发行人能够更灵活地向其雇员提供激励及奖励，同意将发行人股票期权计划授出限额由 103,387,165 股股票（占发行人于 2015 年 9 月审议股票期权激励计划方案时总股本的 10%）调整为 130,047,036 股股票（占发行人本次股东大会审议时总股本的 10%）。

2. 发行人股票期权激励计划是否已授予完毕、截至目前的最新进展

经本所律师核查，根据发行人证券变动月报表及发行人的说明，发行人股票期权激励计划的授予情况及进展如下：

		授予期权数量 (份)	行权期限	截至 2022 年 9 月 30 日已行 权的期权数量	截至 2022 年 9 月 30 日已授 出尚未行权的 期权数量
2015 年 9 月第一期股 票期权激励计划		30,250,000	2022 年 9 月 3 日前行权	26,377,006	0
2018 年 12	2018 年 12	34,500,000	2025 年 12 月	3,813,006	21,766,236

月第二期 股票期权 激励计划	月第一次 授予		23 日前行权		
	2019 年 3 月第二次 授予	500,000	2026 年 3 月 28 日前行权	0	437,500
	2019 年 12 月第三次 授予	2,482,000	2026 年 12 月 22 日前行权	46,376	1,650,798
<b>合计</b>		<b>67,732,000</b>	<b>—</b>	<b>30,236,388</b>	<b>23,854,534</b>

注：上述截至 2022 年 9 月 30 日已行权的期权数量及已授出尚未行权的期权数量未包含因员工离职或未实现绩效等原因所注销的期权数 13,641,078 份。

经本所律师核查，根据发行人股东大会的公告文件、上海市国资委出具的相关批复文件并经发行人确认，发行人上述股票期权计划已于 2022 年 9 月到期；截至 2022 年 9 月 30 日，发行人已授出 67,732,000 份期权（对应可认购发行人 67,732,000 股股票），不存在尚未授出的期权；发行人上述已授予的期权中，已行权的期权数量 30,236,388 份，已授出但尚未行权的期权数量为 23,854,534 份。

经本所律师核查，根据发行人股东大会的公告文件、上海市国资委出具的相关批复文件，发行人上述历次股票期权激励计划均系发行人于香港联交所上市期间制定并实施的员工期权激励计划。员工通过前述期权激励计划所认购的发行人股份将仅在香港联交所流通交易，无法转移至境内 A 股市场进行流通。发行人上述历次股票期权激励计划不属于《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第 12 问规定的首发申报前制定并准备在上市后实施的期权激励计划。

经本所律师核查，根据发行人说明及本所律师对中国裁判文书网、发行人境内子公司所属法院网站等网站的公开查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司不存在涉及上述股票期权激励计划的重大诉讼、仲裁案件。

3. 历次股票期权激励计划的授予及行权是否符合股东大会、董事会及国资批复的相关要求，对上述事项进行核查并发表明确意见

(1) 第一期股票期权激励计划

主要事项	股东大会及董事会审议通过的股票期权激励计划的要求	国资批复关于第一期股票期权激励计划的要求	第一期股票期权激励计划实际授予情况
授予期权的行权价格	<p>最低行权价应不低于以下价格的较高者：</p> <p>(A) 期权授予日股票在香港联交所的收市价；及</p> <p>(B) 期权授予日前连续五个交易日股票在香港联交所的平均收市价。</p>	<p>以下列三个价格的较高者作为授予/行权价：</p> <p>1、授予日发行人股票于香港联交所每日报价表所列的当日股票收市价</p> <p>2、授予日前发行人股票连续五个交易日于香港联交所每日报价表所列的股票平均收市价</p> <p>3、发行人股票的面值</p>	<p>授予价格为 6.912 港币，不低于期权授予日股票在香港联交所的收市价 6.87 港币、期权授予日前连续五个交易日股票在香港联交所的平均收市价 6.912 港币及股票面值</p>

授予数量	合计不得超过发行人于计划批准日的已发行股本总数的10%（即103,387,165股票），且该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过发行人总股本的3%（即不超过31,016,149股）	该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过发行人总股本的3%	授予30,250,000份股票期权（对应可认购发行人30,250,000股股票），未超过发行人总股本的3%（即不超过31,016,149股）
授予时间	自期权激励计划批准日7年内（即2022年9月1日之前）	-	授出日期为2015年9月4日，在2022年9月1日之前
行权有效期	董事会决定并通知被授与人可行使期权的期限（第一期股票期权激励计划期权可行权的有效期为2015年9月4日至2022年9月3日）	自股票期权授予日起的7年时间	均于2022年9月3日之前行权

(2) 第二期股票期权激励计划

主要事项	股东大会及董事会审议通过的股票期权激励计划的要求	国资批复关于第二期股票期权激励计划的要求	第二期股票期权激励计划的实际授予情况		
			第一次授予	第二次授予	第三次授予
授予价格	期权的行权价由董事会全权酌情确定，并	以下列三个价格的较高者作为授予	授予价格为15.056港币，不低于期	授予价格为18.400港币，不低于期权授予	授予价格为17.952港币，不低于期权授予

	告知被授予人。最低行权价应不低于以下价格的较高者： (A) 期权授予日股票在香港联交所的收市价；及 (B) 期权授予日前连续五个交易日股票在香港联交所的平均收市价。	/行权价： 1、授予日发行人股票于香港联交所每日报价表所列的当日股票收市价 2、授予日前发行人股票连续五个交易日于香港联交所每日报价表所列的股票平均收市价 3、发行人股票的面值	权授予日股票在香港联交所的收市价 14.440 港币、期权授予日前连续五个交易日股票在香港联交所的平均收市价 15.056 港币及股票面值	日股票在香港联交所的收市价 18.400 港币、期权授予日前连续五个交易日股票在香港联交所的平均收市价 18.176 港币及股票面值	日股票在香港联交所的收市价 17.260 港币、期权授予日前连续五个交易日股票在香港联交所的平均收市价 17.952 港币及股票面值
授予数量	董事建议根据股票期权计划向发行人若干雇员及董事授出二零一八年期权及二零一九年期权，可分别于二零一八年及二零一九年认购最多 34,500,000 股股票及	授予期权总数 3,850 万份，占发行人当时总股本的比例为 3%	授予 34,500,000 份股票期权（对应可认购发行人 34,500,000 股股票），2018 年发行期权数量所可认购的发行人股票未超过	授予 500,000 份股票期权（对应可认购发行人 500,000 股股票），2019 年发行期权所可认购的发行人股票未超过 4,000,000 股股票	授予 2,482,000 份股票期权（对应可认购发行人 2,482,000 股股票），2019 年合计发行期权所可认购的发行人股票未超过 4,000,000 股股票

	4,000,000 股股票		34,500,000 股股票		
授予时间	自股权激励计划批准日 7 年内 (即 2022 年 9 月 1 日之前)	-	授出日期为 2018 年 12 月 24 日, 在 2022 年 9 月 1 日之前	授出日期为 2019 年 3 月 29 日, 在 2022 年 9 月 1 日之前	授出日期为 2019 年 12 月 23 日, 在 2022 年 9 月 1 日之前
行权有效期	董事会决定并通知被授予人可行使期权的期限	自股票期权授予日起的 7 年时间	期权可行权的有效期为 2018 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日, 截至本补充法律意见书出具之日, 均在有效期内行权	期权可行权的有效期为 2019 年 3 月 29 日至 2026 年 3 月 28 日, 截至本补充法律意见书出具之日, 均在有效期内行权	期权可行权的有效期为 2019 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日, 截至本补充法律意见书出具之日, 均在有效期内行权

基于上述核查, 本所律师认为, 发行人上述历次股票期权激励计划的授予及行权符合股东大会、董事会及国资批复的相关要求。

(二) 对发行人股权变动、分红等涉及外汇、税收、国资及其他相关主管部门审批程序的履行情况及合法合规性等进行核查并发表明确意见

1. 发行人的股权变动情况

经本所律师核查, 根据发行人提供的文件资料, 发行人收购华虹 NEC 股权至香港联交所上市前主要股东的股权变动情况如下:

(1) 发行人的设立及收购华虹 NEC

经本所律师核查，经国务院于 2004 年 12 月批示同意，为华虹 NEC 重组上市目的，华虹 NEC 中方股东华虹集团、张江集团、上海贝岭拟将其持有的华虹 NEC 股权划转到境外，并与华虹 NEC 外方股东合资设立拟上市公司，自行选择有利时机，到境外发行股票并在香港上市。

2005 年 1 月 21 日，发行人在中国香港依据《公司条例》注册，设立时公司名称为“华虹半导体有限公司（Hua Hong Semiconductor Limited）”，设立时已发行股份数为 1 股，每股面值为 0.01 美元，该等已发行股份由 Harefield Limited 持有。

2005 年 3 月 3 日，华虹 NEC 相关股东、发行人签订股权转让相关协议，约定华虹 NEC 当时全体注册于境内的股东分别将其持有的华虹 NEC 股权划转、转让予相关境外主体，并由华虹半导体向前述划转或转让完成后的华虹 NEC 全体股东发行股份购买其合计持有的华虹 NEC 100% 股权，前述事宜的具体情况如下表所示：

单位：万美元

华虹 NEC 原股东情况			第一步：华虹 NEC 境内股东将股权划转、转让予境外主体			第二步：发行人发行股份购买华虹 NEC 全部股权		
股东名称	出资额	持股比例 (%)	划入方/受让方	出资额	持股比例 (%)	出售方	出售比例 (%)	对价股份 (股)
华虹集团	50,000	55.92	华虹国际	50,000	55.92	华虹国际 (注 1)	61.42	350,401,100 (注 2)
华虹国际	4,480	5.01	—	—	—			

张江集团 (注 1)	437	0.49	华虹国际 (注 1)	437	0.49			
中国日电	7,000	7.83	NEC	7,000	7.83	NEC	17.36	99,038,800
NEC	8,520	9.53	—	—	—			
上海贝岭	10,030	11.22	香港海华	10,030	11.22	香港海华	11.22	64,010,100
Newport	8,941	10	—	—	—	Newport	10	57,050,000
<b>合计</b>	<b>89,408</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>89,408</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>570,500,000</b>

注 1: 经本所律师核查, 根据华虹集团、华虹国际与张江集团、张江国际于 2005 年 3 月 3 日签订的《关于华虹半导体有限公司和上海华虹 NEC 电子有限公司境外信托契据》(以下简称“境外信托契据”)及华虹集团、华虹国际与张江集团于 2005 年 3 月 3 日签订的《关于股权托管及划转的协议》(以下简称“股权托管及划转协议”), 张江集团将华虹 NEC 0.49% 股权(以下简称“华虹 NEC 权益”)委托华虹集团代管并划转至华虹国际, 并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持有的华虹 NEC 权益置换为发行人 0.49% 股权(对应发行人 2,795,450 股, 以下简称“发行人权益”); 股权置换后, 由华虹国际根据协议约定代张江集团持有及管理发行人权益, 并代表张江集团行使发行人权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务; 张江集团根据协议约定保留发行人权益项下的处分权、收益权等股东权利, 并承担相应义务。

注 2: 其中华虹国际所持有的发行人 1 股股份系自 Harefield Limited 处以 0.01 美元的价格受让取得。

经本所律师核查, 国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》, 核准华虹 NEC 中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。

经本所律师核查, 中华人民共和国商务部分别于 2005 年 3 月 31 日、2005 年 4 月 30 日、2005 年 7 月 28 日核发商合批

[2005]178 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司向境外划转股权并在香港设立华虹半导体有限公司的批复》、商资批[2005]720 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]1540 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司转股的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，中华人民共和国国家发展和改革委员会于 2005 年 5 月 8 日核发发改外资[2005]730 号《国家发展改革委关于上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权全部转移境外并在香港上市项目核准的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，华虹国际、NEC、香港海华及 Newport 已于 2005 年 6 月 1 日被登记为发行人股东，华虹 NEC 之股权已于 2005 年 10 月 9 日变更登记至发行人名下。

上述华虹 NEC 收购完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100 (其中 2,795,450 股系 为张江集团托管)	61.42
2.	NEC	99,038,800	17.36
3.	香港海华	64,010,100	11.22
4.	Newport	57,050,000	10
	<b>合计</b>	<b>570,500,000</b>	<b>100</b>

经本所律师核查，根据普华永道中天会计师事务所有限公司于 2006 年 3 月 15 日出具的《审计报告》，截至 2004 年 12 月 31 日，华虹 NEC 实收资本为 74.03 亿元，并存在累计亏损约 27.7 亿元；根据国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，截至 2004 年 7 月 31 日拟划转至境外的华虹 NEC 的 100% 股权的净资产评估值为约 62.24 亿元，该等评估值低于华虹 NEC 的实收资本 74.03 亿元。基于前文所述并根据发行人的说明，上述华虹 NEC 收购过程中，转让方未获得收益，不涉及缴纳所得税。

(2) 2011 年股份回购及合并

经本所律师核查，发行人于 2011 年回购了 Newport 持有的发行人 57,050,000 股普通股股份，并与联和国际控制的 Grace Cayman 进行了合并。发行人股东会已于 2011 年 7 月、2011 年 9 月审议通过前述事宜。2011 年 9 月 30 日，发行人当时之间接控股股东华虹集团、Grace Cayman 当时之间接控股股东上海联和共同向上海市国资委提交《关于上海华虹 NEC 电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司境外母公司合并工作情况的报告》，将前述回购事宜、合并方案、合并完成后相关股东的股权比例等事宜报告予上海市国资委。2011 年 11 月 28 日，上海市国资委产权管理处出具了《说明》，确认已收阅相关工作报告。2011 年 12 月 16 日，中华人民共和国国家发展和改革委员会下发《国家发展改革委关于香港华虹半导体有限公司与开曼宏力半导体制造有限公司合并

项目核准的批复》（发改外资[2011]2982号）至上海市发展改革委，批复同意前述合并项目。前述股份回购及合并事宜的具体情况如下：

1) 发行人回购 Newport 股份

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，发行人于 2011 年 7 月召开股东会，同意发行人以 32,000,000 美元的价格回购 Newport 持有的发行人 57,050,000 股普通股股份。

经本所律师核查，华虹集团董事会已于 2011 年 6 月作出决议，同意授权华虹集团派在华虹半导体的董事投票同意上述回购事宜。

本次股份回购完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100（其中2,795,450股系为张江集团托管）	68.24
2.	NEC	99,038,800	19.29
3.	香港海华	64,010,100	12.47
	<b>合计</b>	<b>513,450,000</b>	<b>100</b>

经本所律师核查，根据国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具的国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转

及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，截至 2004 年 7 月 31 日拟划转至境外的华虹 NEC 的 100% 股权的评估值为约 62.24 亿元。Newport 以其持有的华虹 NEC 10% 股权置换发行人 10% 的股份，其取得发行人 10% 股份的成本系华虹 NEC 10% 股权的价值（对应的评估值即 6.224 亿元），高于本次股份回购的对价 3,200 万美元。基于前文所述并根据发行人的说明，上述股份回购过程中，Newport 未获得收益，不涉及缴纳所得税。

## 2) 发行人与 Grace Cayman 公司合并

经本所律师核查，根据发行人、Grace Cayman 及发行人新设的开曼子公司于 2011 年 9 月 13 日签署的《合并协议》及发行人与 Grace Cayman 通过的董事会及股东大会决议，发行人拟与 Grace Cayman 进行合并，Grace Cayman 当时已发行股份总数为 3,389,953,406 股，联和国际持有其 1,796,760,768 股股份；除前述已发行股份外，Grace Cayman 当时尚存向联和国际已发行且尚未转股的 8,900 万美元可转换公司债券，及已授予部分主体可按一定价格购买 Grace Cayman 股份的认股期权。本次合并过程中，就前述三类情形的具体合并方案如下：

### a. 关于 Grace Cayman 向联和国际发行的可转换公司债券的安排

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，发行人开展上述合并时，联和国际持有 Grace

Cayman 已向其发行且尚未转股的可转换公司债券共计 8,900 万美元；发行人与 Grace Cayman、联和国际于 2011 年 12 月 22 日签订《Deed of Cancellation and Assumption》，约定收购完成前，联和国际将其所持本金为 2,000 万美元的 Grace Cayman 可转换公司债券转换为 Grace Cayman 200,000,000 股优先股，剩余 6,900 万美元可转换公司债券（以下简称“可转债”）则转由发行人承担相关义务。为消除转换尚未行使的可转债导致的任何摊薄影响，发行人、Grace Cayman 与联和国际于 2011 年 12 月 28 日签订《Escrow Deed》，约定发行人于上述收购完成后发行额外 11,010,635 股股份（以下简称“托管股份”），由联和国际（作为托管代理）以托管方式持有；如尚未行使的可转债于上述收购完成后获转换，托管股份将转让予发行人的收购前股东，如于 2012 年 9 月 30 日前并无转换，托管股份将转让予 Grace Cayman 的收购前股东。后续联和国际并未行使相关转股权利，相关转股权已于 2012 年 9 月 30 日失效，联和国际已将其持有的 11,010,635 股托管股份按照合并前原股东在 Grace Cayman 对应的持股比例转让予 Grace Cayman 的合并前股东，前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第八（二）1（3）项。

- b. 关于 Grace Cayman 向其他主体授予的认股权的安排

经本所律师核查，根据发行人、Grace Cayman 及发行人新设的开曼子公司于 2011 年 9 月 13 日签署的《合并协议》、联和国际与认股期权持有人签署的《Deed of Novation》《Call Option Agreement》及联和国际发出的认购通知，截至 2011 年 10 月，Grace Cayman 仍存在部分尚未行使认股期权的持有人（以下简称“认股期权持有人”），认股期权持有人持有的认股期权合计可认购 Grace Cayman 339,194,984 股股份。为推进上述公司合并事宜，联和国际与认股期权持有人于 2011 年 10 月 25 日签署了《Deed of Novation》，约定认股期权持有人将 Grace Cayman 于 2009 年授予其的认股期权的全部权利、利益、责任及义务转让予联和国际；同时，联和国际与认股期权持有人签署了《Call Option Agreement》，约定在联和国际行权后，作为向联和国际转让相关认股期权的对价，联和国际授予相关认股期权持有人自联和国际购买发行人普通股股份的认购期权，认购期权所对应发行人对应的股份数系联和国际因行使该认股期权持有人期权所对应取得发行人的相关普通股股份数。

2011 年 10 月 25 日，联和国际向 Grace Cayman 发出通知，行使上述认股期权，总行使价约为 4,070 万美元，对应认购 Grace Cayman 339,194,984 股股份。

经本所律师核查，根据联和国际与认股期权持有人

签署的《Deed of Novation》《Call Option Agreement》，认股期权持有人有权行使认股期权的期限为发行人合格 IPO 的股票禁售期届满后六（6）个月内或联和国际根据《Deed of Novation》授予给认股期权持有人对应认股期权之日起三年内（以孰早为准）。基于前述协议的相关约定并经本所律师查询发行人于香港联交所公告的历次年度报告中联和国际的持股数，认股期权持有人未实际履行上述相关期权。截至本补充法律意见书出具之日，认股期权持有人已不再享有自联和国际处购买发行人普通股股份的认股期权。

- c. 联和国际上述可转换公司债券转股、认股期权行权后，发行人与 Grace Cayman 的合并方案

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，为实现发行人与 Grace Cayman 合并，双方协商由发行人在开曼群岛设立一家其全资拥有的子公司，并由该子公司与 Grace Cayman 进行合并，合并子公司并入 Grace Cayman（作为存续公司），作为合并子公司并入 Grace Cayman 的对价，Grace Cayman 向合并子公司的股东（即发行人）发行 1 股；同时，Grace Cayman 注销其向除发行人外的其他股东已发行的股份（包括本次合并前 Grace Cayman 原已发行的 3,389,953,406 股股份、联和国际将其所持 2,000 万美元可转换公司债券转换的 Grace Cayman 200,000,000 股优先股、联和国际持

有的认股期权行权后获得的 339,194,984 股股份), 作为该等股东注销股份的对价, 发行人同意按照 13.9969315 股 Grace Cayman 股份对应发行人 1 股股份的交流比率向 Grace Cayman 的股东 (合并前 Grace Cayman 股东的具体情况如下表所示) 合计发行 280,715,021 股。

序号	Grace Cayman 股东	持有 Grace Cayman 股份总数 (股)	股份比例 (%)
1.	联和国际	1,796,760,768 (未包含上述可转换公司债券转换的 200,000,000股 及认股期权行权 后获得的 339,194,984股)	53.0025
2.	Wisdom Power	382,719,720	11.2898
3.	Silicon Storage Technology, Inc.	376,648,259	11.1107
4.	Geyserite International Finance Limited	137,394,139	4.0530
5.	Epoch Epitome International Limited	108,459,254	3.1994

6.	Hong Chi International Limited	100,209,912	2.9561
7.	Panther Rock Limited	78,506,649	2.3159
8.	China Canton Associates Limited	50,000,000	1.4749
9.	Sanyo Semiconductor (H.K.) Co., Ltd.	41,666,667	1.2291
10.	Great Expert Limited	37,500,000	1.1062
11.	Shine Century Limited	37,500,000	1.1062
12.	Philemon & Baucis Global Investment Limited	34,427,561	1.0156
13.	Greater Invest Limited	23,899,285	0.7050
14.	Transisland Investments Limited	23,899,285	0.7050
15.	Grace Tsu Han Wong	20,000,000	0.5900
16.	Gypsum Assets	15,900,000	0.4690

	Limited		
17.	In Time Enterprises Limited	14,996,000	0.4424
18.	System Expo Limited	14,616,366	0.4312
19.	Lapis Semiconductor Co., Ltd.	10,000,000	0.2950
20.	Xanbase Investment Co., Ltd.	9,601,147	0.2832
21.	Fitzalan Holdings Limited	9,090,000	0.2681
22.	CDB Web Tech International LP	8,500,000	0.2507
23.	Grand Canal Investments Limited	8,317,928	0.2454
24.	Giant Resources International Limited	8,000,000	0.2360
25.	Leo Ming-Tz Chien	6,000,000	0.1770
26.	Christie	6,000,000	0.1770

	Ming-Hui Chien		
27.	Kwan Wan Hing, Venus	5,921,470	0.1747
28.	Topnotch Electronics International Limited	5,727,203	0.1689
29.	Lingrich Investment Limited	2,500,000	0.0737
30.	Vicorn Investment Limited	2,500,000	0.0737
31.	K J Holding Group Limited	2,000,000	0.0590
32.	Tong Hwei Co., Ltd.	2,000,000	0.0590
33.	Chen, Chieh-Yuan	1,431,793	0.0422
34.	Yu, Yueh-Chiang	1,030,000	0.0304
35.	American Concord Universal Inc.	1,000,000	0.0295
36.	Chen Li	1,000,000	0.0295
37.	Neil Bush	800,000	0.0236
38.	Chou Chen, Chieh	500,000	0.0147
39.	Chou, Tien-Chuan	500,000	0.0147
40.	Luo, Huey Ming	500,000	0.0147

41.	George Jing-Sheng Gau	400,000	0.0118
42.	Sharon Bush	200,000	0.0059
43.	Lo Lee A-Chao	200,000	0.0059
44.	Sun, Shan-Oh	200,000	0.0059
45.	Ho, Chiung-Chuan	160,000	0.0047
46.	Chung, Hui-Sheng	100,000	0.0029
47.	Lin, Fen-Hung	100,000	0.0029
48.	Lin, Yu-Hui	100,000	0.0029
49.	Wu, Nan-Ray	100,000	0.0029
50.	Chang, Chih-Hsi ang	30,000	0.0009
51.	Chen, Han-Ming	30,000	0.0009
52.	Hsiao, Cheng-Ho	30,000	0.0009
53.	Tseng, Wan-Ting	30,000	0.0009
54.	Wang, Shih-Li	30,000	0.0009
55.	Yeh, Ching-Hua	30,000	0.0009
56.	Ying, Tung-Fang	30,000	0.0009
57.	Chen, Chung-Hsiu	20,000	0.0006
58.	Chang, Chih-Cha ng	20,000	0.0006
59.	Chou, Hong-Yeun	20,000	0.0006
60.	Lee, Shui-Sheng	20,000	0.0006
61.	Lin, Hsiang-Ying	20,000	0.0006
62.	Lin, Kung-Cheng	20,000	0.0006
63.	Wei, Tao-Yuan	20,000	0.0006
64.	Wu, Kuan-H Si	20,000	0.0006
	<b>合计</b>	<b>3,389,953,406</b>	<b>100</b>

经本所律师核查，发行人于 2011 年 9 月 2 日召开董事会及股东大会同意上述合并事宜；Grace Cayman 于 2011 年 9 月 9 日召开董事会，并于 2011 年 9 月 23 日召开优先股持有人之类别股东会及股东大会，同意上述合并事宜。

本次合并完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称/ 姓名	持股数量（股）	持股比例 （%）
1.	华虹国际	350,401,100（其中 2,795,450 股系为张江集团托管）	43.5186
2.	联和国际	177,901,203（其中 11,010,635 股系托管股份）	22.0947
3.	NEC	99,038,800	12.3003
4.	香港海华	64,010,100	7.9498
5.	其他股东	113,824,453	14.1366
	<b>合计</b>	<b>805,175,656</b>	<b>100</b>

经本所律师核查，根据 Ernst&Young Hua Ming Shanghai Branch 于 2011 年 11 月 15 日出具的审阅报告，截至 2010 年 12 月 31 日，Grace Cayman 仍存在累计亏损约 10 亿美元。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会核发的发改外资[2011]2982 号《国家发展改革委关于香港华虹半导体有限公司与开曼宏力半导体制造有限公司合并

项目核准的批复》，截至 2010 年 12 月 31 日，拟合并的 Grace Cayman 的 100% 股权的评估值为约 6.93 亿美元，该等评估值低于 Grace Cayman 的实收资本 9.5 亿美元。根据发行人的说明，本次合并过程中，Grace Cayman 原股东未获得收益，不涉及缴纳所得税。

(3) 2013 年 4 月联和国际将托管股份转让予 Grace Cayman 的合并前股东

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，在发行人与 Grace Cayman 合并完成后，联和国际持有对发行人本金为 6,900 万美元的可转换公司债券，联和国际未实施相关转股权利，相关转股权已于 2012 年 9 月 30 日失效。根据发行人、Grace Cayman 与联和国际于 2011 年 12 月 28 日签订的《Escrow Deed》（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第八（二）2 项），联和国际将其持有的 11,010,635 股托管股份按照合并前原股东在 Grace Cayman 对应的持股比例转让予 Grace Cayman 的合并前股东（其中，已退出股东所应受让的股份由受让该等股东所持发行人股份的受让方承继）。发行人已于 2013 年 3 月召开董事会，同意前述股份转让事宜。前述股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	Grace Cayman 原股东暨受让方	转让托管股 份数（股）
1.	联和国际	联和国际	6,546,017
2.		Wisdom Power	1,072,490
3.		Panther Rock Limited	219,998

4.		Fitzalan Holdings Limited	25,473
5.		其他股东	3,146,657
<b>合计</b>			<b>11,010,635</b>

经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》，发行人于2014年3月28日的股东名册中未显示上述转让中3,645股股份的转让日期，且发行人于2013年6月27日及2014年5月12日的周年申报表中亦未显示上述股份中的3,645股股份的股份转让。根据本所律师与联和国际相关人员的访谈，前述情形系因个别股东未交回解除托管的转让文件，联和国际仍为相关股东代为托管3,645股股份。

本次托管股份转让完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称/ 姓名	持股数量（股）	持股比例 （%）
1.	华虹国际	350,401,100（其中 2,795,450股系为张江集 团托管）	43.5186
2.	联和国际	173,440,230（其中3,645 股系为其他股东托管）	21.5407
3.	NEC	99,038,800	12.3003
4.	香港海华	64,010,100	7.9498
5.	其他股东	118,285,426	14.6906
<b>合计</b>		<b>805,175,656</b>	<b>100</b>

经本所律师核查，发行人主要股东所对应的境内出资人华虹

集团、上海联和及上海贝岭股份有限公司已分别就其投资华虹国际、联和国际及香港海华办理外汇登记，并已就相关境外股东持有发行人股份事宜办理境外企业长期股权投资备案手续。

经本所律师核查，根据当时有效的《国家税务总局关于加强非居民企业股权转让所得企业所得税管理的通知》《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》的规定，股权转让交易双方为非居民企业且在境外交易的，由取得所得的非居民企业自行或委托代理人向被转让股权的境内企业所在地主管税务机关申报纳税，发行人就本次股份转让无代扣代缴义务。

(4) 2014年10月发行人在香港联交所首次公开发行股票并上市

经本所律师核查，发行人股东大会于2014年9月20日作出决议，同意发行人公开发行股票，同时批准董事行使发行人配发、发行及处置股份的一切权力（包括作出要约、订立协议、或授出将会或可能须配发及发行股份的证券的权力）。

经本所律师核查，根据发行人公开披露的相关信息，发行人于2014年10月以11.25港币/股的价格公开发行合计228,696,000股股份；本次发行完成后，发行人已发行股份总数增至1,033,871,656股。2014年10月15日，发行人在香港联交所主板挂牌上市。

本次于香港联交所首次公开发行股票并上市完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100 （其中 2,795,450 股系 为张江集团托管）	33.89
2.	联和国际	173,440,230（其中 3,645 股系为其他股东托管）	20.16
	Wisdom Power （注）	28,415,606	
	Panther Rock Limited（注）	5,828,846	
	Fitzalan Holdings Limited（注）	674,902	
3.	NEC	99,038,800	9.58
4.	香港海华	64,010,100	6.19
5.	其他股东	312,062,072	30.18
<b>合计</b>		<b>1,033,871,656</b>	<b>100</b>

注：Wisdom Power、Panther Rock Limited、Fitzalan Holdings Limited 均为联和国际之全资子公司。

(5) 发行人在香港联交所上市后涉及股本增加的变动情况，详见本补充法律意见书第二部分第三（二）项。

2. 发行人主要股权变动涉及外汇、税收、国资及其他相关主管部门审批程序的履行情况及合法合规性

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料，发行人的主要股权变动涉及外汇、税收、国资审批程序的履行情况如下：

序号	发行人的主要股权变动情况	国资程序	涉税情况	外汇情况
1	发行人的设立及收购华虹 NEC	国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹 NEC 中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。	根据普华永道中天会计师事务所有限公司于 2006 年 3 月 15 日出具的《审计报告》，截至 2004 年 12 月 31 日，华虹 NEC 实收资本为 74.03 亿元，并存在累计亏损约 27.7 亿元；根据国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，截至 2004 年 7 月 31 日拟划转至境外的华虹 NEC 的 100%股权的净资产评估值为约 62.24 亿元，该等评估值低于华虹 NEC 的实收资本 74.03 亿元。基于前文所述并根据发行人的说明，上述华虹 NEC 收购过程中，转让方未获得收益，不涉及缴纳所得税。	发行人主要股东所对应的境内出资人华虹集团、上海联和及上海贝岭股份有限公司已分别就其投资华虹国际、联和国际及香港海华办理外汇登记，并已就相关境外股东持有发行人股份事宜办理境外企业长期股权投资备案手续。
2	2011 年股份回购及合并	发行人当时之间接控股股东华虹集团、Grace Cayman 当时之间	就股份回购事宜，根据国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具的国资产权[2005]150	

		<p>接控股股东上海联和共同向上海市国资委提交《关于上海华虹 NEC 电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司境外母公司合并工作情况的报告》，将前述回购事宜、合并方案、合并完成后相关股东的股权比例等事宜报告予上海市国资委。2011 年 11 月 28 日，上海市国资委产权管理处出具了《说明》，确认已收阅相关工作报告。</p>	<p>号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，截至 2004 年 7 月 31 日拟划转至境外的华虹 NEC 的 100%股权的评估值为约 62.24 亿元。Newport 以其持有的华虹 NEC 10%股权置换发行人 10%的股份，其取得发行人 10%股份的成本系华虹 NEC 10%股权的价值(对应的评估值即 6.224 亿元)，高于本次股份回购的对价 3,200 万美元。基于前文所述并根据发行人的说明，上述股份回购过程中，Newport 未获得收益，不涉及缴纳所得税。</p> <p>就发行人与 Grace Cayman 公司合并事宜，根据 Ernst&amp;Young Hua Ming Shanghai Branch 于 2011 年 11 月 15 日出具的审阅报告，截至 2010 年 12 月 31 日，Grace Cayman 仍存在累计亏损约 10 亿美元。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会核发的发改外资[2011]2982 号《国家发展改革委关于香港华虹半导体有限公司与开曼宏力半导体</p>	
--	--	---	--	--

			<p>制造有限公司合并项目核准的批复》，截至 2010 年 12 月 31 日，拟合并的 Grace Cayman 的 100% 股权的评估值为约 6.93 亿美元，该等评估值低于 Grace Cayman 的实收资本 9.5 亿美元。根据发行人的说明，本次合并过程中，Grace Cayman 原股东未获得收益，不涉及缴纳所得税。</p>	
3	2013 年 4 月 联和国际将 托管股份转 让予 Grace Cayman 的合 并前股东	-	<p>根据当时有效的《国家税务总局关于加强非居民企业股权转让所得企业所得税管理的通知》《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》的规定，股权转让交易双方为非居民企业且在境外交易的，由取得所得的非居民企业自行或委托代理人向被转让股权的境内企业所在地主管税务机关申报纳税，发行人就本次股份转让无代扣代缴义务。</p>	
4	发行人于香 港联交所上 市	国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市	不涉及中国境内税费缴纳。	

		公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹 NEC 中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。		
5	2018年11月 鑫芯香港增 资	<p>华虹集团于 2017 年 12 月 15 日召开一届五十三次党委会，同意鑫芯香港入股发行人。</p> <p>大基金已于 2017 年 12 月 15 日召开第二十次董事会审议通过鑫芯香港入股发行人事宜，并就前述事宜于 2017 年 12 月 15 日出具了《国家集成电路产业投资基金重大项目核准意见表》。</p>	不涉及中国境内税费缴纳。	根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》的规定，境内投资主体设立或控制的境外企业在境外再投资设立或控制新的境外企业无需办理外汇备案手续，故鑫芯香港投资发行人无须办理外汇备案手续。
6	发行人实施 员工期权激 励计划	详见本补充法律意见书第一部分第八（一）项。	发行人已就员工期权激励事宜向主管税务局申报纳税。	发行人已向国家外汇管理局上海市分局办理发行人员工期权激励计划的外汇登记手续。

经本所律师核查，根据本所律师对国家税务总局及发行人境内子公司所属地方税务主管部门网站的公开查询，发行人及其境内子公司不存在税务处罚记录。

经本所律师核查，根据本所律师对国家外汇管理局及发行人境内子公司所属地方外汇主管部门网站的公开查询，发行人及其境内子公司不存在外汇处罚记录。

经本所律师核查，根据本所律师对国务院国有资产监督管理委员会及发行人境内子公司所属地方国有资产监督管理委员会网站的公开查询，发行人及其境内子公司不存在因国有资产事宜被处罚记录。

基于上述核查，本所律师认为，发行人历史沿革中的相关境外股东华虹国际、联和国际及香港海华已就持有发行人股份事宜办理境外企业长期股权投资备案手续，发行人已向国家外汇管理局上海市分局办理发行人境外员工期权激励的外汇登记手续；发行人收购华虹 NEC 股权至今的上述股权变动均已履行相关国资程序；发行人已就员工期权激励事宜向主管税务局申报纳税，发行人上述其他股权变动均不涉及中国境内税费缴纳或不涉及发行人作为扣缴义务人。

### 3. 发行人 2019 年分红情况及合法合规性

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料，发行人 2019 年现金分红的具体情况如下：发行人于 2019 年 5 月 9 日召开的股东周年大会审议通过《批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司普通股 0.31 港元》的议案，同意向符合条件的股东派发每股股息 0.31 港元。为实现上述分红，上海华虹宏力已于 2019 年 3 月 28 日召开董事会，同意上海华虹宏力向发行人发放

2018 年度股利 47,736,548 美元，并遵照相关法律规定在中国境内完成股利所得税代扣代缴义务。就前述上海华虹宏力向发行人分红事宜，上海华虹宏力已于 2019 年 6 月 10 日向国家税务总局上海市浦东新区税务局第一税务所报送服务贸易等项目对外支付税务备案表，并于 2020 年 2 月 23 日缴付企业所得税 32,120,013.69 元。上海华虹宏力已于 2019 年 6 月 21 日向其境内代理银行提交了《境外汇款申请书》，并已将税后分红款 42,962,893.2 美元汇至发行人。

基于上述核查，本所律师认为，发行人上述 2019 年分红事宜未违反境内与分红相关的外汇、税收、国资方面的法律法规的规定。

- (三) 按照股东核查的相关规定完善股东信息披露专项核查报告及主要股东信息披露工作，如确实无法穿透核查的应按照相关规则提供充分依据

本所律师已根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》《关于科创板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》《监管规则适用指引——发行类第 2 号》《关于科创板落实首发上市企业证监会系统离职人员入股监管相关事项的通知》《关于股东信息核查中“最终持有人”的理解与适用》《关于进一步规范股东穿透核查的通知》等规定进一步更新完善股东信息披露专项核查报告，详见本所律师更新出具的《上海市通力律师事务所关于华虹半导体有限公司股东信息披露专项核查报告》。

- 九. 审核问询问题 15.2 关于美国出口管制新规的影响：根据申报材料：报告期内，发行人使用的主要生产设备和原材料从境外供应商的采购占比较大，募投项目涉及生产设备购置及安装费达 50 亿美元，发行人存在部分境外或外籍员工。公开信息显示：美国近期公布了出口管制新规，新规将限制中国企业获取高性能芯片和先进计算机、限制中国获取先进半导体制造物项与设备、限制美国人**

**参与中国境内半导体开发活动等。请发行人说明：结合美国近期的限制性措施，全面分析对发行人生产经营、产品研发及募投项目建设的具体影响，产品（含服务）采购、员工聘任等是否会受到境外相关规定的限制，相应的应对措施及可行性。请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。**

经本所律师核查，根据本所律师通过公开信息的检索，2022年8月9日，美国政府出台《2022 芯片与科学法案》（以下简称“芯片法案”），计划通过设立约 527 亿美元的多个专项基金及实施投资税收抵免的优惠政策对半导体行业提供资金补助和税务补贴，并投入 2,000 多亿美元支持科学研究与创新。接受前述补助的相关企业在 10 年内不得在包括中国在内的受关注国家开展与半导体制造能力实质性扩张有关的任何重大交易，包括但不限于在相关国家新增扩建或新建先进半导体产能，但传统半导体（legacy semiconductors）产能可获例外。前述传统半导体主要包括：（1）采用 28 纳米或更早一代的制程工艺技术的逻辑芯片；（2）对于存储技术、模拟技术、封装技术和任何其它相关技术，则需要通过美国商务部等相关部门会商后进一步确定。

经本所律师核查，根据本所律师通过公开信息的检索，2022年10月7日，美国商务部（以下简称“BIS”）公布了出口管制新规，对《出口管理条例》（以下简称“EAR”）作出修订，实施更全面的与先进计算和半导体制造相关的限制措施，主要涉及高算力芯片、先进逻辑芯片和高端存储芯片制造等先进制程领域，并对实体清单（以下简称“EL”）与未经核实清单（以下简称“UVL”）管制措施进行更新，前述限制措施的主要内容如下：

序号	主要领域	主要内容
1.	高性能芯片和先进计算机相关限制	（1）将特定先进高性能计算芯片及含有该等芯片的计算机、电子组件或元件、以及开发前述产品的专用软件加入《商务管制清单》（以下简称“CCL”，出口、再出口列入 CCL 的物项等，需要向 BIS 申请取得出口许可证）；

		(2) 增加对“超级计算机”最终用途的管控，当出口商、再出口商等“知晓”涉华出口、再出口或境内转移特定受管控物项，且其最终用途为“超级计算机”时，需向 BIS 申请出口许可证。
2.	先进半导体制造物项与设备限制	<p>(1) 将特定先进半导体制造设备列入 CCL；</p> <p>(2) 增加对“先进制程半导体制造”最终用途的管控，当出口商、再出口商等“知晓”涉华出口、再出口或境内转移特定受管控物项，其最终用途为在中国境内的半导体制造设施中开发或生产集成电路且符合以下任一标准的，将实施严格的出口管制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 使用 16nm 或 14nm 及以下的非平面晶体管结构（FinFET 或 GAAFET）的逻辑芯片；</li> <li>ii. 采用半间距为 18nm 或更小的生产技术节点的 DRAM 存储芯片；</li> <li>iii. 使用 128 层及以上的 NAND 闪存芯片。</li> </ul>
3.	美国人士参与中国境内半导体开发活动限制	限制美国人士（包括美国公民、拥有美国永久居留权的自然人、根据美国及美国境内管辖地法律设立的法人及在外国的分支机构等）在未取得许可证的情况下通过提供服务、技术支持等方式在中国境内的半导体制造“设施”中开发或生产集成电路，主要限制活动范围为上述高性能芯片和先进计算机、先进半导体制造物项与设备相关领域。
4.	实体清单限制	新增 EL “脚注 4” 规则，扩大美国出口管制的域外管辖范围，适用于 EL 中位于中国的 28 个实体。
5.	未经核实清单限制	更新 UVL 相关管制措施，新增制裁 31 个中国实体。

经本所律师核查，上述芯片法案主要针对接受美国政府补助的半导体制造等相

关行业企业、限制其在中国境内进行特定先进半导体的实质性增产；上述美国出口管制新规的限制性措施主要管制高性能芯片及先进半导体制造设备和相关物项的出口，限制受管制物项最终用途为中国境内的超级计算机或先进制程半导体制造，并对参与前述活动的美国人士予以限制。根据招股说明书（申报稿）及发行人的说明，发行人工艺技术主要定位于特色工艺，工艺节点主要覆盖 0.35  $\mu\text{m}$  到 55nm 等，发行人主营业务、现有产品研发及募投项目建设未涉及芯片法案项下的限制性交易，未涉及高性能芯片和先进计算机以及先进半导体制造物项与设备领域，发行人员工在发行人处从事的工作亦未涉及前述限制性领域活动。上述美国限制性措施未对发行人生产经营、产品研发及募投项目建设造成重大不利影响，发行人产品（含服务）采购、员工聘任等尚未受到上述境外相关规定的限制。

经本所律师核查，根据发行人的说明，为了应对未来中美贸易摩擦、地缘冲突升级等对发行人境外采购可能造成的不利影响，一方面，发行人将综合利用全球资源，基于国家产业政策的高度支持和发行人与上下游产业链长期、稳定、广泛的合作，在产品（含服务）采购、研发、生产经营等多项业务条线中继续深化产业合作，维系国内外半导体合作伙伴的广泛信任与支持，保障发行人供应与销售稳定安全开展；另一方面，发行人将不断健全完善目前已建立的国际业务合规体系，自觉遵守国际间有关贸易往来的相关规定、政策，并根据美国等境外国家或地区的立法机关、政府部门或其他监管机构不时发布的规定、政策等持续对自身的合规体系进行完善，以确保在开展业务过程中遵守相关规定、政策，依法开展生产经营活动。

基于上述核查，本所律师认为，美国近期公布的上述限制性措施未对发行人生产经营、产品研发及募投项目建设造成重大不利影响，发行人产品（含服务）采购、员工聘任未受到境外相关规定的限制，且发行人已制定了切实可行的应对措施。

## 第二部分 关于发行人情况的补充

### 一. 本次发行的实质条件

经本所律师核查，安永华明于 2022 年 12 月 13 日就发行人财务报表出具了安永华明（2022）审字第 60985153\_B03 号《审计报告》。据此，本所律师对发行人本次发行涉及财务状况等相关实质条件发表如下补充意见：

#### （一） 关于本次发行是否符合《公司法》《证券法》规定的公开发行人民币普通股之条件

1. 经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》，发行人合并报表显示发行人2019年度、2020年度、2021年度及2022年1月至9月（以下合称“报告期”或“最近三年及一期”）经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为1,039,622,164.31元、505,457,513.37元、1,659,997,402.42元及1,905,779,004.96元。据此，本所律师认为发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项之规定。
2. 经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日的合并财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度及截至2022年9月30日止九个月期间的合并经营成果和现金流量。有鉴于前文所述并基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，本所律师认为，发行人最近三年及一期财务会计报告由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，发行人本次发行符合《证券法》第十二条第一款第（三）项之规定。

3. 经本所律师核查，根据发行人及其控股股东华虹国际、实际控制人华虹集团的确认、Conyers Dill & Pearman律师事务所于2022年12月12日出具的法律意见书及《香港法律审阅报告》，并经本所律师对公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其实际控制人华虹集团、控股股东华虹国际最近三年及一期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项之规定。

(二) 关于本次发行是否符合《管理办法》规定的公开发行人民币普通股之条件

1. 经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》，安永华明认为，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年9月30日的合并财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度及截至2022年9月30日止九个月期间的合并经营成果和现金流量。有鉴于前文所述并基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，本所律师认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《管理办法》第十一条第一款之规定。
2. 经本所律师核查，根据安永华明出具的安永华明（2022）专字第60985153\_B11号《华虹半导体有限公司内部控制审核报告》，安永华明认为，于2022年9月30日发行人及其子公司在《华虹半导体有限公司关于2022年9月30日与财务报表相关的内部控制的评估报

告》中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）建立的与财务报表相关的内部控制。基于本所律师作为非管理、财务专业人员的理解和判断，本所律师认为，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证发行人运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并且注册会计师已出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《管理办法》第十一条第二款之规定。

3. 经本所律师核查，根据发行人及其控股股东、实际控制人出具的确认、Conyers Dill & Pearman律师事务所于2022年12月12日出具的法律意见书、《香港法律审阅报告》，并经本所律师对公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年及一期不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《管理办法》第十三条第二款之规定。
4. 经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》、发行人董事及高级管理人员分别出具的确认、相关政府主管部门就境内董事及高级管理人员出具的无违法犯罪记录证明及本所律师对公开信息的查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人的董事及高级管理人员不存在最近三年及一期内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《管理办法》第十三条第三款之规定。

(三) 基于上文所述，本所律师认为，发行人本次发行已经满足《证券法》《管

理办法》《审核规则》《科创板上市规则》《若干意见》《实施办法》和《公告》规定的各项实质条件，本次发行尚待经上交所审核并报经中国证监会履行发行注册程序。

## 二. 发行人主要股东及实际控制人

- (一) 经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》、发行人提供的股东名册，截至2022年9月30日，发行人股份总数为1,306,506,969股，其股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	347,605,650	26.61
2.	联和国际	160,545,541（注）	12.29
	Wisdom Power（系联和国际之全资子公司）	28,415,606	2.17
3.	鑫芯香港	178,705,925	13.68
4.	其他股东	591,234,247	45.25
合计		1,306,506,969	100

注：含为其他股东托管的3,084股股份，前述事宜的具体情况详见律师工作报告第七部分第（二）项。

- (二) 经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》及发行人提供的相关资料，截至2022年9月30日，持有发行人5%以上股份的主要股东为华虹国际、联和国际及其全资子公司 Wisdom Power、鑫芯香港；其中，华虹国际持有发行人346,605,650股股份，占发行人股份总数的26.61%；联和国际持有发行人160,545,541股股份，占发行人股份总数的12.29%；Wisdom Power持有发行人28,415,606股股份，占发行人股份总数的2.17%；鑫芯香港持有发行人178,705,925股股份，占发行人股份总数的13.68%。

- (三) 经本所律师核查，根据发行人提供的相关资料，截至 2022 年 9 月 30 日，华虹国际持有发行人 347,605,650 股股份，占发行人于 2022 年 9 月 30 日已发行股份总数的 26.61%。

经本所律师核查，根据 Conyers Dill & Pearman 律师事务所于 2022 年 12 月 12 日出具的法律意见书，华虹国际作为一家在开曼群岛注册成立的控股主体，需要满足《开曼群岛经济实质法》项下的简化经济实质测试要求：（1）符合法律规定的所有适用的备案要求，（2）在开曼群岛具有充足的人力及合格的办公场所开展控股业务；如华虹国际已按《开曼群岛经济实质法》要求申报经济实质通知，在其提交经济实质报告后，华虹国际即已履行《开曼群岛经济实质法》项下相应财政年度的申报义务；基于华虹国际已取得的《存续证明》，华虹国际根据开曼群岛法律合法设立并有效存续，截至 2022 年 12 月 5 日，华虹国际在开曼群岛大法院不存在针对其未了结的诉讼案件。

### 三. 发行人的股本及演变

- (一) 发行人的设立至发行人于香港联交所上市的股本变动情况

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料，发行人收购华虹 NEC 股权至香港联交所上市前主要股东的股权变动情况如下：

#### 1. 发行人的设立及收购华虹 NEC

经本所律师核查，经国务院于 2004 年 12 月批示同意，为华虹 NEC 重组上市目的，华虹 NEC 中方股东华虹集团、张江集团、上海贝岭拟将其持有的华虹 NEC 股权划转到境外，并与华虹 NEC 外方股东合资设立拟上市公司，自行选择有利时机，到境外发行股票并在香港上市。

2005年1月21日，发行人在中国香港依据《公司条例》注册，设立时公司名称为“华虹半导体有限公司（Hua Hong Semiconductor Limited）”，设立时已发行股份数为1股，每股面值为0.01美元，该等已发行股份由Harefield Limited持有。

2005年3月3日，华虹 NEC 相关股东、发行人签订股权转让相关协议，约定华虹 NEC 当时全体注册于境内的股东分别将其持有的华虹 NEC 股权划转、转让予相关境外主体，并由华虹半导体向前述划转或转让完成后的华虹 NEC 全体股东发行股份购买其合计持有的华虹 NEC 100%股权，前述事宜的具体情况如下表所示：

单位：万美元

华虹 NEC 原股东情况			第一步：华虹 NEC 境内股东将 股权划转、转让予境外主体			第二步：发行人发行股份购买华 虹 NEC 全部股权		
股东名称	出资额	持股比例 (%)	划入方/ 受让方	出资额	持股比例 (%)	出售方	出售比例 (%)	对价股份 (股)
华虹集团	50,000	55.92	华虹国际	50,000	55.92	华虹国际 (注1)	61.42	350,401,100 (注2)
华虹国际	4,480	5.01	—	—	—			
张江集团 (注1)	437	0.49	华虹国际 (注1)	437	0.49			
中国日电	7,000	7.83	NEC	7,000	7.83	NEC	17.36	99,038,800
NEC	8,520	9.53	—	—	—			
上海贝岭	10,030	11.22	香港海华	10,030	11.22	香港海华	11.22	64,010,100
Newport	8,941	10	—	—	—	Newport	10	57,050,000
<b>合计</b>	<b>89,408</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>89,408</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>570,500,000</b>

注1：经本所律师核查，根据华虹集团、华虹国际与张江集团、张江国际于2005年3月3日签订的境外信托契据及华虹集团、华虹国际与张江集团于2005年3月3日签订的股权托

管及划转协议，张江集团将华虹 NEC 0.49%股权（即“华虹 NEC 权益”）委托华虹集团代管并划转至华虹国际，并授权华虹国际根据境外股权转让协议将其持有的华虹 NEC 权益置换为发行人 0.49%股权（对应发行人 2,795,450 股，即“发行人权益”）；股权置换后，由华虹国际根据协议约定代张江集团持有及管理发行人权益，并代表张江集团行使发行人权益项下的股东权利以及履行相应的股东义务；张江集团根据协议约定保留发行人权益项下的处分权、收益权等股东权利，并承担相应义务。

注 2：其中华虹国际所持有的发行人 1 股股份系自 Harefield Limited 处以 0.01 美元的价格受让取得。

经本所律师核查，国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 2 月 4 日出具国资产权[2005]150 号《关于对上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司资产评估项目予以核准的批复》，核准华虹 NEC 中方股东股权向境外划转及注入拟上市公司项目的资产评估报告。

经本所律师核查，中华人民共和国商务部分别于 2005 年 3 月 31 日、2005 年 4 月 30 日、2005 年 7 月 28 日核发商合批[2005]178 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司向境外划转股权并在香港设立华虹半导体有限公司的批复》、商资批[2005]720 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司股权转让等事宜的批复》、商资批[2005]1540 号《商务部关于同意上海华虹 NEC 电子有限公司转股的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，中华人民共和国国家发展和改革委员会于 2005 年 5 月 8 日核发发改外资[2005]730 号《国家发展改革委关于上海华虹 NEC 电子有限公司中方股东股权全部转移境外并在香港上市项目核准的批复》，同意上述事宜。

经本所律师核查，华虹国际、NEC、香港海华及 Newport 已于 2005 年 6 月 1 日被登记为发行人股东，华虹 NEC 之股权已于 2005 年 10 月 9 日变更登记至发行人名下。

上述华虹 NEC 收购完成后，发行人的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100 (其中 2,795,450 股系为 张江集团托管)	61.42
2.	NEC	99,038,800	17.36
3.	香港海华	64,010,100	11.22
4.	Newport	57,050,000	10
<b>合计</b>		<b>570,500,000</b>	<b>100</b>

## 2. 2011 年股份回购及合并

经本所律师核查，发行人于 2011 年回购了 Newport 持有的发行人 57,050,000 股普通股股份，并与联和国际控制的 Grace Cayman 进行了合并。发行人股东会已于 2011 年 7 月、2011 年 11 月审议通过前述事宜。2011 年 9 月 30 日，发行人当时之间接控股股东华虹集团、Grace Cayman 当时之间接控股股东上海联和共同向上海市国资委提交《关于上海华虹 NEC 电子有限公司和上海宏力半导体制造有限公司境外母公司合并工作情况的报告》，将前述回购事宜、合并方案、合并完成后相关股东的股权比例等事宜报告予上海市国资委。2011 年 11 月 28 日，上海市国资委产权管理处出具了《说明》，确认已收阅相关工作报告。2011 年 12 月 16 日，中华人民共和国国家发展和改革委员会下发《国家发展改革委关于香港华虹半导体有

限公司与开曼宏力半导体制造有限公司合并项目核准的批复》（发改外资[2011]2982号）至上海市发展改革委，批复同意前述合并项目。前述股份回购及合并事宜的具体情况如下：

(1) 发行人回购 Newport 股份

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，发行人于 2011 年 7 月召开股东会，同意发行人以 32,000,000 美元的价格回购 Newport 持有的发行人 57,050,000 股普通股股份。

经本所律师核查，华虹集团董事会已于 2011 年 6 月作出决议，同意授权华虹集团派在华虹半导体的董事投票同意上述回购事宜。

本次股份回购完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100（其中 2,795,450 股系为 张江集团托管）	68.24
2.	NEC	99,038,800	19.29
3.	香港海华	64,010,100	12.47
	<b>合计</b>	<b>513,450,000</b>	<b>100%</b>

(2) 发行人与 Grace Cayman 公司合并

经本所律师核查，根据发行人、Grace Cayman 及发行人新设

的开曼子公司于 2011 年 9 月 13 日签署的《合并协议》及发行人与 Grace Cayman 通过的董事会及股东大会决议，发行人拟与 Grace Cayman 进行合并，Grace Cayman 当时已发行股份总数为 3,389,953,406 股，联和国际持有其 1,796,760,768 股股份；除前述已发行股份外，Grace Cayman 当时尚存向联和国际已发行的尚未转股的 8,900 万美元可转换公司债券，及已授予部分主体可按一定价格购买 Grace Cayman 股份的认股期权。本次合并过程中，就前述三类情形的具体合并方案如下：

1) 关于 Grace Cayman 向联和国际发行的可转换公司债券的安排

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，发行人开展上述合并时，联和国际持有 Grace Cayman 已向其发行且尚未转股的可转换公司债券共计 8,900 万美元；发行人与 Grace Cayman、联和国际于 2011 年 12 月 22 日签订《Deed of Cancellation and Assumption》，约定收购完成前，联和国际将其所持本金为 2,000 万美元的 Grace Cayman 可转换公司债券转换为 Grace Cayman 200,000,000 股优先股，剩余 6,900 万美元可转换公司债券（以下简称“可转债”）则转由发行人承担相关义务。为消除转换尚未行使的可转债导致的任何摊薄影响，发行人、Grace Cayman 与联和国际于 2011 年 12 月 28 日签订《Escrow Deed》，约定发行人于上述收购完成后发行额外 11,010,635 股股份（以下简称“托管股份”），由联和国际（作为托管代理）以托管方式持有；如尚未行使的可转债于上述收购完成后获转换，托管股份将转

让予发行人的收购前股东，如于 2012 年 9 月 30 日前并无转换，托管股份将转让予 Grace Cayman 的收购前股东。

2) 关于 Grace Cayman 向其他主体授予的认股权的安排

经本所律师核查，根据发行人、Grace Cayman 及发行人新设的开曼子公司于 2011 年 9 月 13 日签署的《合并协议》、联和国际与认股权持有人签署的《Deed of Novation》《Call Option Agreement》及联和国际发出的认购通知，截至 2011 年 10 月，Grace Cayman 仍存在部分尚未行使认股权的持有人（以下简称“认股权持有人”），认股权持有人持有的认股权合计可认购 Grace Cayman 339,194,984 股股份。为推进上述公司合并事宜，联和国际与认股权持有人于 2011 年 10 月 25 日签署了《Deed of Novation》，约定认股权持有人将 Grace Cayman 于 2009 年授予其的认股权的全部权利、利益、责任及义务转让予联和国际；同时，联和国际与认股权持有人签署了《Call Option Agreement》，约定在联和国际行权后，作为向联和国际转让相关认股权的对价，联和国际授予相关认股权持有人自联和国际购买发行人普通股股份的认购期权，认购期权所对应发行人对应的股份数系联和国际因行使该认股权持有人期权所对应取得发行人的相关普通股股份数。

2011 年 10 月 25 日，联和国际向 Grace Cayman 发出通知，行使上述认股权，总行使价约为 4,070 万美元，对应认购 Grace Cayman 339,194,984 股股份。

3) 联和国际上述可转换公司债券转股、认股期权行权后，  
发行人与 Grace Cayman 的合并方案

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，为实现发行人与 Grace Cayman 合并，双方协商由发行人在开曼群岛设立一家其全资拥有的子公司，并由该子公司与 Grace Cayman 进行合并，合并子公司并入 Grace Cayman（作为存续公司），作为合并子公司并入 Grace Cayman 的对价，Grace Cayman 向合并子公司的股东（即发行人）发行 1 股；同时，Grace Cayman 注销其向除发行人外的其他股东已发行的股份（包括本次合并前 Grace Cayman 原已发行的 3,389,953,406 股股份、联和国际将其所持 2,000 万美元可转换公司债券转换的 Grace Cayman 200,000,000 股优先股、联和国际持有的认股期权行权后获得的 339,194,984 股股份），作为该等股东注销股份的对价，发行人同意按照 13.9969315 股 Grace Cayman 股份对应发行人 1 股股份的交流比率向 Grace Cayman 的股东合计发行 280,715,021 股。

经本所律师核查，发行人于 2011 年 9 月 2 日召开董事会及股东大会同意上述合并事宜；Grace Cayman 于 2011 年 9 月 9 日召开董事会，并于 2011 年 9 月 23 日召开优先股持有人之类别股东会及股东大会，同意上述合并事宜。

本次合并完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称/ 姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100（其中2,795,450股系为张江集团托管）	43.5186
2.	联和国际	177,901,203（其中11,010,635股系托管股份）	22.0947
3.	NEC	99,038,800	12.3003
4.	香港海华	64,010,100	7.9498
5.	其他股东	113,824,453	14.1366
	<b>合计</b>	<b>805,175,656</b>	<b>100</b>

3. 2013年4月联和国际将托管股份转让予 Grace Cayman 的合并前股东

经本所律师核查，根据发行人提供的相关文件资料，在发行人与 Grace Cayman 合并完成后，联和国际持有对发行人本金为 6,900 万美元的可转换公司债券，联和国际未实施相关转股权利，相关转股权已于 2012 年 9 月 30 日失效。根据发行人、Grace Cayman 与联和国际于 2011 年 12 月 28 日签订的《Escrow Deed》（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第一部分第八（二）2 项），联和国际将其持有的 11,010,635 股托管股份按照合并前原股东在 Grace Cayman 对应的持股比例转让予 Grace Cayman 的合并前股东（其中，已退出股东所应受让的股份由受让该等股东所持发行人股份的受让方承继）。发行人已于 2013 年 3 月召开董事会，同意前述股份转让事宜。前述股份转让的具体情况如下：

序号	转让方	Grace Cayman 原股东暨受让方	转让托管股份数 (股)
1.	联合国国际	联合国国际	6,546,017
2.		Wisdom Power Technology Limited	1,072,490
3.		Panther Rock Limited	219,998
4.		Fitzalan Holdings Limited	25,473
5.		其他股东	3,146,657
合计			<b>11,010,635</b>

经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》，发行人于2014年3月28日的股东名册中未显示上述转让中3,645股股份的转让日期，且发行人于2013年6月27日及2014年5月12日的周年申报表中亦未显示上述股份中的3,645股股份的股份转让。根据本所律师与联合国国际相关人员的访谈，前述情形系因个别股东未交回解除托管的转让文件，联合国国际仍为相关股东代为托管3,645股股份。

本次托管股份转让完成后，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100（其中 2,795,450股系为 张江集团托管）	43.5186
2.	联合国国际	173,440,230（其中 3,645股系为其他 股东托管）	21.5407

3.	NEC	99,038,800	12.3003
4.	香港海华	64,010,100	7.9498
5.	其他股东	118,285,426	14.6906
<b>合计</b>		<b>805,175,656</b>	<b>100</b>

4. 2014年10月发行人在香港联交所首次公开发行股票并上市

经本所律师核查，发行人股东大会于2014年9月20日作出决议，同意发行人公开发行股票，同时批准董事行使发行人配发、发行及处置股份的一切权力（包括作出要约、订立协议、或授出将会或可能须配发及发行股份的证券的权力）。

经本所律师核查，根据发行人公开披露的相关信息，发行人于2014年10月以11.25港币/股的价格公开发行合计228,696,000股股份；本次发行完成后，发行人已发行股份总数增至1,033,871,656股。2014年10月15日，发行人在香港联交所主板挂牌上市。

本次于香港联交所首次公开发行股票并上市完成后，发行人的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100 （其中2,795,450股 系为张江集团托管）	33.89
2.	联和国际	173,440,230（其中 3,645股系为其他股东 托管）（注2）	20.16

	Wisdom Power (注 1)	28,415,606	
	Panther Rock Limited (注 1)	5,828,846	
	Fitzalan Holdings Limited (注 1)	674,902	
3.	NEC	99,038,800	9.58
4.	香港海华	64,010,100	6.19
5.	其他股东	312,062,072	30.18
	<b>合计</b>	<b>1,033,871,656</b>	<b>100</b>

注 1: Wisdom Power、Panther Rock Limited、Fitzalan Holdings Limited 均为联和国际之全资子公司。

注 2: 2016 年 3 月 9 日, 联和国际将其代为托管的 561 股股份转让给实际权益人; 截至 2022 年 9 月 30 日, 联和国际仍为相关股东托管 3,084 股股份。

## (二) 发行人在香港联交所上市后涉及股本增加的变动情况

### 1. 2015 年 9 月第一期期权激励计划

经本所律师核查, 发行人股东特别大会于 2015 年 9 月 1 日作出决议, 同意采纳股票期权计划, 并授权董事会自计划批准日 7 年内任何时间全权决定授予参与者按行权价认购一定数量发行人股票的权利; 该股票期权计划项下拟授出的所有期权及发行人任何其他股票期权计划项下拟授出的任何期权获行使时可予发行的股票总数, 合计不得超过当时的已发行股本总数的 10%, 且该等股票期权计划项下首次授予的期权数量不超过发行人总股本的 3%。

经本所律师核查，上海市国资委已于 2015 年 8 月 14 日出具沪国资委分配（2015）278 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划的批复》，原则同意上述期权激励计划。

经本所律师核查，根据发行人股东大会的上述授权，发行人董事会于 2015 年 9 月 4 日作出决议，同意于 2015 年 9 月 4 日向董事及雇员授出股票期权。发行人本次授出 30,250,000 份期权，前述期权可按行权价 6.912 港元认购合计最多 30,250,000 股股票，本次期权分三期归属，并将于 2022 年 9 月 3 日失效。

## 2. 2018 年 11 月增资

经本所律师核查，发行人于 2018 年 1 月 3 日与大基金签订《认购协议》，约定大基金（无论是通过其自身或是通过其指定人士）认购发行人 242,398,925 股股份，认购价为每股 12.9002 港元；发行人股东特别大会于 2018 年 2 月 14 日作出决议，同意前述股份认购事宜。大基金指定的主体鑫芯香港已于 2018 年 11 月 7 日完成前述股份认购。

经本所律师核查，根据华虹集团提供的党委会议纪要及大基金提供的《国家集成电路产业投资基金重大项目核准意见表》，华虹集团于 2017 年 12 月 15 日召开一届五十三次党委会，同意上述股份认购事宜；大基金已于 2017 年 12 月 15 日召开第二十次董事会审议通过上述股份认购事宜，并就前述事宜于 2017 年 12 月 15 日出具了《国家集成电路产业投资基金重大项目核准意见表》。

本次增资完成后，发行人股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	350,401,100 （其中 2,795,450 股股份系为张江集团托管）	27.30
2.	联和国际及其子公司	195,464,895 （其中 3,084 股股份系为其他股东托管）	15.23
3.	鑫芯香港	242,398,925	18.88
4.	其他流通股	495,485,971	38.60
合计		<b>1,283,750,891</b>	<b>100</b>

### 3. 2018 年 12 月第二期股票期权计划第一次授予

经本所律师核查，发行人董事会于 2018 年 12 月 18 日作出决议，同意于 2018 年 12 月 24 日及 2019 年 12 月 23 日向若干雇员和/或董事配发股票期权，但该等期权计划的实施须根据国资监管部门的要求取得发行人股东的批准为前提。发行人于 2018 年 12 月 24 日向发行人若干员工及当时的董事授出 34,500,000 份期权（该等期权须经发行人股东大会批准后方可生效）。前述期权可按行权价 15.056 港元认购合计最多 34,500,000 股股票，其中，就发行人副总裁及以上级别的职员（连同董事）而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属；前述期权将于 2025 年 12 月 23 日失效。

经本所律师核查，上海市国资委于 2019 年 3 月 12 日出具沪国资委分配（2019）44 号《关于同意华虹半导体有限公司实施股权激励计划（二期）的批复》，原则同意《华虹半导体有限公司股权激励计划（二期）方案》，并按有关规定提交发行人股东大会审议。

经本所律师核查，发行人股东特别大会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意根据发行人于 2015 年 9 月 1 日采纳的股票期权计划于 2018 年 12 月 24 日授出 34,500,000 份股票期权，并同意于 2019 年 12 月 23 日或前后进一步授出 4,000,000 份股票期权。

4. 2019 年 3 月第二期股票期权计划第二次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及发行人股东大会的授权，发行人董事会于 2019 年 3 月 28 日作出决议，同意于 2019 年 3 月 29 日向唐均君授出 500,000 份期权，前述期权可按行权价 18.40 港元认购合计最多 500,000 股股票；本次期权分四期归属，并将于 2026 年 3 月 28 日失效。

5. 2019 年 12 月第二期股票期权计划第三次授予

经本所律师核查，根据上述上海市国资委的批复及发行人股东大会的授权，发行人董事会于 2019 年 11 月 12 日作出决议，同意于 2019 年 12 月 23 日向华虹无锡具有重要技术专长及/或担任核心管理职位的 101 名员工授予 2,482,000 份期权。前述期权可按行权价 17.952 港元认购合计最多 2,482,000 股股票，其中，就华虹无锡副总裁及以上级别的职员而言，本次期权分四期归属；就其他职员而言，本次期权分三期归属。前述期权将于 2026 年 12 月 22 日失效。

6. 2021 年 11 月发行人股票期权计划调整

经本所律师核查，发行人股东特别大会于 2021 年 11 月 26 日作出

决议，鉴于发行人的总股本已发生变更，为使发行人能够更灵活地向其雇员提供激励及奖励，同意将发行人股票期权计划授出限额由 103,387,165 股股票（占发行人于 2015 年 9 月审议股票期权激励计划方案时总股本的 10%）调整为 130,047,036 股股票（占发行人本次股东大会审议时总股本的 10%）。

根据发行人证券变动月报表，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人已授予员工的期权中，已行权的期权数量为 30,236,388 份，已授予但尚未行权的期权数量为 23,854,534 份。

- (三) 经本所律师核查，根据发行人提供的相关资料，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人的股本结构如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1.	华虹国际	347,605,650	26.61
2.	联和国际	160,545,541（注）	12.29
	Wisdom Power（系联和国际之全资子公司）	28,415,606	2.17
3.	鑫芯香港	178,705,925	13.68
4.	其他股东	591,234,247	45.25
合计		1,306,506,969	100

注：含为其他股东托管的 3,084 股股份

#### 四. 发行人的业务

- (一) 经本所律师核查，除已出具法律意见中披露的许可、备案外，发行人新增取得的主要经营资质或备案情况如下：

序号	持证单位	证书编号	发证部门	有效期
1.	上海华虹宏力 (一厂)	913100000576745 32R002Q	上海市浦 东新区生 态环境局	2022年12月20日 至2027年12月19 日止
2.	上海华虹宏力 (三厂)	913100000576745 32R003V		2022年11月8日至 2027年11月7日止

(二) 经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》，报告期内发行人主营业务收入与营业总收入情况如下：

单位：元

项目	2022年1月至9月	2021年度	2020年度	2019年度
主营业务收入	12,173,063,536.62	10,523,435,890.54	6,638,976,291.57	6,428,183,946.68
营业总收入	12,260,872,870.42	10,629,677,535.99	6,737,026,343.39	6,522,230,198.13
主营业务收入占比	99.28%	99.00%	98.54%	98.56%

报告期内发行人的主营业务收入占发行人营业总收入的比重较高。据此，本所律师认为，发行人主营业务突出。

(三) 经本所律师核查，并经查阅《香港法律审阅报告》，截至本补充法律意见书出具之日，发行人未出现依法律、法规以及规范性文件、《公司章程》规定的需终止的事由，在现行法律、法规以及规范性文件未发生对发行人业务经营具有重大不利影响之变化的情况下，发行人不存在持续经营的法律障碍。

## 五. 关联（连）交易及同业竞争

（一） 经本所律师核查，根据发行人提供的资料、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号〈公开发行证券的法律意见书和律师工作报告〉》《科创板上市规则》《香港上市规则》的规定并参照其他法律、法规以及规范性文件的规定，除已出具法律意见已披露的相关企业外，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人新增或新增与发行人发生交易的主要关联（连）方情况如下：

### 1. 发行人的控股子公司

经本所律师核查，本补充法律意见书第二部分第六（四）项所披露的发行人新增的控股子公司构成发行人的关联方。

### 2. 直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

经本所律师核查，华虹国际为发行人的控股股东，华虹集团为发行人的实际控制人，华虹国际及华虹集团新任董事、监事和高级管理人员或其他主要负责人构成发行人的关联方。

### 3. 直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

经本所律师核查，担任直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人直接或间接控制的，

或由其（独立董事除外）担任董事或高级管理人员的法人或其他组织构成发行人的关联方。于 2022 年 9 月 30 日，除已出具法律意见中已披露的关联方外，与发行人发生交易的前述法人或其他组织主要包括：

序号	企业名称	关联关系
1.	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	华虹集团原董事报告期内曾担任其董事

4. 法律、法规以及规范性文件规定的其他关联方

5. 《香港上市规则》所界定的关连方

(二) 经本所律师核查，根据《审计报告》、招股说明书（申报稿）、发行人提供的文件资料，除已出具法律意见中已披露的关联交易外，发行人及其控股子公司与关联（连）方之间于 2022 年 1 月至 9 月期间主要关联（连）交易情况如下（发行人及其控股子公司之间发生的交易除外）：

1. 销售商品

单位：元

关联（连）方	2022 年 1 月至 9 月
上海华虹挚芯电子科技有限公司	46,189,688.63
上海矽睿	22,034,870.37
上海集成	20,729,132.82
上海华虹虹日电子有限公司	16,856,455.51
芯原微电子（上海）股份有限公司	1,730,736.00

## 2. 采购商品

单位：元

关联（连）方	2022年1月至9月
上海华虹虹日电子有限公司	88,364,139.49
华海清科股份有限公司	67,120,434.00
上海华虹挚芯电子科技有限公司	4,170,634.68
NEC Management Partner, Ltd.	3,884,638.51
公司一	740,930.00
华力集	124,740.00
上海华虹计通智能系统股份有限公司	70,057.50

## 3. 关联（连）租赁

单位：元

关联（连）方	项目	2022年1月至9月
华力微	租赁收入	71,668,978.88
华虹科技及其子公司	支付的租金	8,604,220.17
	租赁负债利息支出	3,604,292.24

经本所律师核查，除已出具法律意见中已披露的租赁合同及相关补充协议外，根据上海华虹宏力与华虹置业于2022年签订的租赁合同补充协议，上海华虹宏力向华虹置业新增租赁位于上海市浦东新区锦绣东路2777弄华虹创新园面积为7,726.32平方米的房屋，租赁期限为自2022年9月7日至2022年12月31日。

## 4. 物业管理费

单位：元

关联（连）方	2022年1月至9月
华虹科技及其子公司	1,939,503.23

经本所律师核查，除已出具法律意见中已披露的物业服务合同及相关协议外，根据上海华虹宏力与华锦物业于2022年9月7日签署的《华虹创新园扩租面积物业服务合同（租赁）》，华锦物业为上海华虹宏力新增租赁的房屋提供物业管理服务，并向上海华虹宏力收取基础物业服务费、网络服务费等，合同期限为自2022年9月7日至2022年12月31日。

5. 为关联（连）公司代收代付水电物业费等

单位：元

关联（连）方	2022年1月至9月
华力微	169,320,456.46
Hua Hong International (Americas) Inc.	59,530.14

经本所律师核查，除已出具法律意见中已披露的租赁合同及相关补充协议外，根据出租方 Grace USA 和承租方 Hua Hong International (Americas) Inc. 于2022年7月签订的《转租协议》，Grace USA 将其位于 530 Alder Drive, Milpitas, CA 的租赁物业部分转租予 Hua Hong International (Americas) Inc. 使用并相应收取租金，转租期限为自2022年7月1日至2023年6月30日，转租面积为380平方英尺。

6. 取得借款、银行借款利息支出

单位：元

关联（连）方	项目	2022年1月至9月
上海银行股份有限公司	取得借款	207,740,148.00
	银行借款利息支出	3,971,104.64

7. 利息收入

单位：元

关联（连）方	2022年1月至9月
上海银行股份有限公司	412,707.02

8. 存放关联（连）方的货币资金

单位：元

关联（连）方	2022年9月30日
上海银行股份有限公司	31,231,174.13

9. 与关联（连）方共同投资

经本所律师核查，根据华虹无锡、上海华虹宏力、发行人、大基金、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司与无锡锡虹联芯投资有限公司于2022年6月29日订立的《关于华虹半导体（无锡）有限公司的增资协议》及本所律师于国家企业信用信息公示系统的查询，华虹无锡注册资本由180,000万美元增加至253,685.180069万美元，其中，发行人出资177,777,600美元认购华虹无锡163,744,680.85美元新增注册资本，上海华虹宏力出资

230,222,400 美元认购华虹无锡 212,049,737.5 美元新增注册资本，无锡锡虹联芯投资有限公司出资 160,000,000 美元认购华虹无锡 147,370,360.14 美元新增注册资本，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认缴出资 232,000,000 美元认购 213,687,022.2 美元新增注册资本。前述出资均以等值人民币现金方式出资。

10. 关联（连）方应收款项余额

单位：元

项目	关联（连）方	2022年9月30日
应收账款	上海华虹挚芯电子科技有限公司	10,268,096.00
	上海集成	3,266,789.54
	芯原微电子（上海）股份有限公司	251,739.50
	上海矽睿	216,620.25
其他应收款	华力微	62,787,918.54
	上海华虹挚芯电子科技有限公司	56,861.00
	上海矽睿	3,145.00
	上海集成	60.00

11. 关联（连）方应付款项余额

单位：元

项目	关联（连）方	2022年9月30日
应付账款	上海华虹虹日电子有限公司	13,813,370.88
	华海清科股份有限公司	3,621,680.32

	上海华虹攀芯电子科技有限公司	2,611,557.86
	华虹科技及其子公司	162,534.00
	上海华虹计通智能系统股份有限公司	121,592.50
	华力集	104,868.96
其他应付款	华海清科股份有限公司	42,979,800.00
预收账款	华力微	46,208,775.91
	上海华虹攀芯电子科技有限公司	28,399.20
合同负债	上海华虹虹日电子有限公司	7,048,437.00
	上海华虹攀芯电子科技有限公司	1,180,876.35
	上海集成	467,468.61
一年内到期的非流动负债	上海银行股份有限公司	11,856,666.00
	华虹科技及其子公司	7,194,636.60
长期借款	上海银行股份有限公司	195,883,482.00
租赁负债	华虹科技及其子公司	94,485,635.06

(三) 经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》，自2019年1月1日至该报告出具之日，根据HSF审阅的材料及发行人的确认，发行人就关联交易相关事项不存在重大违反《香港上市规则》的情形（即根据2022年1月1日生效的香港联交所《纪律程序》，属于以下其中一类的实际或潜在违反《香港上市规则》的事件：（i）通过标准处分程序和标准处分表（如适用）处理的违规事件；或（ii）通过聆讯处理的违规事件）。

(四) 经本所律师核查，发行人实际控制人华虹集团已于2022年12月进一步出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1. 自该承诺函出具之日起，其及其控制的除发行人及其控股子公司外的其他企业未来不会在65/55nm工艺节点上扩充产能。
2. 上述承诺在其作为发行人实际控制人期间有效。
3. 自该承诺函出具之日起，若因其违反该承诺函任何条款而致使发行人遭受或产生的任何损失或开支，其将予以全额赔偿。

## 六. 发行人的主要资产

### (一) 发行人及其控股子公司拥有的主要租赁物业

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料，截至2022年9月30日，除已出具法律意见中已披露的主要租赁物业外，发行人及其控股子公司存在变动的自第三方承租之主要经营物业情况如下：

序号	承租方	出租方	租赁地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	用途
1.	上海 华虹 宏力	住友仓储 (中国) 有限公司	金桥出口加工区王桥路 600号仓库	5,000	2022年6 月15日至 2024年6 月14日	仓库
2.			申东路251 弄4号仓库	3,700	2022年6 月15日至 2024年6 月14日	仓库
3.		上海北芳 储运集团	上海金山区 浦卫公路	500	2022年6 月1日至	仓库

		有限公司	10481 号		2024 年 5 月 31 日	
--	--	------	---------	--	--------------------	--

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料，发行人及其控股子公司就上述租赁物业存在未办理租赁备案登记的情况。根据《中华人民共和国民法典》等相关规定，租赁合同不因未办理租赁备案登记手续而无效，因此发行人及其控股子公司租赁上述物业所涉之房屋租赁合同虽未办理租赁备案登记，但并不影响该等房屋租赁合同的法律效力。

基于上述核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司租赁的上述物业所涉之租赁合同内容不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形。

## (二) 发行人及其控股子公司拥有的主要注册商标

### 1. 发行人及其控股子公司拥有的主要境内注册商标

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及本所律师对国家知识产权局相关网站的公开查询，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司于中国境内注册并取得《商标注册证》的主要商标共计 39 项，具体情况详见本补充法律意见书附件一表 1。

基于上述核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司系自行申请取得上述境内注册商标，发行人及其控股子公司已取得的上述境内注册商标不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

### 2. 发行人及其控股子公司拥有的主要境外注册商标

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、《香港法律审阅报

告》，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司于中国境外取得的主要商标共计 9 项，具体情况详见本补充法律意见书附件一表 2。

根据《香港法律审阅报告》，发行人及其控股子公司持有的上述境外注册商标均已有效注册。

### (三) 发行人及其控股子公司拥有的主要专利

#### 1. 发行人及其控股子公司拥有的主要境内专利

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及本所律师对国家知识产权局相关网站的公开查询，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司于中国境内申请并已获授权的对发行人主营业务有重要影响的专利共计 323 项，具体情况详见本补充法律意见书附件二表 1。

基于上述核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司系自行申请取得上述中国境内专利权，发行人及其控股子公司已取得的上述中国境内专利权不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

#### 2. 发行人及其控股子公司拥有的主要境外专利

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、美国大易律师事务所出具的法律意见书，截至 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司于中国境外取得的对发行人主营业务有重要影响的主要专利共计 41 项，具体情况详见本补充法律意见书附件二表 2。

经本所律师核查，根据美国大易律师事务所于 2022 年 12 月 9 日出

具的法律意见书，发行人及其控股子公司持有的上述境外专利目前均为有效。

(四) 发行人的控股子公司、参股公司

经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，除已出具法律意见中已披露的发行人的控股子公司、参股公司情况外，发行人控股子公司、参股公司的主要变化情况如下：

1. 发行人新设控股子公司无锡华虹制造

经本所律师核查，根据统一社会信用代码为 91320214MABP7NAE9E 的《营业执照》、无锡华虹制造的章程及本所律师于国家企业信用信息公示系统的查询，上海华虹宏力于 2022 年 6 月 17 日新设立了一家全资子公司无锡华虹制造，无锡华虹制造的基本情况如下：

名称	华虹半导体制造（无锡）有限公司
统一社会信用代码	91320214MABP7NAE9E
法定代表人	张素心
注册资本	668万元
注册地址	无锡市新吴区新洲路30-1号
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2022年6月17日至2072年6月16日
股权结构	上海华虹宏力持有其100%股权

## 2. 华虹无锡

经本所律师核查，根据统一社会信用代码为 91320214MA1R9H5T8X 的《营业执照》、华虹无锡的章程及本所律师于国家企业信用信息公示系统的查询，华虹无锡于 2022 年 9 月 15 日注册资本由 180,000 万美元增加至 253,685.180069 万美元，新增注册资本由发行人、上海华虹宏力、无锡锡虹联芯投资有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认缴（前述事宜的具体情况详见本补充法律意见书第二部分第五（二）9 项）。前述增资完成后，华虹无锡的基本情况如下：

名称	华虹半导体（无锡）有限公司
统一社会信用代码	91320214MA1R9H5T8X
法定代表人	张素心
注册资本	253,685.180069 万美元
注册地址	无锡市新吴区新洲路30号
经营范围	集成电路产品的设计、开发、制造、测试、封装、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2017年10月10日至2068年2月13日
股权结构	发行人持有其22.22%股权，上海华虹宏力持有其28.78%股权，大基金持有其20.58%股权，无锡锡虹联芯投资有限公司持有其20%股权，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有其8.42%股权

### 3. 上海艾为

经本所律师核查，根据发行人提供的上海艾为证券账户交易明细并经发行人说明，发行人控股子公司上海华虹宏力于 2022 年 8 月至 9 月期间出售其持有上海艾为的 35 万股股票，截至 2022 年 9 月 30 日，上海华虹宏力仍持有上海艾为 0.11% 的股份。

基于上述核查，本所律师认为，发行人持有的上述控股子公司、参股公司的股权不存在产权纠纷或潜在产权纠纷。

- (五) 经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》，于 2022 年 9 月 30 日，发行人固定资产账面价值为 18,061,829,226.97 元，主要包括房屋及建筑物、厂务设施、机器设备、运输工具、办公设备。

## 七. 重大债权、债务关系

- (一) 经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料、《审计报告》，除已出具法律意见中已披露的重大合同外，发行人报告期内的重大合同主要有：

### 1. 销售合同

经本所律师核查，截至 2022 年 9 月 30 日，除已出具法律意见中已披露的销售框架协议外，发行人及其境内控股子公司与报告期新增的前五大客户签署的正在履行中的销售框架协议或在报告期内签署的单笔金额最高的订单情况如下：

经本所律师核查，根据客户三与华虹无锡于 2022 年 6 月 2 日签署的《采购单》，华虹无锡向客户三提供集成电路晶圆代工，订单价格为 7,762.32 万元。

## 2. 原材料采购合同

经本所律师核查，除已出具法律意见中已披露的订单外，发行人及其境内控股子公司与报告期前五大原材料供应商在报告期内新增签署的单笔金额最高的订单情况如下：

经本所律师核查，根据供应商三与华虹无锡于 2022 年 7 月 5 日签署的《采购单》，华虹无锡向供应商三采购硅片，订单价格为 114.44 万美元。

经本所律师核查，根据供应商五与华虹无锡于 2022 年 6 月 7 日签署的《采购单》，华虹无锡向供应商五采购硅片，订单价格为 847.45 万美元。

## 3. 借款合同

经本所律师核查，于 2022 年 9 月 30 日，除已出具法律意见中已披露的授信合同、借款合同外，发行人及其境内控股子公司新增的正在履行的 50,000 万元以上的借款合同如下：

根据华虹无锡与国家开发银行江苏省分行于 2022 年 7 月 21 日签订的合同编号为 3210202201100002589 《国家开发银行建设项目外汇

资金短期贷款合同》，国家开发银行江苏省分行向华虹无锡提供金额为 20,000 万美元的借款；本借款执行浮动利率，贷款年利率为 3 个月美元 LIBOR+75BP；借款期限为自该合同约定的第一笔贷款提款日起 12 个月期满之日止。

经本所律师核查，发行人及其境内控股子公司上述适用中国境内法律的重大合同不存在违反中国境内法律、行政法规强制性规定的情形。

(二) 经本所律师核查，根据《香港法律审阅报告》《审计报告》、发行人提供的说明及本所律师对信用中国、中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网站的公开查询，发行人不存在因知识产权、环境保护、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的重大侵权之债。

(三) 经本所律师核查，根据发行人提供的相关资料、安永华明出具的《审计报告》，于 2022 年 9 月 30 日，除律师工作报告第九部分第（二）项及本补充法律意见书第二部分第五（二）项披露的关联（连）交易情况外，发行人及其控股子公司与关联（连）方之间不存在其他重大债权债务关系。

经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》，于 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司未向关联（连）方提供担保。

(四) 经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》以及发行人提供的文件资料，于 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司存在的金额较大的其他应收款、其他应付款情况如下：

#### 1. 其他应收款

- (1) 发行人及其控股子公司存在对华力微 62,787,918.54 元的其他应收款，前述款项主要系发行人及其控股子公司为华力微垫付的水电物业费等。
- (2) 发行人及其控股子公司存在对保险人 51,483,902 元的其他应收款。根据发行人提供的文件资料，上海华虹宏力因厂区内发生停电事故向保险人进行索赔，根据公估公司出具的报告，其建议保险人暂设准备金合计 811 万美元，发行人按照前述金额及于 2022 年 3 月 31 日美元对人民币的汇率中间价预计对保险人的应收保险赔款为 51,483,902 元。最终保险赔款以届时保险人实际支付的为准。
- (3) 发行人及其控股子公司存在对核聚证券有限公司 9,724,580.58 元的其他应收款，前述款项系应收期权行权费。
- (4) 发行人及其控股子公司存在对苏南冠寓商业运营管理（无锡）有限公司 1,505,042 元的其他应收款，前述款项系根据与苏南冠寓商业运营管理（无锡）有限公司签订的《酒店式公寓租赁服务合作协议》的约定，向苏南冠寓商业运营管理（无锡）有限公司支付的租赁押金。
- (5) 发行人及其控股子公司存在对无锡华润燃气有限公司 1,164,900.00 元的其他应收款，前述款项系天然气押金。

## 2. 其他应付款

经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》、发行人提供的文件资料，于 2022 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司存在的金额较大的其他应付款主要系应付建设工程、资产采购款等。

基于上述核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司上述其他应收款、其他应付款系在正常经营过程中发生，不存在违反中国境内法律、行政法规强制性规定的情形。

## **八. 发行人股东大会、董事会议事规则及规范运作**

经本所律师核查，就报告期内股东大会、董事会会议的召开程序、决议内容及签署（包括股东大会及董事会的授权）事宜，根据《香港法律审阅报告》：“在审阅材料、公司确认及该报告中‘监管和争议’章节所述内容的基础上，上述公司股东大会和董事会的召开程序、决议内容及签署（包括股东大会及董事会的授权）在所有重大方面均符合当时有效的香港法律、《香港上市规则》及《公司章程》的规定。”

## **九. 税务及补贴**

### **(一) 发行人及其境内控股子公司、分支机构的税务合规情况**

#### **1. 发行人及力鸿科技的税务合规情况**

根据 HSF 出具的《香港法律审阅报告》，HSF 未发现发行人及力鸿科技于 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日存在违反香港税法的重大违法行为。

## 2. 上海华虹宏力的税务合规情况

经本所律师核查，国家税务总局上海市浦东新区税务局第一税务所于 2022 年 11 月 2 日出具《无欠税证明》，证明上海华虹宏力“截至 2022 年 10 月 30 日，未发现有欠税情形。”

经本所律师核查，上海华虹宏力于 2022 年 11 月 22 日出具《关于协助开具信用报告的申请》，向上海市浦东新区金融工作局申请查询发行人包括但不限于税务事项；上海市公共信用信息服务中心于 2022 年 11 月 24 日就前述查询事项提供了《法人公共信用信息查询报告》，截至查询时间（2022 年 11 月 24 日），不存在因税务事项给予行政处罚的记录。

## 3. 华虹无锡的税务合规情况

经本所律师核查，国家税务总局无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）税务局于 2022 年 11 月 10 日出具《涉税信息查询结果告知书》，告知：“截止至 2022 年 11 月 10 日 14 时，经查询金税三期税收管理系统（或者其他系统），暂未发现华虹半导体（无锡）有限公司自 2022 年 04 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日期间存在税收违法记录。”

## 4. 无锡置业的税务合规情况

经本所律师核查，国家税务总局无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）税务局于 2022 年 11 月 10 日出具《涉税信息查询结

果告知书》，告知：“截止至 2022 年 11 月 10 日 14 时，经查询金税三期税收管理系统（或者其他系统），暂未发现华虹置业（无锡）有限公司自 2022 年 04 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日期间存在税收违法行为。”

**(二) 发行人及其境内控股子公司的主要补贴**

经本所律师核查，根据安永华明出具的《审计报告》、发行人提供的相关资料，发行人及其控股子公司在报告期内获得的政府补助包括但不限于浦东新区财政扶持款、上海市张江科学城专项发展扶持资金、无锡高新区产业扶持款等。

基于上述核查，本所律师认为，发行人及其境内控股子公司获得的上述补贴、补助符合法律、法规以及规范性文件的规定。

**十. 发行人及其控股子公司、分支机构的合规情况**

**(一) 市场监督管理合规**

上海市市场监督管理局于 2022 年 10 月 21 日出具编号为 000000202210000090 的《合规证明》：“上海华虹宏力半导体制造有限公司(社会信用码 91310000057674532R)自 2022 年 04 月 01 日至 2022 年 09 月 30 日，未发现上海市市场监督管理部门作出的行政处罚记录。”

**(二) 社会保险合规**

根据上海市社会保险事业管理中心于 2022 年 10 月 20 日出具的《单位

参加城镇社会保险基本情况》，截至 2022 年 9 月，上海华虹宏力正常缴费，截至 2020 年 9 月<sup>2</sup>，上海华虹宏力无欠款。

根据无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）人力资源和社会保障局于 2022 年 11 月 7 日出具的锡新人社证[2022]134 号《关于华虹半导体（无锡）有限公司企业守法情况的证明》，2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，华虹无锡在劳动和社会保障法律、法规方面未受到该机关行政处罚。

根据无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）人力资源和社会保障局于 2022 年 11 月 7 日出具的锡新人社证[2022]135 号《关于华宏置业（无锡）有限公司企业守法情况的证明》，2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，无锡置业在劳动和社会保障法律、法规方面未受到该机关行政处罚。

### （三） 住房公积金合规

根据上海市公积金管理中心于 2022 年 10 月 18 日出具的《上海市单位住房公积金缴存情况证明》，上海华虹宏力住房公积金账户处于正常缴存状态，未有该中心行政处罚记录。

根据无锡市住房公积金管理中心于 2022 年 10 月 26 日出具的《证明函》，自 2018 年 4 月 24 日至该证明出具之日，华虹无锡没有因违反公积金法规而受到该中心追缴、罚款或其他形式的行政处罚情形。

根据无锡市住房公积金管理中心于 2022 年 10 月 26 日出具的《证明函》，

---

<sup>2</sup> 上海市社会保险费征管职责自 2020 年 11 月划转至税务部门，涉及参保单位 2020 年 10 月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

自 2022 年 2 月 22 日至该证明出具之日，无锡置业没有因违反公积金法规而受到该中心追缴、罚款或其他形式的行政处罚情形。

#### (四) 消防合规

根据浦东新区消防救援支队外高桥大队于 2022 年 10 月 26 日出具的《证明》，上海华虹宏力于 2019 年 1 月 1 日至该证明出具之日期间，在该部门管辖范围和权限内，生产经营活动中遵守相关消防法律法规，未发生火灾，未因消防违法行为受到过该部门的行政处罚。

华虹无锡于 2022 年 10 月 27 日向无锡市新吴区消防救援大队出具《消防合规情况说明》，确认其自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，不存在因违反消防法律、法规、规章及规范性文件而受到行政处罚的情形；无锡市新吴区消防救援大队核实：“经查询消防监督系统，华虹半导体（无锡）有限公司自 2001 年 12 月 27 日至 2022 年 10 月 27 日，未查阅到行政处罚信息”。

无锡置业于 2022 年 10 月 27 日向无锡市新吴区消防救援大队出具《消防合规情况说明》，确认其自 2020 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，不存在因违反消防法律、法规、规章及规范性文件而受到行政处罚的情形；无锡市新吴区消防救援大队核实：“经查询消防监督系统，华宏置业（无锡）有限公司自 2001 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 27 日，未查阅到行政处罚信息”。

#### (五) 安监合规

上海华虹宏力于 2022 年 10 月 23 日向上海市浦东新区安全生产监察大

队出具《情况说明》，确认其自 2022 年 4 月 1 日以来生产经营不存在因违反安全生产法律、法规、规章及规范文件而受到行政处罚或不良记录的情形；上海市浦东新区安全生产监察大队已确认前述情况属实。

华虹无锡于 2022 年 10 月 24 日向无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）应急管理局出具《情况说明》，确认其自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，未因违反安全生产方面的法律、法规及规章的规定而受到新吴区应急管理局的行政处罚；无锡市新吴区应急管理局已确认前述情况属实。

无锡置业于 2022 年 10 月 24 日向无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）应急管理局出具《情况说明》，确认其自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，未因违反安全生产方面的法律、法规及规章的规定而受到新吴区应急管理局的行政处罚；无锡市新吴区应急管理局已确认前述情况属实。

#### （六） 土地合规

根据无锡市自然资源和规划局于 2022 年 11 月 3 日出具的《核查证明》，华虹无锡从 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，在该市范围内不存在因为违反土地管理法律法规而受到行政处罚的情形。

根据无锡市自然资源和规划局于 2022 年 11 月 3 日出具的《核查证明》，无锡置业从 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，在该市范围内不存在因为违反土地管理法律法规而受到行政处罚的情形。

#### （七） 住建合规

根据无锡市住房和城乡建设局于 2022 年 10 月 31 日出具的《证明》，华虹无锡自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日未发生因违反住建领域相关法律法规规章受该局行政处罚的情形。

根据无锡市住房和城乡建设局于 2022 年 10 月 31 日出具的《证明》，无锡置业自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日未发生因违反住建领域相关法律法规规章受该局行政处罚的情形。

#### (八) 环保合规

根据上海市浦东新区城市管理行政执法局生态环境执法支队于 2022 年 11 月 10 日出具的《关于上海华虹宏力半导体制造有限公司环保行政管理情况的证明》，上海华虹宏力自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，在生产经营活动中能够遵守环境保护法律、法规或规章的规定，未发生环境污染事故，未涉及环境污染投诉，未有因违反环保相关法律、法规或规章的规定而受到环保部门行政处罚。

华虹无锡于 2022 年 10 月 24 日出具《情况说明》，确认其自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，未因违反生态环境方面的法律、法规及规章的规定而受到新吴区生态环境主管部门的行政处罚；无锡市新吴生态环境局已确认前述情况属实。

无锡置业于 2022 年 10 月 24 日出具《情况说明》，确认其自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，未因违反生态环境方面的法律、法规及规章的规定而受到新吴区生态环境主管部门的行政处罚；无锡市新吴生态环境局已确认前述情况属实。

(九) 商委合规

根据无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）商务局于 2022 年 11 月 3 日出具的《证明》，“我局管辖的华虹半导体（无锡）有限公司自 2019 年 1 月 1 日以来遵守国家及地方有关商务部门方面的法律法规，公司的历次股权变动已履行必要的商务部门审批、备案或报送手续，不存在虚假、误导性报告或重大遗漏。经查询，华虹半导体（无锡）有限公司不存在违反商务部门相关法律法规的情形，不存在违反商务部门相关法律法规受到处罚的记录。”

(十) 海关合规

根据中华人民共和国南京海关于 2022 年 11 月 11 日出具的《企业信用状况证明》，在 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，该单位未发现华虹无锡有涉及海关进出口监管领域的违法记录。

(十一) 发行人及其境外控股子公司的合规情况

根据《香港法律审阅报告》，于 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日期间，没有针对发行人及力鸿科技的由香港监管机构提起的任何构成重大违规处罚（即处罚港币金额超过等值人民币 10,000 元）的诉讼记录。

根据 Conyers Dill & Pearman 律师事务所于 2022 年 12 月 6 日出具的法律意见书，在开曼群岛大法院不存在针对 Grace Cayman 未了结的诉讼案件。

根据长岛·大野·常松律师事务所于 2022 年 11 月 30 日出具的法律意见书，Grace Japan 自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日为止未受到过行政处罚。

根据美国大易律师事务所于 2022 年 12 月 9 日出具的法律意见书，截至 2022 年 9 月 30 日，Grace USA 没有受过任何行政处罚的情况。

## (十二) 发行人境外上市期间的合规情况

根据《香港法律审阅报告》，HSF 于 2022 年 12 月 7 日进行了诉讼搜索，并于《香港法律审阅报告》出具之日对香港联交所和香港证监会网站进行了搜索，其未发现自发行人香港上市以来，香港联交所或香港证监会对发行人进行的任何处罚。

## 十一. 发行人募集资金的运用

经本所律师核查，根据发行人提供的文件资料及发行人确认，就“华虹制造（无锡）项目”，无锡华虹制造已于 2023 年 1 月取得锡新行审投备[2023]9 号《江苏省投资项目备案证》。无锡市行政审批局于 2023 年 1 月 9 日出具锡行审环许[2023]7005 号《关于华虹半导体制造（无锡）有限公司华虹制造（无锡）项目环境影响报告表的批复》，从生态环境保护角度同意该项目建设。

## 十二. 诉讼、仲裁或行政处罚

(一) 经本所律师核查，并经发行人确认，于 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，发行人境内控股子公司无新增处罚金额超过 10,000 元的行政处罚。

(二) 经本所律师核查，同时根据《审计报告》、发行人的确认，发行人的境内控股子公司无未了结的或者可预见的对发行人资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁案件。

(三) 据发行人及其境外控股子公司所在地的律师出具的法律意见或法律审阅报告，发行人及其境外控股子公司的诉讼、仲裁、行政处罚情况如下：

1. 发行人

根据《香港法律审阅报告》，于 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日期间，没有针对发行人的由香港监管机构提起的任何构成重大违规处罚（即处罚港币金额超过等值人民币 10,000 元）的诉讼记录；截至《香港法律审阅报告》出具之日，不存在涉及发行人的仲裁。

2. 力鸿科技

根据《香港法律审阅报告》，于 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 7 日期间，没有针对力鸿科技的由香港监管机构提起的任何构成重大违规处罚的诉讼记录；截至《香港法律审阅报告》出具之日，不存在涉及力鸿科技的仲裁。

3. Grace Cayman

根据 Conyers Dill & Pearman 律师事务所于 2022 年 12 月 6 日出具的法律意见书，在开曼群岛大法院不存在针对 Grace Cayman 未了结的诉讼案件。

#### 4. Grace Japan

根据长岛·大野·常松律师事务所于 2022 年 11 月 30 日出具的法律意见书，Grace Japan 自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日为止未受到过行政处罚，未涉及诉讼、仲裁及其他纠纷，且截至 2022 年 9 月 30 日亦不存在重大的潜在纠纷（包括正在交涉中或收到警告信的情形）。

#### 5. Grace USA

根据美国大易律师事务所于 2022 年 12 月 9 日出具的法律意见书，截至 2022 年 9 月 30 日，Grace USA 没有受过任何行政处罚的情况；自 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日，Grace USA 在美国联邦法院、加州州法院和仲裁机构没有诉讼和仲裁案件。

- (四) 经本所律师核查，并根据本所律师与华虹国际、联和国际、Wisdom Power 及鑫芯香港等单独或合计持有发行人 5%以上股份的股东进行的访谈，该等发行人的股东无未了结的或者可预见的对其自身资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
- (五) 经本所律师核查，并根据发行人董事会主席、总裁出具的保证，发行人董事会主席、总裁无未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

以上补充法律意见系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文件的理解而出具，仅供华虹半导体有限公司向上海证券交易所申报本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它目的。

本补充法律意见书正本一式四份。



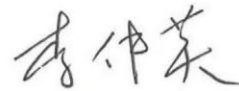
事务所负责人

韩 炯 律师



经办律师

李仲英 律师



张征轶 律师



郭 珣 律师



夏 青 律师


























二〇二三年一月十九日

附件一：商标

表 1：境内主要商标

编号	商标图形	注册人	核定使用商品	注册号	专用权期限
1.		上海华虹宏力	第 7 类	第 35885741 号	2019 年 12 月 21 日至 2029 年 12 月 20 日
2.		上海华虹宏力	第 36 类	第 53583076 号	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日
3.		上海华虹宏力	第 42 类	第 53583149 号	2021 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日
4.		上海华虹宏力	第 9 类	第 53587876 号	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日
5.		上海华虹宏力	第 9 类	第 53589527 号	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日
6.		上海华虹宏力	第 40 类	第 53589853 号	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日
7.		上海华虹宏力	第 36 类	第 53590098 号	2021 年 9 月 14 日至 2031 年 9 月 13 日
8.		上海华虹宏力	第 40 类	第 53594306 号	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日

9.		上海华虹宏力	第 42 类	第 53594329 号	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日
10.		上海华虹宏力	第 42 类	第 53594341 号	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日
11.		上海华虹宏力	第 40 类	第 53596218 号	2021 年 9 月 7 日至 2031 年 9 月 6 日
12.		上海华虹宏力	第 35 类	第 53598386 号	2021 年 11 月 21 日至 2031 年 11 月 20 日
13.		上海华虹宏力	第 36 类	第 53599308 号	2021 年 9 月 14 日至 2031 年 9 月 13 日
14.		上海华虹宏力	第 9 类	第 53602017 号	2021 年 8 月 28 日至 2031 年 8 月 27 日
15.		上海华虹宏力	第 35 类	第 53603559 号	2021 年 11 月 28 日至 2031 年 11 月 27 日
16.		上海华虹宏力	第 35 类	第 53603580 号	2021 年 11 月 28 日至 2031 年 11 月 27 日
17.		上海华虹宏力	第 40 类	第 22479260 号	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日
18.		上海华虹宏力	第 40 类	第 22479259 号	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日
19.		上海华虹宏力	第 40 类	第 22479258 号	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日

20.		上海华虹宏力	第 9 类	第 22454634 号	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日
21.		上海华虹宏力	第 42 类	第 22454368 号	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日
22.		上海华虹宏力	第 42 类	第 22454336 号	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日
23.		上海华虹宏力	第 9 类	第 22454095 号	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日
24.		上海华虹宏力	第 42 类	第 22453959 号	2018 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日
25.		上海华虹宏力	第 9 类	第 22453857 号	2018 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日
26.		上海华虹宏力	第 42 类	第 14573670 号	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
27.		上海华虹宏力	第 9 类	第 14573669 号	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
28.		上海华虹宏力	第 42 类	第 14573668 号	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
29.		上海华虹宏力	第 9 类	第 14573667 号	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
30.		上海华虹宏力	第 42 类	第 14573666 号	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
31.		上海华虹宏力	第 9 类	第 14573665 号	2016 年 2 月 14 日至 2026 年 2 月 13 日

32.	<b>HG华虹宏力</b>	上海华虹宏力	第 42 类	第 14573664 号	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
33.	<b>HG华虹宏力</b>	上海华虹宏力	第 9 类	第 14573663 号	2015 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日
34.	NORD-Flash	上海华虹宏力	第 16 类	第 14501665 号	2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日
35.	NORD-Flash	上海华虹宏力	第 35 类	第 14501664 号	2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日
36.	NORD-Flash	上海华虹宏力	第 37 类	第 14501663 号	2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日
37.	NORD-Flash	上海华虹宏力	第 40 类	第 14501662 号	2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日
38.	NORD-Flash	上海华虹宏力	第 42 类	第 14501660 号	2015 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 13 日
39.	NORD-Flash	上海华虹宏力	第 9 类	第 14241227 号	2018 年 4 月 7 日至 2028 年 4 月 6 日

表 2：境外主要商标

编号	商标图形	注册人	核定使用商品类别	注册号	有效期限	注册国家/地区
1.		发行人	第 9 类、第 35 类、第 36 类、 第 40 类、第 42 类	305556826	2021 年 3 月 9 日至 2031 年 3 月 8 日	中国香港
2.		发行人	第 9 类、第 35 类、第 36 类、 第 40 类、第 42 类	305556817	2021 年 3 月 9 日至 2031 年 3 月 8 日	中国香港
3.		发行人	第 9 类、第 35 类、第 36 类、 第 40 类、第 42 类	305556808	2021 年 3 月 9 日至 2031 年 3 月 8 日	中国香港
4.		发行人	第 9 类、第 40 类、第 42 类	303085920	2014 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日	中国香港
5.		发行人	第 9 类、第 40 类、第 42 类	303085911	2014 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日	中国香港
6.		发行人	第 9 类、第 40 类、第 42 类	303085894	2014 年 7 月 31 日至 2024 年 7 月 30 日	中国香港

7.	<b>华虹宏力</b>	发行人	第 9 类	303013532	2014年5月29日至2024年5月28日	中国香港
8.	<b>华虹宏力</b>	发行人	第 40 类	303013604	2014年5月29日至2024年5月28日	中国香港
9.	<b>华虹宏力</b>	发行人	第 42 类	303013596	2014年5月29日至2024年5月28日	中国香港

附件二：专利

表 1：境内主要专利

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利期限	专利权人
1.	发明	具有双超浅隔离结构的绝缘体上硅晶体管及其制作方法	ZL200910197884.3	2009年10月29日起20年	上海华虹宏力
2.	发明	一种垂直双扩散MOS晶体管的制备方法	ZL200910198981.4	2009年11月18日起20年	上海华虹宏力
3.	发明	VDMOS晶体管测试结构	ZL201010133570.X	2010年3月26日起20年	上海华虹宏力
4.	发明	场效应晶体管制造方法	ZL200910195617.2	2009年9月7日起20年	上海华虹宏力
5.	发明	SONOS的存储单元及其操作方法	ZL200910201932.1	2009年12月15日起20年	上海华虹宏力
6.	发明	一种浮栅为SONOS结构的闪存	ZL200910196452.0	2009年9月25日起20年	上海华虹宏力
7.	发明	SONOS闪存器件采用氧化铝作隧穿电介质膜的制作方法	ZL200910201852.6	2009年11月24日起20年	上海华虹宏力
8.	发明	LDMOS及其制造方法	ZL200910201753.8	2009年11月5日起20年	上海华虹宏力
9.	发明	OTP器件的单元结构及其制造方法	ZL200910201782.4	2009年11月9日起20年	上海华虹宏力

10.	发明	功率 MOS 晶体管内集成肖特基二极管的器件及制造方法	ZL200910201907.3	2009 年 12 月 8 日起 20 年	上海华虹宏力
11.	发明	超结 VDMOS 器件及其制造方法	ZL201010108871.7	2010 年 2 月 11 日起 20 年	上海华虹宏力
12.	发明	一种存储器的编程方法	ZL201010121436.8	2010 年 3 月 10 日起 20 年	上海华虹宏力
13.	发明	超级结器件的终端保护结构及其制造方法	ZL201010141072.X	2010 年 4 月 6 日起 20 年	上海华虹宏力
14.	发明	一种存储器阵列	ZL200910197806.3	2009 年 10 月 28 日起 20 年	上海华虹宏力
15.	发明	小线宽沟槽 DMOS 的实现方法	ZL201010027229.6	2010 年 1 月 6 日起 20 年	上海华虹宏力
16.	发明	闪存芯片的测试方法	ZL200910198561.6	2009 年 11 月 10 日起 20 年	上海华虹宏力
17.	发明	SONOS 器件及其制造方法	ZL201010027280.7	2010 年 1 月 18 日起 20 年	上海华虹宏力
18.	发明	检测晶圆的方法	ZL201010027297.2	2010 年 1 月 18 日起 20 年	上海华虹宏力
19.	发明	外延片形成方法及使用该形成的外延片	ZL200910196119.X	2009 年 9 月 22 日起 20 年	上海华虹宏力
20.	发明	EEPROM 器件的制作方法	ZL201010100501.9	2010 年 1 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
21.	发明	LDMOS 及其制造方法	ZL200910201890.1	2009 年 12 月 3 日起 20 年	上海华虹宏力
22.	发明	EEPROM 器件	ZL201010027349.6	2010 年 1 月 21 日起 20 年	上海华虹宏力
23.	发明	沟槽型 MOSFET 结构及其制备方法	ZL200910201943.X	2009 年 12 月 15 日起 20 年	上海华虹宏力

24.	发明	SONOS 及其制造方法	ZL200910201933.6	2009 年 12 月 15 日起 20 年	上海华虹宏力
25.	发明	SONOS 器件	ZL201010027326.5	2010 年 1 月 20 日起 20 年	上海华虹宏力
26.	发明	用于 NVM 测试中不同品种参数之间坐标的对应方法	ZL201010027218.8	2010 年 1 月 5 日起 20 年	上海华虹宏力
27.	发明	一种存储单元读取装置及读取方法	ZL200910198986.7	2009 年 11 月 18 日起 20 年	上海华虹宏力
28.	发明	一种 ESD 保护装置	ZL200910195956.0	2009 年 9 月 17 日起 20 年	上海华虹宏力
29.	发明	BCD 工艺中的自对准高压 CMOS 制造工艺方法	ZL200910201967.5	2009 年 12 月 18 日起 20 年	上海华虹宏力
30.	发明	EEPROM 器件的制作方法	ZL200910202026.3	2009 年 12 月 24 日起 20 年	上海华虹宏力
31.	发明	超级结 LDMOS 器件及制造方法	ZL201010265250.X	2010 年 8 月 26 日起 20 年	上海华虹宏力
32.	发明	超级结半导体器件的制作方法	ZL201010265294.2	2010 年 8 月 26 日起 20 年	上海华虹宏力
33.	发明	SONOS 工艺中 5 伏 PMOS 器件及制造方法	ZL201010290313.7	2010 年 9 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
34.	发明	IGBT 器件的制备方法	ZL201110183356.X	2011 年 7 月 1 日起 20 年	上海华虹宏力
35.	发明	结合超级结穿透型沟槽 IGBT 器件制造方法	ZL201110383157.3	2011 年 11 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
36.	发明	超级结器件的终端保护结构及制造方法	ZL201110186069.4	2011 年 7 月 5 日起 20 年	上海华虹宏力
37.	发明	MTP 器件的单元结构及其操作方法	ZL200910201913.9	2009 年 12 月 8 日起 20 年	上海华虹宏力

38.	发明	在 CMOS 工艺中集成光电二极管的方法	ZL200910201940.6	2009 年 12 月 15 日起 20 年	上海华虹宏力
39.	发明	在 SONOS 非挥发性存储器工艺中嵌入高压器件的方法	ZL201010503967.3	2010 年 10 月 12 日起 20 年	上海华虹宏力
40.	发明	隔离型 LDMOS 的制造方法	ZL201110009456.0	2011 年 1 月 17 日起 20 年	上海华虹宏力
41.	发明	一种静电放电保护装置	ZL200910195567.8	2009 年 9 月 7 日起 20 年	上海华虹宏力
42.	发明	存储器以及制造存储器的方法	ZL201010241550.4	2010 年 7 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
43.	发明	超级结半导体器件及其制作方法	ZL201010553535.3	2010 年 11 月 22 日起 20 年	上海华虹宏力
44.	发明	用于功率金属氧化物晶体管芯片的缺陷失效定位方法	ZL201010547545.6	2010 年 11 月 17 日起 20 年	上海华虹宏力
45.	发明	超级结半导体器件的终端保护结构及制作方法	ZL201010290451.5	2010 年 9 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
46.	发明	DMOS 器件及制造工艺	ZL201010227093.3	2010 年 7 月 15 日起 20 年	上海华虹宏力
47.	发明	RFCMOS 射频相关性噪声的模型	ZL201110352944.1	2011 年 11 月 9 日起 20 年	上海华虹宏力
48.	发明	隔离型功率晶体管的制造方法	ZL201110242328.0	2011 年 8 月 23 日起 20 年	上海华虹宏力
49.	发明	提高 SOA 能力的功率器件结构及其制造方法	ZL201110310516.2	2011 年 10 月 13 日起 20 年	上海华虹宏力

50.	发明	深亚微米半导体器件的工艺集成方法	ZL201110283488.X	2011年9月22日起20年	上海华虹宏力
51.	发明	基于 NMOS 的 OTP 器件的制造方法	ZL201110076611.0	2011年3月29日起20年	上海华虹宏力
52.	发明	超级结器件及其制作方法	ZL201210325859.0	2012年9月5日起20年	上海华虹宏力
53.	发明	分栅闪存单元及其形成方法	ZL201110335656.5	2011年10月28日起20年	上海华虹宏力
54.	发明	CDM ESD 保护电路	ZL201010111101.8	2010年2月10日起20年	上海华虹宏力
55.	发明	CMOS 图像传感器	ZL201010518422.X	2010年10月25日起20年	上海华虹宏力
56.	发明	SONOS 器件	ZL201110225676.7	2011年8月8日起20年	上海华虹宏力
57.	发明	BiCMOS 工艺中的垂直寄生型 PNP 器件及其 制造方法	ZL201110412637.8	2011年12月12日起20年	上海华虹宏力
58.	发明	探针电阻的检测方法	ZL201010198398.6	2010年6月11日起20年	上海华虹宏力
59.	发明	提高沟槽栅顶角栅氧可靠性的方法	ZL201010518386.7	2010年10月25日起20年	上海华虹宏力
60.	发明	分栅式存储器制造方法以及分栅式存储器	ZL201110103156.9	2011年4月25日起20年	上海华虹宏力
61.	发明	超级结结构、超级结 MOS 晶体管及其制造 方法	ZL201110295521.0	2011年9月30日起20年	上海华虹宏力
62.	发明	超级结制备工艺方法	ZL201210163767.7	2012年5月23日起20年	上海华虹宏力
63.	发明	防止晶圆边缘器件良率低的方法	ZL201110328154.X	2011年10月25日起20年	上海华虹宏力

64.	发明	RC 振荡器及其实现方法	ZL201110009105.X	2011 年 1 月 17 日起 20 年	上海华虹宏力
65.	发明	一种 5V CMOS 器件结构及其制造方法	ZL201110348591.8	2011 年 11 月 7 日起 20 年	上海华虹宏力
66.	发明	晶圆级测试结构和测试方法	ZL201110440591.0	2011 年 12 月 23 日起 20 年	上海华虹宏力
67.	发明	逆导型 IGBT 半导体器件及制造方法	ZL201210064071.9	2012 年 3 月 12 日起 20 年	上海华虹宏力
68.	发明	非挥发性存储器的数据自动比较测试电路	ZL201210073811.5	2012 年 3 月 20 日起 20 年	上海华虹宏力
69.	发明	IGBT 器件及其制作工艺方法	ZL201210262423.1	2012 年 7 月 27 日起 20 年	上海华虹宏力
70.	发明	闪存及其编程方法	ZL201110061751.0	2011 年 3 月 15 日起 20 年	上海华虹宏力
71.	发明	自对准多晶硅化物工艺方法及半导体器件	ZL201110103325.9	2011 年 4 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
72.	发明	接触孔的形成方法	ZL201110436358.5	2011 年 12 月 22 日起 20 年	上海华虹宏力
73.	发明	静电保护结构	ZL201110103518.4	2011 年 4 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
74.	发明	一种 SRAM 的旁路结构	ZL201110385627.X	2011 年 11 月 28 日起 20 年	上海华虹宏力
75.	发明	探针检测装置及其方法	ZL201010187373.6	2010 年 5 月 28 日起 20 年	上海华虹宏力
76.	发明	CMOS 图像传感器及其形成方法	ZL201110213090.9	2011 年 7 月 28 日起 20 年	上海华虹宏力
77.	发明	MEMS 器件的制造方法	ZL201210085879.5	2012 年 3 月 27 日起 20 年	上海华虹宏力
78.	发明	无缺陷选择性外延的生长方法	ZL201110407665.0	2011 年 12 月 9 日起 20 年	上海华虹宏力
79.	发明	以具有外延层的衬底制造场终止型 IGBT 器件的方法	ZL201110394424.7	2011 年 12 月 2 日起 20 年	上海华虹宏力

80.	发明	非挥发性存储器的擦除方法	ZL201210082555.6	2012年3月26日起20年	上海华虹宏力
81.	发明	CMOS 工艺中集成 SONOS 器件和 LDMOS 器件的方法	ZL201210306805.X	2012年8月24日起20年	上海华虹宏力
82.	发明	一种改善硅片翘曲度的深沟槽制造方法	ZL201210378133.3	2012年9月29日起20年	上海华虹宏力
83.	发明	场截止型绝缘栅双极晶体管及其制造方法	ZL201210439400.3	2012年11月6日起20年	上海华虹宏力
84.	发明	ONO 结构及其制作方法、存储器及其制作方法	ZL201110436603.2	2011年12月22日起20年	上海华虹宏力
85.	发明	一种 SOI 体接触 MOS 晶体管及其形成方法	ZL201110135857.0	2011年5月24日起20年	上海华虹宏力
86.	发明	光刻对准精度检测方法	ZL201110436380.X	2011年12月22日起20年	上海华虹宏力
87.	发明	微机电系统压力传感器的制作方法	ZL201210061933.2	2012年3月9日起20年	上海华虹宏力
88.	发明	光刻对准参数预测方法以及光刻方法	ZL201210142948.1	2012年5月9日起20年	上海华虹宏力
89.	发明	SRAM 存储器及其形成方法	ZL201110185892.3	2011年7月4日起20年	上海华虹宏力
90.	发明	锁相环电路	ZL201210133450.9	2012年4月28日起20年	上海华虹宏力
91.	发明	集成过流保护的 MOSFET 及制造方法	ZL201210248220.7	2012年7月18日起20年	上海华虹宏力
92.	发明	自对准接触孔的小尺寸 MOSFET 结构及制作方法	ZL201210239999.6	2012年7月11日起20年	上海华虹宏力

93.	发明	TVS 器件及制造方法	ZL201210276113.5	2012 年 8 月 3 日起 20 年	上海华虹宏力
94.	发明	版图的 DFM 方法	ZL201210552740.7	2012 年 12 月 18 日起 20 年	上海华虹宏力
95.	发明	精确控制晶圆减薄厚度的方法	ZL201210468683.4	2012 年 11 月 19 日起 20 年	上海华虹宏力
96.	发明	形成于 SOI 衬底上的静态随机存取存储器	ZL201110159604.7	2011 年 6 月 14 日起 20 年	上海华虹宏力
97.	发明	一种晶圆盒清洗装置及其清洗方法	ZL201210142935.4	2012 年 5 月 9 日起 20 年	上海华虹宏力
98.	发明	MIM 电容器	ZL201110176520.4	2011 年 6 月 28 日起 20 年	上海华虹宏力
99.	发明	一次可编程存储器以及制造方法	ZL201110436602.8	2011 年 12 月 22 日起 20 年	上海华虹宏力
100.	发明	一种深沟槽的硅外延填充方法	ZL201110332561.8	2011 年 10 月 28 日起 20 年	上海华虹宏力
101.	发明	平面型超级结制备方法	ZL201110391342.7	2011 年 11 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
102.	发明	结合快复管的 IGBT 器件制造方法	ZL201110383511.2	2011 年 11 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
103.	发明	MOM 电容	ZL201210488405.5	2012 年 11 月 26 日起 20 年	上海华虹宏力
104.	发明	硅背面的离子注入方法	ZL201210550558.8	2012 年 12 月 18 日起 20 年	上海华虹宏力
105.	发明	晶圆弯曲度测算方法	ZL201110296332.5	2011 年 9 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
106.	发明	集成 MEMS 器件及其制作方法	ZL201410428773.X	2014 年 8 月 27 日起 20 年	上海华虹宏力
107.	发明	晶圆自动测试系统	ZL201410083969.X	2014 年 3 月 7 日起 20 年	上海华虹宏力
108.	发明	半导体晶圆的刷洗装置和刷洗方法	ZL201410352938.X	2014 年 7 月 23 日起 20 年	上海华虹宏力

109.	发明	图像传感器的像素单元及其形成方法	ZL201410084191.4	2014年3月7日起20年	上海华虹宏力
110.	发明	利用红外光谱检测键合晶圆之间的气密性的方法	ZL201410010304.6	2014年1月9日起20年	上海华虹宏力
111.	发明	闪存的数据修复方法	ZL201410083702.0	2014年3月7日起20年	上海华虹宏力
112.	发明	SOI 结构及其制作方法	ZL201410006921.9	2014年1月7日起20年	上海华虹宏力
113.	发明	闪存的形成方法	ZL201410078727.1	2014年3月5日起20年	上海华虹宏力
114.	发明	EEPROM 结构、存储阵列及其编程、擦除和读取方法	ZL201410083736.X	2014年3月7日起20年	上海华虹宏力
115.	发明	存储器单元阵列及其形成方法和驱动方法	ZL201410353747.5	2014年7月23日起20年	上海华虹宏力
116.	发明	比特失效检测方法	ZL201410098678.8	2014年3月17日起20年	上海华虹宏力
117.	发明	沟槽栅半导体器件的制造方法	ZL201410663729.7	2014年11月19日起20年	上海华虹宏力
118.	发明	闪存存储单元及其形成方法	ZL201410425321.6	2014年8月26日起20年	上海华虹宏力
119.	发明	沟槽功率器件及其制作方法	ZL201410098298.4	2014年3月17日起20年	上海华虹宏力
120.	发明	负压电荷泵反馈电路	ZL201410342481.4	2014年7月18日起20年	上海华虹宏力
121.	发明	RC 振荡器	ZL201410667550.9	2014年11月20日起20年	上海华虹宏力
122.	发明	颗粒物缺陷的监控方法	ZL201510309136.5	2015年6月7日起20年	上海华虹宏力

123.	发明	化学机械研磨方法	ZL201510491035.4	2015年8月11日起20年	上海华虹宏力
124.	发明	太鼓减薄工艺的去环方法	ZL201410363960.4	2014年7月29日起20年	上海华虹宏力
125.	发明	IGBT器件的栅极结构	ZL201410490036.2	2014年9月23日起20年	上海华虹宏力
126.	发明	包含中压SGT结构的MOSFET及其制作方法	ZL201410842303.8	2014年12月29日起20年	上海华虹宏力
127.	发明	射频LDMOS器件的制造方法	ZL201410837468.6	2014年12月24日起20年	上海华虹宏力
128.	发明	改善FLASH可靠性的方法	ZL201410520493.1	2014年9月30日起20年	上海华虹宏力
129.	发明	非易失性存储器系统	ZL201410084253.1	2014年3月7日起20年	上海华虹宏力
130.	发明	半导体器件及其形成方法	ZL201410682247.6	2014年11月24日起20年	上海华虹宏力
131.	发明	改善IGBT背面金属化的工艺方法	ZL201510050448.9	2015年1月30日起20年	上海华虹宏力
132.	发明	电压产生电路和存储器	ZL201410855162.3	2014年12月30日起20年	上海华虹宏力
133.	发明	低噪声放大器	ZL201410857355.2	2014年12月30日起20年	上海华虹宏力
134.	发明	IGBT背面金属化退火的工艺方法	ZL201510270323.7	2015年5月25日起20年	上海华虹宏力
135.	发明	闪存产品自对准光刻工艺测试方法	ZL201410844354.4	2014年12月26日起20年	上海华虹宏力
136.	发明	OSC频率自动校准电路及自动校准方法	ZL201410527935.5	2014年10月9日起20年	上海华虹宏力
137.	发明	ADC的自适应滤波数字校准电路和方法	ZL201510067902.1	2015年2月10日起20年	上海华虹宏力
138.	发明	嵌入式闪存的结构及嵌入式闪存的制造方法	ZL201410466050.9	2014年9月12日起20年	上海华虹宏力

139.	发明	OTP 器件的结构和制作方法	ZL201410842288.7	2014 年 12 月 29 日起 20 年	上海华虹宏力
140.	发明	提高电感器 Q 值的方法以及电感器	ZL201410465851.3	2014 年 9 月 12 日起 20 年	上海华虹宏力
141.	发明	一种光刻版图 OPC 方法	ZL201510309042.8	2015 年 6 月 7 日起 20 年	上海华虹宏力
142.	发明	IGBT 负阻问题的改善方法	ZL201410307058.0	2014 年 6 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
143.	发明	OPC 前期对版图的处理方法	ZL201410466059.X	2014 年 9 月 12 日起 20 年	上海华虹宏力
144.	发明	MEMS 器件及晶圆级密封性的测量方法	ZL201310386021.7	2013 年 8 月 29 日起 20 年	上海华虹宏力
145.	发明	一种降低 SONOS 存储器串联电阻的方法	ZL201510505846.5	2015 年 8 月 18 日起 20 年	上海华虹宏力
146.	发明	太鼓减薄工艺的环切工艺方法	ZL201510977067.5	2015 年 12 月 22 日起 20 年	上海华虹宏力
147.	发明	屏蔽栅-深沟槽 MOSFET 的屏蔽栅氧化层及其形成方法	ZL201610064114.1	2016 年 1 月 29 日起 20 年	上海华虹宏力
148.	发明	晶圆测试方法	ZL201610192125.8	2016 年 3 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
149.	发明	高压 BCD 器件	ZL201710004113.2	2017 年 1 月 4 日起 20 年	上海华虹宏力
150.	发明	EEPROM 存储器及其操作方法	ZL201710004047.9	2017 年 1 月 4 日起 20 年	上海华虹宏力
151.	发明	超级结的沟槽填充方法	ZL201710519255.2	2017 年 6 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
152.	发明	1.5T 耗尽型 SONOS 非挥发性存储器及其制造方法	ZL201710768034.9	2017 年 8 月 31 日起 20 年	上海华虹宏力

153.	发明	划片槽测试结构及测试方法	ZL201710600058.3	2017年7月21日起20年	上海华虹宏力
154.	发明	MTP 器件及其制造方法	ZL201710960907.6	2017年10月17日起20年	上海华虹宏力
155.	发明	沟槽外延的填充方法	ZL201711075799.0	2017年11月6日起20年	上海华虹宏力
156.	发明	CMP 研磨方法	ZL201810112566.1	2018年2月5日起20年	上海华虹宏力
157.	发明	ONO 膜层的制造方法	ZL201811053724.7	2018年9月11日起20年	上海华虹宏力
158.	发明	BCD 器件深沟槽隔离方法	ZL201910061588.4	2019年1月23日起20年	上海华虹宏力
159.	发明	逆导型超结 IGBT 器件及其制造方法	ZL201910056493.3	2019年1月22日起20年	上海华虹宏力
160.	发明	LDO 电路	ZL201510647956.5	2015年10月9日起20年	上海华虹宏力
161.	发明	静电保护电路	ZL201510706068.6	2015年10月27日起20年	上海华虹宏力
162.	发明	SRAM 的 IP 地址建立时间的测量电路和方法	ZL201610024754.X	2016年1月15日起20年	上海华虹宏力
163.	发明	屏蔽栅沟槽功率 MOSTET 器件及其制造方法	ZL201710903865.2	2017年9月29日起20年	上海华虹宏力
164.	发明	IGBT 器件	ZL201810120416.5	2018年2月7日起20年	上海华虹宏力
165.	发明	超级结器件的工艺方法	ZL201810025084.2	2018年1月11日起20年	上海华虹宏力
166.	发明	沟槽型超级结及其制造方法	ZL201711234826.4	2017年11月30日起20年	上海华虹宏力
167.	发明	沟槽栅超结器件及其制造方法	ZL201810695756.0	2018年6月29日起20年	上海华虹宏力
168.	发明	IGBT 复合元胞结构及其构成的可编程 IGBT	ZL201910034227.0	2019年1月15日起20年	上海华虹宏力

169.	发明	用于 OPC 验证的验证图形的量化分析方法	ZL201910098268.6	2019 年 1 月 31 日起 20 年	上海华虹宏力
170.	发明	SRAM 存储单元	ZL201910211428.3	2019 年 3 月 20 日起 20 年	上海华虹宏力
171.	发明	清洗单元的清洗效率侦测方法	ZL201510971819.7	2015 年 12 月 22 日起 20 年	上海华虹宏力
172.	发明	半导体器件的形成方法	ZL201610067374.4	2016 年 1 月 29 日起 20 年	上海华虹宏力
173.	发明	二极管及其形成方法	ZL201610130584.3	2016 年 3 月 8 日起 20 年	上海华虹宏力
174.	发明	射频开关器件及其形成方法	ZL201610160489.8	2016 年 3 月 21 日起 20 年	上海华虹宏力
175.	发明	存储器及其干扰检测和消除的方法、装置	ZL201610177344.9	2016 年 3 月 25 日起 20 年	上海华虹宏力
176.	发明	低噪声放大器及射频终端	ZL201610301970.4	2016 年 5 月 9 日起 20 年	上海华虹宏力
177.	发明	利用多晶锗硅通孔形成 MEMS 晶圆电连接的方法	ZL201610596473.1	2016 年 7 月 27 日起 20 年	上海华虹宏力
178.	发明	改善栅极侧墙形貌的方法及半导体器件制造方法	ZL201610307769.7	2016 年 5 月 11 日起 20 年	上海华虹宏力
179.	发明	光刻胶去除方法及半导体器件制作方法	ZL201610307221.2	2016 年 5 月 11 日起 20 年	上海华虹宏力
180.	发明	闪存存储器及其形成方法	ZL201610596401.7	2016 年 7 月 27 日起 20 年	上海华虹宏力
181.	发明	闪存器件及其制造方法	ZL201610307728.8	2016 年 5 月 11 日起 20 年	上海华虹宏力
182.	发明	闪存器件制造方法	ZL201610596395.5	2016 年 7 月 27 日起 20 年	上海华虹宏力

183.	发明	分栅式闪存器件制造方法	ZL201610596382.8	2016年7月27日起20年	上海华虹宏力
184.	发明	半导体结构的形成方法	ZL201610599893.5	2016年7月27日起20年	上海华虹宏力
185.	发明	SOI 射频开关结构及集成电路	ZL201610596479.9	2016年7月27日起20年	上海华虹宏力
186.	发明	存储器系统、存储器阵列及其读和编程操作方法	ZL201710340957.4	2017年5月15日起20年	上海华虹宏力
187.	发明	CMOS 图像传感器及其制作方法	ZL201610884650.6	2016年10月10日起20年	上海华虹宏力
188.	发明	一种用于光刻版图 OPC 的采样方法及装置	ZL201610843995.7	2016年9月22日起20年	上海华虹宏力
189.	发明	嵌入式闪存的多晶硅干蚀刻工艺的选择方法	ZL201610885898.4	2016年10月10日起20年	上海华虹宏力
190.	发明	防止闪存单元控制栅极空洞的工艺制造方法	ZL201710079389.7	2017年2月14日起20年	上海华虹宏力
191.	发明	半导体器件的刻蚀方法	ZL201710079125.1	2017年2月14日起20年	上海华虹宏力
192.	发明	MOS 器件的仿真方法	ZL201710011836.5	2017年1月6日起20年	上海华虹宏力
193.	发明	芯片的钝化层及形成芯片的钝化层的方法	ZL201710551912.1	2017年7月7日起20年	上海华虹宏力
194.	发明	晶圆的平坦化方法	ZL201710552553.1	2017年7月7日起20年	上海华虹宏力
195.	发明	闪存单元、闪存单元的编程方法及闪存单元的擦除方法	ZL201710553098.7	2017年7月7日起20年	上海华虹宏力

196.	发明	一种自对准曝光半导体结构的制作方法	ZL201711334555.X	2017年12月13日起20年	上海华虹宏力
197.	发明	一种EEPROM及其擦除、编程和读方法	ZL201711120987.0	2017年11月14日起20年	上海华虹宏力
198.	发明	一种检测掩膜版与掩膜台接触面污染的方法	ZL201711127716.8	2017年11月15日起20年	上海华虹宏力
199.	发明	探针卡电路及其测试方法	ZL201711132890.1	2017年11月15日起20年	上海华虹宏力
200.	发明	晶圆键合方法	ZL201810005643.3	2018年1月3日起20年	上海华虹宏力
201.	发明	晶圆的测试方法	ZL201710884250.X	2017年9月26日起20年	上海华虹宏力
202.	发明	NORD存储阵列及其制造方法、存储器	ZL201910436286.0	2019年5月23日起20年	上海华虹宏力
203.	发明	一种擦除增强型NORD闪存及其制备方法	ZL201910057318.6	2019年1月22日起20年	上海华虹宏力
204.	发明	一种嵌入式闪存结构的形成方法	ZL201910059072.6	2019年1月22日起20年	上海华虹宏力
205.	发明	超级结及其制造方法、超级结的深沟槽制造方法	ZL201910060771.2	2019年1月22日起20年	上海华虹宏力
206.	发明	EEPROM结构及其制备方法	ZL201910848806.9	2019年9月9日起20年	上海华虹宏力
207.	发明	射频开关器件的形成方法及射频开关器件	ZL201910210572.5	2019年3月20日起20年	上海华虹宏力
208.	发明	一种晶圆测试方法	ZL201910318905.6	2019年4月19日起20年	上海华虹宏力
209.	发明	分栅式存储器及其制作方法	ZL201910347413.X	2019年4月28日起20年	上海华虹宏力

210.	发明	CMP 研磨方法	ZL201910698610.6	2019 年 7 月 31 日起 20 年	上海华虹宏力
211.	发明	OTP 器件结构及其制备方法	ZL200810044082.4	2008 年 12 月 10 日起 20 年	上海华虹宏力
212.	发明	功率 MOS 管的结构及其制造方法	ZL201310613289.X	2013 年 11 月 27 日起 20 年	上海华虹宏力
213.	发明	集成超势垒整流器的 IGBT 器件及制造方法	ZL201310509003.3	2013 年 10 月 24 日起 20 年	上海华虹宏力
214.	发明	提高 IGBT 性能的背面工艺制作方法	ZL201310684349.7	2013 年 12 月 13 日起 20 年	上海华虹宏力
215.	发明	晶圆背面减薄工艺方法	ZL201710847318.7	2017 年 9 月 19 日起 20 年	上海华虹宏力
216.	发明	采用大马士革工艺制备金属栅极中接触孔的方法	ZL200810043751.6	2008 年 8 月 29 日起 20 年	上海华虹宏力
217.	发明	超深沟槽的多级刻蚀与填充方法	ZL200810044051.9	2008 年 12 月 4 日起 20 年	上海华虹宏力
218.	发明	深沟槽填充方法	ZL200910057251.2	2009 年 5 月 13 日起 20 年	上海华虹宏力
219.	发明	一种 NVM 中的负电荷泵	ZL201911042233.7	2019 年 10 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
220.	发明	温度补偿 POR 电路	ZL201910939800.2	2019 年 9 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
221.	发明	低电压射频前端结构	ZL201910939186.X	2019 年 9 月 30 日起 20 年	上海华虹宏力
222.	发明	一种闪存及其制备方法	ZL201910919833.0	2019 年 9 月 26 日起 20 年	上海华虹宏力
223.	发明	一种半导体器件以及形成方法	ZL201910919825.6	2019 年 9 月 26 日起 20 年	上海华虹宏力
224.	发明	一种 ESD 保护电路	ZL202010057738.7	2020 年 1 月 19 日起 20 年	上海华虹宏力

225.	发明	半导体结构的形成方法	ZL201911131109.8	2019年11月19日起20年	上海华虹宏力
226.	发明	光刻工艺方法	ZL201910821876.5	2019年9月2日起20年	上海华虹宏力
227.	发明	1.5T SONOS 闪存器件及工艺方法	ZL201910742908.2	2019年8月13日起20年	上海华虹宏力
228.	发明	SONOS 器件的制造方法	ZL201910211373.6	2019年3月20日起20年	上海华虹宏力
229.	发明	一种绝缘体上硅射频开关器件及其制造方法	ZL201910059096.1	2019年1月22日起20年	上海华虹宏力
230.	发明	刻蚀方法及半导体器件的制造方法	ZL202010723935.8	2020年7月24日起20年	上海华虹宏力
231.	发明	超级结及其制造方法	ZL201911051619.4	2019年10月31日起20年	上海华虹宏力
232.	发明	闪存器件的形成方法	ZL202010116390.4	2020年2月25日起20年	上海华虹宏力
233.	发明	半导体器件的形成方法	ZL201910913688.5	2019年9月25日起20年	上海华虹宏力
234.	发明	LDMOS 器件及其制作方法	ZL201911325026.2	2019年12月20日起20年	华虹无锡
235.	发明	LDMOS 器件的制作方法、LDMOS 器件	ZL201911324379.0	2019年12月20日起20年	华虹无锡
236.	发明	WAT 设备的测试头及其诊断修复方法	ZL201911363248.3	2019年12月26日起20年	华虹无锡
237.	发明	一种射频开关 ESD 系统	ZL201810800636.2	2018年7月20日起20年	上海华虹宏力
238.	发明	LDMOS 晶体管的场氧化层隔离结构及其制备方法	ZL201910435315.1	2019年5月23日起20年	上海华虹宏力

239.	发明	版图数据检查分配方法	ZL201810319793.1	2018年4月11日起20年	上海华虹宏力
240.	发明	晶圆特性测试系统和方法	ZL201910808257.2	2019年8月29日起20年	上海华虹宏力
241.	发明	电荷泵电路的待机电压调节方法	ZL202010931820.8	2020年9月8日起20年	上海华虹宏力
242.	发明	一种分栅快闪存储器的版图、掩膜版及版图制作方法	ZL201911025730.6	2019年10月25日起20年	上海华虹宏力
243.	发明	定位环及化学机械抛光机台	ZL202010872381.8	2020年8月26日起20年	上海华虹宏力
244.	发明	超级结器件的晶圆背面工艺方法	ZL201910089981.4	2019年1月30日起20年	上海华虹宏力
245.	发明	MIM 电容的测试结构及其制备方法	ZL201910698627.1	2019年7月31日起20年	上海华虹宏力
246.	发明	屏蔽栅沟槽型器件的工艺方法	ZL202011056835.0	2020年9月29日起20年	上海华虹宏力
247.	发明	低频振荡电路及偏置电压和电流产生电路	ZL201810178622.1	2018年3月5日起20年	上海华虹宏力
248.	发明	IGBT 结构	ZL201910014517.9	2019年1月8日起20年	上海华虹宏力
249.	发明	一种提高 OPC 初值预估精度的方法	ZL201910078663.8	2019年1月28日起20年	上海华虹宏力
250.	发明	沟槽的外延填充方法	ZL202010326164.9	2020年4月23日起20年	上海华虹宏力
251.	发明	非挥发性存储器冗余存储的控制测试电路和控制测试方法	ZL202010475586.2	2020年5月29日起20年	上海华虹宏力
252.	发明	离子注入机台的监控方法	ZL202010530978.4	2020年6月11日起20年	上海华虹宏力

253.	发明	一种由射频开关控制的衰减器	ZL201811197876.4	2018年10月15日起20年	上海华虹宏力
254.	发明	改善 PMOS OTP 性能的方法	ZL201810696878.1	2018年6月29日起20年	上海华虹宏力
255.	发明	MEMS 感知器结构及其制造方法	ZL201910297077.2	2019年4月15日起20年	上海华虹宏力
256.	发明	超结结构及超结器件	ZL201910418765.X	2019年5月20日起20年	上海华虹宏力
257.	发明	静电保护电路	ZL201911256096.7	2019年12月10日起20年	上海华虹宏力
258.	发明	SGT 器件的工艺方法	ZL201911291567.8	2019年12月16日起20年	上海华虹宏力
259.	发明	晶圆背面监控方法	ZL202010004203.3	2020年1月3日起20年	上海华虹宏力
260.	发明	沟槽的刻蚀方法	ZL202010169846.3	2020年3月12日起20年	上海华虹宏力
261.	发明	电压控制电路及其控制方法	ZL202010541617.X	2020年6月15日起20年	上海华虹宏力
262.	发明	IGBT 晶圆的减薄方法	ZL202010618537.X	2020年7月1日起20年	上海华虹宏力
263.	发明	一种一次可编程器件的制造方法	ZL202010693357.8	2020年7月17日起20年	上海华虹宏力
264.	发明	NORD 闪存的制造方法	ZL201911373706.1	2019年12月27日起20年	华虹无锡
265.	发明	沟槽的集成结构及其制造方法	ZL201911373708.0	2019年12月27日起20年	华虹无锡
266.	发明	隔离结构的制造方法	ZL202110268128.6	2021年3月12日起20年	华虹无锡
267.	发明	存储器件的制作方法	ZL202110446864.6	2021年4月25日起20年	华虹无锡
268.	发明	超薄栅极 CMOS 器件的制造方法	ZL201911042424.3	2019年10月30日起20年	华虹无锡

269.	发明	一种减少晶圆边缘聚焦不良的方法	ZL201911364438.7	2019年12月26日起20年	华虹无锡
270.	发明	OTP 存储器及其制造方法	ZL201911364749.3	2019年12月26日起20年	华虹无锡
271.	发明	闪存器件的制造方法	ZL201911373600.1	2019年12月27日起20年	华虹无锡
272.	发明	对硅氧化物和多晶硅的刻蚀方法	ZL201911373845.4	2019年12月27日起20年	华虹无锡
273.	发明	半导体器件的版图和器件沟槽深度的监控方法	ZL202011019728.0	2020年9月25日起20年	华虹无锡
274.	发明	NORD 闪存的制作方法	ZL202011095984.8	2020年10月14日起20年	华虹无锡
275.	发明	应用于图像传感器的接触孔形成方法	ZL202011139697.2	2020年10月22日起20年	华虹无锡
276.	发明	晶圆测试的自动化控制系统和方法	ZL202011354244.1	2020年11月27日起20年	华虹无锡
277.	发明	NORD 闪存浮栅测试区域接通方法、接通结构、设备和存储介质	ZL202011415084.7	2020年12月7日起20年	华虹无锡
278.	发明	高压厚栅氧的制作方法	ZL202011462782.2	2020年12月14日起20年	华虹无锡
279.	发明	刻蚀方法	ZL202011540990.X	2020年12月23日起20年	华虹无锡
280.	发明	半导体器件及其制造方法	ZL202110418016.4	2021年4月19日起20年	华虹无锡
281.	发明	CMOS 图像传感器的制造方法	ZL202110428528.9	2021年4月21日起20年	华虹无锡
282.	发明	晶圆背面减薄工艺方法	ZL202011508325.2	2020年12月18日起20年	华虹无锡

283.	发明	测量深沟槽深度的方法	ZL201911246450.8	2019年12月5日起20年	华虹无锡
284.	发明	一种改善NOR flash单元边界字线多晶硅残留的方法	ZL201911363060.9	2019年12月26日起20年	华虹无锡
285.	发明	CIS器件的隔离区形成方法	ZL202011536574.2	2020年12月23日起20年	华虹无锡 上海华虹宏力
286.	发明	半导体测试结构和包含其的晶圆	ZL202011536772.9	2020年12月23日起20年	华虹无锡 上海华虹宏力
287.	发明	存储器件的形成方法	ZL202011536786.0	2020年12月23日起20年	华虹无锡
288.	发明	浮栅型分栅闪存器件结构及其制造方法	ZL202110347041.8	2021年3月31日起20年	华虹无锡 上海华虹宏力
289.	发明	金属硅化物层的形成方法	ZL202110446856.1	2021年4月25日起20年	华虹无锡
290.	发明	半导体器件的制作方法	ZL202110446880.5	2021年4月25日起20年	华虹无锡
291.	发明	集成电路的仿真模型的建立方法	ZL202110467089.2	2021年4月28日起20年	华虹无锡 上海华虹宏力
292.	发明	屏蔽栅功率器件制造方法及其功率器件	ZL202110467590.9	2021年4月28日起20年	华虹无锡
293.	发明	铜铝互连结构的制作方法	ZL202010630546.0	2020年7月3日起20年	华虹无锡
294.	发明	半导体器件及其制作方法	ZL202010764588.3	2020年7月31日起20年	华虹无锡

295.	发明	MIM 电容的形成方法和 MIM 电容	ZL202010958494. X	2020 年 9 月 14 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
296.	发明	用于改善晶圆翘曲的 SGT 器件及其制作方法	ZL202011008913. X	2020 年 9 月 23 日起 20 年	华虹无锡
297.	发明	静电贴合方法和静电贴合装置	ZL202011096820. 7	2020 年 10 月 14 日起 20 年	华虹无锡
298.	发明	铜互连结构制作方法	ZL202011145106. 2	2020 年 10 月 23 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
299.	发明	MIM 电容的形成方法和后端结构	ZL202011169695. 8	2020 年 10 月 28 日起 20 年	华虹无锡
300.	发明	对准工艺方法	ZL202011319110. 6	2020 年 11 月 23 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
301.	发明	用于 CIS 的富硅氧化物层制作方法	ZL202011334038. 4	2020 年 11 月 25 日起 20 年	华虹无锡
302.	发明	闪存的数据保持力测试方法	ZL202011463234. 1	2020 年 12 月 14 日起 20 年	华虹无锡
303.	发明	具有栅极保护二极管的 MOS 晶体管	ZL202011636002. 1	2020 年 12 月 31 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
304.	发明	CIS 器件的深沟槽隔离形成方法、半导体器件结构	ZL202110075783. X	2021 年 1 月 20 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
305.	发明	控制 Taiko 晶圆断差的方法	ZL202110169980. 8	2021 年 2 月 5 日起 20 年	华虹无锡

306.	发明	CMOS 图像传感器及其制造方法	ZL202110344986.4	2021 年 3 月 31 日起 20 年	华虹无锡
307.	发明	存储器件的制作方法	ZL202110446879.2	2021 年 4 月 25 日起 20 年	华虹无锡
308.	发明	通孔的制造方法	ZL202110459179.7	2021 年 4 月 27 日起 20 年	华虹无锡
309.	发明	闪存器件的制造方法	ZL201911255745.1	2019 年 12 月 10 日起 20 年	华虹无锡
310.	发明	IGBT 器件的制造方法	ZL202010897106.1	2020 年 8 月 31 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
311.	发明	MIM 电容的制造方法	ZL202010937668.4	2020 年 9 月 8 日起 20 年	华虹无锡
312.	发明	MOS 器件的制作方法及其版图	ZL202011096035.1	2020 年 10 月 14 日起 20 年	华虹无锡
313.	发明	针对特定图形旁波效应的 OPC 方法及通孔层 OPC 处理方法	ZL202011422048.3	2020 年 12 月 8 日起 20 年	华虹无锡
314.	发明	图像传感器的深沟槽隔离形成方法、半导体器件结构	ZL202011536612.4	2020 年 12 月 23 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
315.	发明	浮栅型分栅闪存器件结构及其制作工艺	ZL202110347764.8	2021 年 3 月 31 日起 20 年	华虹无锡 上海华虹宏力
316.	发明	一种改善厚铝刻蚀工艺中聚合物的方法	ZL202110447796.5	2021 年 4 月 25 日起 20 年	华虹无锡
317.	发明	NOR Flash Cell 区域控制栅回刻方法、存储介质和控制模块	ZL202110466875.0	2021 年 4 月 28 日起 20 年	华虹无锡

318.	发明	功率器件制作方法和功率器件结构	ZL202110467209.9	2021年4月28日起20年	华虹无锡
319.	发明	浮栅分栅闪存器件结构及其制造方法	ZL202110467481.7	2021年4月28日起20年	华虹无锡
320.	发明	背封硅片的制作方法	ZL202010716648.4	2020年7月23日起20年	华虹无锡
321.	发明	后端结构的形成方法	ZL202011292924.5	2020年11月18日起20年	华虹无锡
322.	发明	NORD flash 制造方法、器件和存储介质	ZL202011504341.4	2020年12月18日起20年	华虹无锡
323.	发明	CMOS 图像传感器及其制造方法	ZL202110346045.4	2021年3月31日起20年	华虹无锡

表 2: 境外主要专利

编号	专利名称	专利号	专利权人	专利期限	注册国家/地区
1.	Thyristor comprising a special doped region characterized by an LDD region and a halo implant	US 8,703,547	上海华虹宏力	2008年12月22日起 20年又466天	美国
2.	ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE MEMORY AND ITS MANUFACTURING METHOD	US 8,575,673	上海华虹宏力	2008年10月13日起 20年又310天	美国
3.	MEMORY ARRAY	US 8,693,243	上海华虹宏力	2011年10月5日起 20年又215天	美国
4.	WORD-LINE VOLTAGE REGULATING CIRCUIT AND SINGLE POWER SUPPLY MEMORY	US 8,659,971	上海华虹宏力	2012年7月3日起 20年又71天	美国
5.	SUPERJUNCTION LDMOS AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME	US 8,698,237	上海华虹宏力	2012年9月28日起 20年又35天	美国
6.	Flash Memory Device	US 8,942,044	上海华虹宏力	2012年8月9日起 20年又404天	美国

7.	METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE	US 8,778,761	上海华虹宏力	2013年6月10日起 20年	美国
8.	SILICON-ON-INSULATOR RADIO FREQUENCY DEVICE AND SILICON-ON-INSULATOR SUBSTRATE	US 9,780,164	上海华虹宏力	2013年12月19日起 20年又41天	美国
9.	CHARGE PUMP CIRCUIT	US 9,013,230	上海华虹宏力	2013年8月12日起 20年又29天	美国
10.	RESISTOR STRUCTURE AND METHOD FOR FORMING THE SAME	US 9,318,545	上海华虹宏力	2014年12月29日起 20年	美国
11.	EEPROM DEVICE AND FORMING METHOD AND ERASING METHOD THEREOF	US 9,269,717	上海华虹宏力	2014年12月31日起 20年	美国
12.	MEMORY TESTING METHOD AND APPARATUS	US 9,257,201	上海华虹宏力	2014年12月30日起 20年	美国
13.	METHOD OF FORMING MEMS DEVICE	US 9,296,608	上海华虹宏力	2014年12月18日起 20年	美国
14.	HIGH VOLTAGE LDMOS DEVICE WITH AN INCREASED VOLTAGE AT SOURCE (HIGH SIDE) AND A FABRICATING METHOD THEREOF	US 9,543,432	上海华虹宏力	2015年12月29日起 20年	美国

15.	NLDMOS DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	US 9,997,626	上海华虹宏力	2015年12月29日起 20年	美国
16.	MOSFET AND A METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME	US 10,784,337	上海华虹宏力	2019年8月2日起 20年	美国
17.	CAPACITOR-COUPLED N-TYPE TRANSISTOR-BASED ONE-TIME PROGRAMMABLE DEVICE	US 10,679,999	上海华虹宏力	2018年11月28日起 20年	美国
18.	SONOS NONVOLATLE MEMORY AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME	US 10,978,467	上海华虹宏力	2019年6月18日起 20年又8天	美国
19.	IGBT DEVICE	US 11,139,391	上海华虹宏力	2019年9月10日起 20年	美国
20.	MANUFACTURING METHOD FOR SHIELDED GATE TRENCH DEVICE	US 10,943,994	上海华虹宏力	2019年12月6日起 20年	美国
21.	EEPROM MEMORY CELL GATE CONTROL SIGNAL GENERATING CIRCUIT	US 9,530,505	上海华虹宏力	2015年12月21日起 20年	美国
22.	PATTERN SORTING METHOD USED IN OPC VERIFICATION	US 10,409,153	上海华虹宏力	2017年12月21日起 20年又71天	美国

23.	TRENCH GATE MANUFACTURING METHOD	US 10,680,070	上海华虹宏力	2018年9月26日起 20年	美国
24.	SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER AND CONVERSION METHOD THEREFOR	US 10,530,382	上海华虹宏力	2018年11月28日起 20年	美国
25.	SUPER-JUNCTION STRUCTURE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME	US 10,923,564	上海华虹宏力	2019年6月18日起 20年	美国
26.	TRENCH-GATE MOSFET AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME	US 10,686,070	上海华虹宏力	2019年8月16日起 20年	美国
27.	SUPER-JUNCTION IGBT DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAMR	US 11,133,407	上海华虹宏力	2019年10月11日起 20年又61天	美国
28.	SPLIT GATE MEMORY DEVICE, SEMICONDUCTOR DEVICE AND FORMING METHOD THEREOF	US 9,536,889	上海华虹宏力	2014年12月29日起 20年	美国
29.	MEMORY, AND ERASING METHOD, PROGRAMMING METHOD AND READING METHOD THEREOF	US 9,396,801	上海华虹宏力	2015年12月14日起 20年	美国
30.	Sampling Method and Apparatus Applied to OPC of Lithography Layout	US 9,978,134	上海华虹宏力	2016年12月22日起 20年又8天	美国

31.	EEPROM, AND METHOD FOR ERASING, PROGRAMMING AND READING THE EEPROM	US 10,790,021	上海华虹宏力	2018年4月9日起 20年	美国
32.	SPLIT-GATE FLASH MEMORY, METHOD OF FABRICATING SAME AND METHOD FOR CONTROL THEREOF	US 10,700,174	上海华虹宏力	2018年12月26日起 20年	美国
33.	ELECTRICALLY PROGRAMMABLE FUSE CIRCUIT, PROGRAMMING METHOD FOR ELECTRICALLY PROGRAMMABLE FUSE, AND STATE DETECTION METHOD FOR ELECTRICALLY PROGRAMMABLE FUSE	US 10,811,113	上海华虹宏力	2019年5月28日起 20年	美国
34.	RADIO FREQUENCY SWITCHING CIRCUIT	US 1,0763,842	上海华虹宏力	2019年5月31日起 20年	美国
35.	POWER SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME	US 11,145,511	上海华虹宏力	2020年10月13日起 20年	美国
36.	TERMINAL STRUCTURE FOR SUPERJUNCTION DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME	US 8,546,882	上海华虹宏力	2011年3月30日起 20年又352天	美国
37.	HIGH-VOLTAGE ESD PROTECTION DEVICE	US 8,803,280	上海华虹宏力	2011年10月18日起 20年	美国

38.	MEMORY AND METHOD FOR FORMING THE SAME	US 11,081,557	上海华虹宏力	2020年2月12日起 20年	美国
39.	LD MOS DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME	US 11,264,497	上海华虹宏力	2019年10月18日起 20年又78天	美国
40.	METHOD FOR MAKING JFET DEVICE, JFET DEVICE AND LAYOUT STRUCTURE THEREOF	US 11,257,936	上海华虹宏力	2020年8月13日起 20年	美国
41.	MIM CAPACITOR OF EMBEDDED STRUCTURE AND METHOD FOR MAKING THE SAME	US 11,239,153	华虹无锡	2020年12月15日起 20年	美国